股票代號(Stock Code):3661

Alchip Technologies, Limited
英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

一百零三年度年報
2014 Annual Report

刊印日期: 2015 年 4 月 16 日

年報網址: http://mops.twse.com.tw

世芯電子網站：http://www.alchip.com

一、公司發言人及代理發言人、中華民國境內訴訟及非訴訟代理人

本公司發言人		代理發言人	
姓　　名：王德善		姓　　名：湯治華	
職　　稱：財務長		職　　稱：亞太營運處 General Manager	
電　　話：02-2659-9357		電　　話：02-2799-2318	
電子郵件信箱：IR@alchip.com		電子郵件信箱：IR@alchip.com	

訴訟及非訴訟代理人
姓　　名：湯治華
職　　稱：亞太營運處 General Manager
電　　話：02-2799-2318
電子郵件信箱：IR@alchip.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

(一)本公司

名　稱：Alchip Technologies, Limited 英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司
地　址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY-1104, Cayman Islands　電話：02-2799-2318

(二)子公司：

1.臺灣子公司:
名稱：世芯電子股份有限公司
公司地址：臺北市內湖區文湖街 12 號 9 樓　電話：02-2799-2318

2.臺灣分公司:
名稱：英屬開曼群島商世芯股份有限公司臺灣分公司
公司地址：臺北市內湖區文湖街 12 號 9 樓　電話：02-2799-2318

3.香港子公司:
名稱：Alchip Technologies, Limited
公司地址：Bank of America Tower, 12 Harcourt Road Central,Hong Kong　電話：852-2522-2922

4.上海孫公司:
名稱：世芯電子（上海）有限公司
註冊地址：上海市張江高科技園區郭守敬路 351 號 2 號樓 632-19 室
營運地址：上海市徐匯區龍華中路 596 號綠地中心東樓 11 樓
電話：86-21-5235-0999

5.日本子公司:
名稱：アルチップ・テクノロジーズ株式会社（Alchip Technologies, K.K.）
公司地址：10F Shin-Yokohama Square Bldg, 2-3-12 Shin-Yokohama, Kouhoku Yokohama Kanagawa Japan, 222-0033　電話：81-45-470-1090

6.美國子公司:
名稱：AlChip Technologies, Inc.
公司地址: P.O. Box 5176 Santa Clara, CA 95054　電話：1-408-727-3957

7.無錫孫公司:
名稱：世芯電子科技(無錫)有限公司
公司地址：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A5 幢 4 楼
電話：86-510-8512-0332

8.BVI 子公司:
名稱：Alchip Investment Inc.
公司地址：Portcullis TrustNet Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola,Birtish Virgin Islands VG1110　電話：02-2799-2318

三、董事會名單

職稱	姓名	國籍	主要經(學)歷	
董事長	關建英 Kwan, Kinying	美國、中華民國	學歷	美國伊利諾大學電子工程學士
			經歷	世芯電子總經理 Altius Solutions 創辦人 Cirus Logic 協理
董事	張國威	中華民國	學歷	交通大學管理科學碩士
			經歷	Investar Capital inc. President 旭揚創業投資(股)公司總經理
董事	Ng, Benjamin Jin-Ping	澳洲	學歷	澳洲麥克里大學企業管理碩士 澳洲新南威爾斯大學工程學士
			經歷	SAIF Advisors, General Partner Cisco Systems, Head of Corporate Business Development
董事	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang Lin	美國、中華民國	學歷	美國加州州立大學洛杉磯分校電子工程學士
			經歷	世芯電子營運長 (COO) 世芯電子中國營運處 General Manager 及單晶片設計處 VP Cadence Design System 資深經理 Altius/Simplex Solutions 經理 Sun Microsystems 資深工程師 Tandem Computer 工程師
獨立董事	江善頌	中華民國	學歷	美國南加州大學,企業管理碩士
			經歷	華登國際管理顧問(股)公司董事總經理
獨立董事	洪茂蔚	中華民國	學歷	美國西北大學財務金融博士 美國威斯康辛麥迪遜大學經濟碩士 台灣大學,經濟學學士
			經歷	台灣大學管理學院院長 中央研究院經濟研究所合聘研究員 加拿大 McGill 大學財金系教授
獨立董事	莊彬甫	美國	學歷	美國奧勒岡州立大學,理工碩士 台灣交通大學,理工學士
			經歷	上海新茂半導體總裁

四、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱: 中國信託商業銀行代理部	網址: https://www.ctbcbank.com
地址: 台北市重慶南路一段 83 號 5 樓	電話: (02)6636-5566

五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：王儀雯會計師、黃樹傑會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所　網址：http://www.deloitte.com.tw
地址：台北市松山區民生東路三段 156 號 12 樓　電話：02-2545-9988

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

七、公司網址：http://www.alchip.com。

目錄

壹、致股東報告書 1
貳、公司簡介 3
一、設立日期及集團簡介 3
二、公司沿革 3
參、公司治理報告 6
一、組織系統 6
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 8
三、公司治理運作情形 18
四、會計師公費資訊 30
五、更換會計師資訊 31
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或關係企業 31
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 31
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二等 親以內之親屬關係之資訊 32
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 33
肆、募資情形 39
一、資本及股份、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形 39
二、資金運用計劃執行情形，包括計畫內容及執行情形 48
伍、營運概況 49
一、業務內容 49
二、市場及產銷概況 55
三、從業員工 62
四、環保支出資訊 62
五、勞資關係 63
六、重要契約 63
陸、財務概況 67
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 67
二、最近五年度財務分析 71
三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告 76
四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表及附註或附表 77
五、最近年度(2014 年)經會計師查核簽證之合併財務報告 77
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 77

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 78
一、財務狀況分析 78
二、財務績效分析 79
三、現金流量分析 80
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 80
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃 80
六、最近年度及截至年報刊日止風險事項評估 81
七、其他重要事項 84
捌、特別記載事項 85
一、關係企業相關資料 85
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 88
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 88
四、其他必要補充說明事項 88
五、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明 89
六、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 104

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生們：

2014 年是世芯電子營收及獲利再創高峰的一年，由於產量收入增加，除第四季由於營收季節性下滑與業外損益影響有所衰退，世芯電子 2014 年全年無論是營收或是獲利皆向上攀升。總的來說，2014 年全年合併營收以美元計算約一億五仟四佰八十萬美元，較 2013 年成長 77.9%；在獲利方面，2014 全年稅後淨利較前年成長 88.7%，達七百萬美元，並順利推動公司股票掛牌上市。

在技術研發方面，世芯電子仍然維持 ASIC 設計服務領域中先進製程技術的領先地位，營收中高達 70%都屬於高階製程(40 奈米及以下)設計案，除了完成多項 28/20 奈米製程設計，也在 2014 年底開始提供客戶最先進的 16 奈米製程服務，並於 2015 年 2 月完成項目設計，順利投片。

在產品應用方面，我們持續與世界級系統大廠合作，完成了許多高效能、低功耗的設計案，應用領域包含：4K2K 電視、數位相機、娛樂系統、行動寬頻以及通訊網絡設備，與可累積利基的醫療設備、比特幣挖礦機與日本娛樂機台…等。另，公司在業務發展上亦有相當斬獲，除了既有市場外，也成功納入手機相機模組與移動裝置 ISP 客戶，可望在未來提供穩定的營運動力。整體而言，公司在 2014 年無論是獲利及業務發展皆有亮麗的表現。

依銷售區域分析，日本地區的營收持續受到大型系統客戶的加持，所占總營收之比例雖有下滑，但仍為世芯電子最主要的營收來源；亞太及歐洲地區受惠於韓國及其他客戶產品陸續開始量產，躍升為世芯第二大營收來源，所占比例於 2014 年持續拉高；中國地區營收所佔比例，隨著比特幣挖礦機設計案的持續進行而逐漸提高。預期隨著新興產品進入量產與新項目的貢獻，世芯電子 2015 年整體營收相較 2014 年將持平成長。

財務表現

以新台幣計，2014 年本公司營業額為新台幣四十六億九仟兩佰萬元，較 2013 年的營業額新台幣二十五億八仟三佰萬元成長 81.60%，2014 年稅後淨利為新台幣二億一仟二佰萬元，較 2013 年的稅後淨利新台幣一億一仟三佰萬元成長了 87.69%。以美元來計算，全年營收為一億五仟四佰八十萬美元，稅後淨利為七佰萬美元，分別較前一年成長 77.90%及成長 83.97%。2014 年經營績效的表現還包括: 全年平均毛利率 20.3%、營業利益率為 7.30%、資產報酬率為 8.13%、股東權益報酬率為 9.58%。

技術創新

因應客戶對高階製程設計之需求，2014年世芯持續投入資源發展高階製程與客製化IP之設計，加強與合作夥伴針對先進技術最佳化的研發，延續20奈米製程設計的成功；世芯並於2014年底開始提供客戶最先進的16奈米製程服務，已於2015年初進入量產，持續站穩先進製程領導廠商的地位。

企業發展

世芯深耕半導體產業已十一年，並在無晶圓廠 ASIC 領域佔有一定的地位，在所有同仁的努力下，世芯於 2014 年 10 月 28 日順利掛牌上市，未來除了繼續發展既有市場外，我們也將積極打入北美、泛歐地區及新興市場，以提升全球市占率，挹注成長動能；並承諾客戶更精緻化的設計服務，期望未來成為 ASIC 產業第一領導品牌。

未來展望

展望 2015 年，全球半導體市場持續增溫，在全球智慧型手機熱賣、物聯網產業的起步、穿戴式產品發燒及新產品出貨的帶動下，世芯營收可望持續成長。我們將專注深耕世界級品牌客戶，以堅強的核心競爭力、高階先進製程的設計能力及滿意的客戶服務，邁向持續獲利之目標，為客戶及股東創造更高的價值。

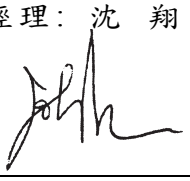
最後，再次誠摯地感謝努力不懈的員工，和各位股東們長久以來對本公司的支持與鼓勵，謹致上最深的謝忱！

並祝各位，身體健康、萬事如意

董事長: 關 建 英 Kinying Kwan

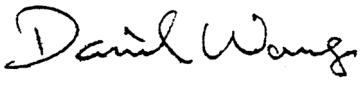
Chairman

總經理: 沈 翔 霖 Johnny Shyang-Lin Shen



Chief Executive Officer

財務長: 王 德 善 Daniel Wang



Chief Financial Officer

貳、 公司簡介

一、 設立日期及集團簡介

世芯電子股份有限公司（以下稱「本公司」或「世芯電子」），係由董事長關建英先生帶領來自美國矽谷知名系統單晶片公司的核心技術團隊，於 2003 年 2 月 27 日設立於英屬開曼群島，為專門提供高複雜度、高產量特殊應用積體電路(ASIC)與系統單晶片(SoC)設計及製造服務的領導業者。總部設於台灣台北，新竹設有 ASIC 製造中心；基於全球發展策略考量，本公司分別在中國、日本和美國成立子公司，及於韓國成立辦事處（以下合稱「本集團」）。截至 2014 年底，員工總人數為 240 人。

本集團之經營團隊在IC設計服務產業深耕多年，團隊包含來自美國矽谷與日本的SoC設計專家，平均具有 20 年以上半導體產業管理經驗，在高階製程及晶片設計的能力優於其他同業。在成立之初的短短三年間，就完成了從 0.13 微米、90 奈米至 65 奈米的技術跨度並付諸量產；2009 年開始為客戶量產 40 奈米設計案；2013 年跨入 28 奈米設計案；2014 年完成多項 28 奈米、20 奈米設計案，並於同年底更開始提供客戶最新 16 奈米製程設計服務。

世芯電子專注於深次微米製程(40 奈米以下)的 ASIC 及 SoC 解決方案，目標在於協助系統產品客戶在最短時間完成低成本、高複雜度的晶片設計，以加速客戶產品上市。公司成立至今，已完成超過兩百五十顆高端製程 SoC，四大產品應用領域為高解析度電視、通訊網絡設備、其他數位多媒體消費性電子產品(數位相機、娛樂系統、行動寬頻…等)以及利基型產品(醫療設備與監視系統…等)， 世芯電子在上述的應用領域中創造出傲人的成績，並維持 100%一次投片成功的紀錄，是眾多世界級系統大廠 IC 設計夥伴之首選。

二、 公司沿革

2002 年 08 月	香港子公司成立。
2002 年 09 月	上海子公司成立。
2003 年 02 月	世芯電子於開曼群島註冊成立豁免公司。
2003 年 04 月	開曼世芯電子以換股方式投資香港子公司及上海子公司。
2003 年 05 月	美國子公司成立。
2003 年 08 月	完成第一個 0.13 微米晶片設計。
2004 年 02 月	日本子公司成立。
2004 年 07 月	加入台積電設計中心聯盟(DCA) 。
2004 年 09 月	獲日本大廠 M 公司 0.13 微米，16M gate 設計訂單。
2004 年 11 月	完成第一個 90 奈米、6M gate 高階消費性電子 SoC 設計，並於 2005 年下半年進入量產。
2005 年 01 月	臺灣子公司成立。
2005 年 04 月	贏得 90 奈米、500MHz 高速運算 SoC 設計訂單，成為全球第一個在台積電進入 90G 量產的產品。
2005 年 08 月	單月出貨量高達 1 百萬顆系統單晶片。
2006 年 06 月	完成 65 奈米 ARM 1176 嵌入式多核心應用處理器發展。

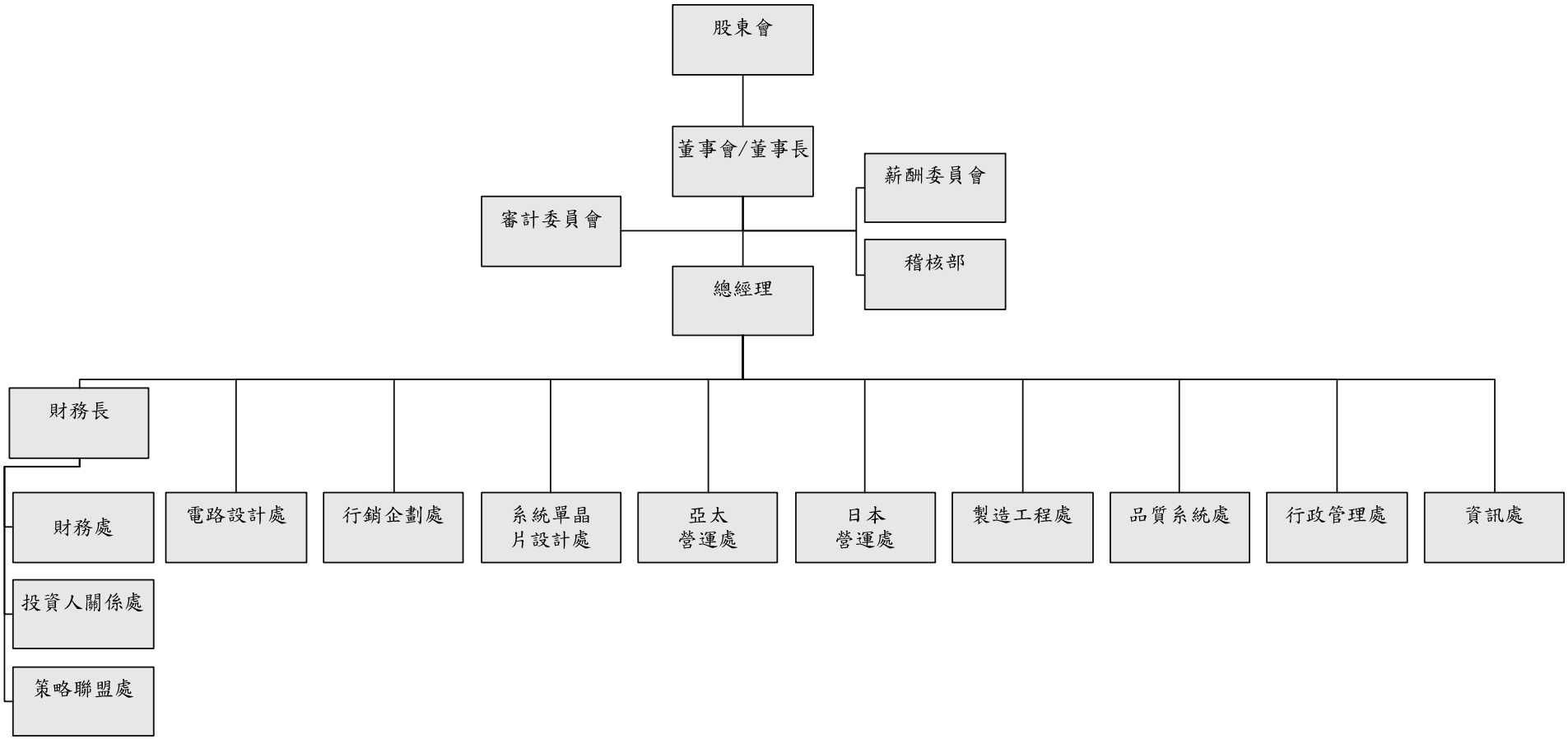
2006 年 09 月	贏得日本系統大廠數位攝影機 SoC 設計訂單。
2006 年 11 月	通過 ISO 9001 認證。
2006 年 12 月	單月出貨量高達 2 百萬顆系統單晶片。
2007 年 02 月	贏得 65 奈米 SoC 設計訂單。
2007 年 05 月	贏得日本系統大廠 HDTV SoC 設計訂單。
2007 年 06 月	單月出貨量高達 2 百 50 萬顆系統單晶片。
2007 年 07 月	採用 Verigy V93000 Pin-Scale 800 系統為其新一代晶片測試機台。
2008 年 01 月	贏得系統大廠行動通訊裝置 SoC 設計訂單。
2008 年 02 月	取得 ARM 授權。
2008 年 03 月	贏得日本系統大廠數位電視 SoC 設計訂單。
2008 年 03 月	加入 Cadence (Power Forward Initiative；PFI) 聯盟。
2008 年 04 月	加入 ARM Connected Community 成為 ARM 合作夥伴。
2008 年 05 月	與 SONY 半導體事業部(SONY Semiconductor Group)成為封裝技術之合作夥伴。
2008 年 06 月	被評為 2008《電子工程專輯》“十大中國傑出服務型 IC 設計公司”。
2008 年 08 月	採用 Synopsys Eclypse 的低功耗設計解決方案。
2008 年 10 月	量產 65 奈米 Turnkey 統包服務。
2008 年 11 月	在中國贏得第一個 65 奈米 Turnkey 統包服務設計案。
2008 年 12 月	榮獲日本系統大廠「Green Partner」綠色夥伴殊榮。
2008 年 12 月	設置熱流及自動化測試分類機。
2009 年 02 月	參與電子束創始計畫(ebeam Initiative)。
2009 年 04 月	獲選為台積電全球九大 VCA 會員之一。
2009 年 12 月	量產 55 奈米 Turnkey 統包服務。
2009 年 12 月	完成系統大廠 40 奈米 Mobile Game 設計案。
2010 年 03 月	單月出貨量高達 2 百 50 萬顆系統單晶片。
2010 年 10 月	完成系統大廠 32 奈米 HDTV 應用設計案。
2010 年 12 月	55 奈米設計案累計出貨量超過一千萬顆系統單晶片。
2011 年 01 月	設置晶圓針測機 UF3000。
2011 年 03 月	完成 55 奈米平板電腦應用設計案。
2011 年 04 月	55 奈米設計案累計出貨量超過一千八百萬顆系統單晶片。
2011 年 07 月	世芯總部喬遷至內湖科技園區太陽科技廣場。
2011 年 09 月	完成 40 奈米影像設備設計案。
2011 年 12 月	通過 ISO 9001 擴充驗證認證。
2012 年 02 月	榮獲日系大廠之「2011 年度最佳供應商」殊榮。
2012 年 03 月	贏得 28 奈米 SoC 設計訂單。
2012 年 05 月	與日月光集團合作出貨突破五千萬顆系統單晶片。
2012 年 08 月	中國無錫子公司成立。
2012 年 09 月	完成系統大廠 28 奈米 Mobile Game 設計案。

2012 年 12 月	榮獲德勤亞太高科技高成長 Fast 500 獎項。
2012 年 12 月	日本子公司通過 ISO9001 認證。
2013 年 06 月	獲得日系大廠合作夥伴年度評鑑第一名。
2013 年 07 月	完成 28 奈米比特幣挖礦機設計案。
2013 年 08 月	完成 40 奈米高效能影像處理設計案。
2013 年 09 月	完成 28 奈米處理器(超級電腦)設計案。
2013 年 11 月	通過 ISO9001 認證。
2014 年 02 月	完成 20 奈米比特幣挖礦機設計案。
2014 年 05 月	完成日系大廠 28 奈米醫療設備設計案。
2014 年 06 月	獲得日系大廠合作夥伴年度評鑑第一名。
2014 年 06 月	完成 28 奈米萊特幣挖礦機設計案。
2014 年 09 月	完成日系大廠 28 奈米娛樂機台設計案。
2014 年 10 月	於台灣證券交易所掛牌上市。
2015 年 01 月	Alchip BVI 子公司及開曼世芯臺灣分公司成立。
2015 年 02 月	完成 16 奈米比特幣挖礦機設計案。

參、 公司治理報告

一、 組織系統

(一) 組織結構



(二) 主要部門所營業務

部門名稱	職掌業務
董事長	1. 依董事會決議，訂定公司之經營方針、政策、目標及經營計劃。 2. 列席董事會報告公司年度經營計劃，並作各階段經營成果財務報告。 3. 經董事會之授權，領導全公司之各項經營管理事宜。 4. 定期召開經營、主管會議等，協調推動公司各項業務之擴展。
總經理	1. 訂立公司業務經營之方向及目標，並負責領導各營運處達成營收目標。 2. 對公司各部門經常實施計劃、組織、指導、指揮、協調、檢討與控制。
財務長	負責管理公司財務營運、收購及其它資金問題。
財務處	掌管公司財務資金調度及會計帳務管理。
投資人關係處	1. 處理所有與台灣證券交易所之相關事物。 2. 與投資者（自然人與法人）做例行性溝通。 3. 為潛在投資者舉辦投資說明會。 4. 邀請投資者參加協商會議。
策略聯盟處	1. 發展和維護策略供應商的合作關係。 2. 與供應商議定目標價格以提供相關部門銷售前支援。 3. 發展新供應商或從現行供應商導入具有競爭性/高階的技術以達到成本效益。 4. 發展及執行所有採購的政策以及確保採購有效率的運作及組織利益。
行銷企劃處	負責公司全球行銷企劃之相關事宜。
系統單晶片設計處	為客戶完成從 RTL 或 netlist 到 GDSII 的設計實現。
電路設計處	1. 混合類比訊號矽智財開發。 2. 提供客製化電路設計服務及技術支援給各營運處單位。
製造工程處	1. 制定並完成公司生產技術研發方向及目標。 2. 提供先進的測試、封裝及產品/元件工程解決方案。
亞太/日本營運處	負責各營運處之業務推展、客戶服務及專案管理。
品質系統處	負責公司品質政策之規劃、執行及管理。
資訊處	負責公司資訊作業之規劃、執行及管理。
稽核部	協助董事會、執行長及管理階層檢查、評估內部控制系統並衡量營運之效率及成效，適時提供改善建議，作為內部控制系統修正的基礎，以確保內部控制制度得以持續有效運作。
行政管理處	統籌公司人事、行政總務、安全衛生等全盤行政管理事宜。

二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

2015 年 04 月 14 日

職稱	國籍	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷		目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
						股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率				職稱	姓名	關係
董事長	美國、中華民國	關建英 Kwan, Kinying	2013/06/28	3	2003/02/27	720,000	1.34%	680,000	1.07%	0	0%	0	0%	學歷: 經歷:	■美國伊利諾大學電子工程學士 ■世芯電子總經理 ■Altius Solutions 創辦人 ■Cirus Logic 協理	■本公司上海孫公司執行董事 ■本公司台灣子公司董事 ■本公司日本子公司董事 ■本公司美國子公司董事 ■本公司香港子公司董事	無	無	無
董事	中華民國	張國威	2013/06/28	3	2003/04/09	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷: 經歷:	■交通大學管理科學碩士 ■Investar Capital inc. President ■旭揚創業投資(股)公司總經理	■Monolithic Power Systems,Inc.董事 ■CEO of C Squared Management Corporation ■牧東光電總經理 ■本公司台灣子公司監察人 ■Investar Capital inc. President	無	無	無
董事	澳洲	Ng, Benjamin Jin-Ping	2013/06/28	3	2007/04/27	100,000	0.19%	100,000	0.16%	0	0%	0	0%	學歷: 經歷:	■澳洲麥克里大學企業管理碩士 ■澳洲新南威爾斯大學工程學士 ■Cisco Systems, Head of Corporate Business Development	■Sicomm Tech Co., Ltd 董事 ■Risecomm Co., Ltd 董事 ■NTS International Holding Ltd.董事 ■Beijing Rising Technology Co., Ltd 董事 ■China United Cleaning Technology Co., Ltd 董事 ■China Organic Holdings Ltd 董事 ■Natural Food Ltd 董事 ■Fuhua Tonda Agrochemical Technology Co., Ltd 董事 ■Fresh Waters International 董事 ■Pheromonicin Biotech, Ltd.董事 ■Chongqing PSK-Health Sci-Tech Development Co.,Ltd 董事 ■Beijing Ryzur Axiom Medical Investment Co.,Ltd.董事 ■AYLA Networks, INC.董事 ■Supersonic Ads Ltd.董事 ■SAIF Advisors, General Partner	無	無	無

董事	美國、中華民國	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	2013/06/28	3	2011/05/18	981,652	1.82%	941,652	1.48%	0	0%	0	0%	學歷:	■美國加州州立大學洛杉磯分校電子工程學士	■本公司台灣子公司董事及總經理 ■本公司上海孫公司總經理 ■本公司無錫孫公司執行董事 ■本公司臺灣分公司經理人	無	無	無
														經歷:	■世芯電子營運長(COO) ■世芯電子中國營運處 General Manager 及單晶片設計處 VP ■Cadence Design System 資深經理 ■Altius/Simplex Solutions 經理 ■Sun Microsystems 資深工程師 ■Tandem Computer 工程師				
獨立董事	中華民國	洪茂蔚	2013/06/28	3	2010/11/05	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷:	■美國西北大學財務金融博士 ■美國威斯康辛麥迪遜大學經濟碩士 ■台灣大學經濟學學士	■台灣大學國企系教授 ■牧東光電獨立董事 ■盛弘醫藥監察人	無	無	無
														經歷:	■台灣大學講座教授 ■台灣大學管理學院院長 ■中央研究院經濟研究所合聘研究員 ■加拿大 McGill 大學財金系教授				
獨立董事	中華民國	江善頌	2013/06/28	3	2010/11/05	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷:	■美國南加州大學企業管理碩士	無	無	無	無
														經歷:	■華登國際管理顧問(股)公司董事總經理				
獨立董事	美國、中華民國	莊彬甫	2013/06/28	3	2010/11/25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷:	■美國奧勒岡州立大學理工碩士 ■台灣交通大學理工學士	■上海新茂半導體董事及總經理	無	無	無
														經歷:	■上海新茂半導體總裁				

條件 姓名 (註 1)	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註 2）										兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
關建英 Kwan, Kinying			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
張國威			✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	0
Ng, Benjamin Jin-Ping			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	0
沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
洪茂蔚	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
江善頌			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
莊彬甫			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註 1：欄位多寡視實際數調整。

註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

2015 年 04 月 14 日

職稱	國籍	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	美國、中華民國	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	2010/01/01	941,652	1.48%	0	0%	0	0%	學歷: ■美國加州州立大學洛杉磯分校電子工程學士 經歷: ■世芯電子營運長 (COO) ■世芯電子中國營運處 General Manager 及單晶片設計處 VP ■Cadence Design System 資深經理 Solutions 經理 ■Altius/Simplex Solutions 經理 ■Sun Microsystems 資深工程師 ■Tandem Computer 工程師	■本公司台灣子公司董事及總經理 ■本公司上海孫公司總經理 ■本公司無錫孫公司執行董事 ■本公司台灣分公司經理人	無	無	無
日本營運處 General Manager	日本	藤田 浩三	2012/08/15	489,915	0.77%	0	0%	0	0%	學歷: ■日本大阪府立大學工業工程碩士 ■日本近畿大學工業工程學士 經歷: ■世芯電子策略業務處 VP ■Candence Design Systems 協理 ■Simplex Solutions 協理	■本公司日本子公司董事長及總經理	無	無	無
日本營運處 Deputy General Manager	日本	保坂 純一郎	2009/07/02	40,000	0.06%	0	0%	0	0%	學歷: ■日本橫浜國立大學經濟系學士 經歷: ■世芯電子財務長 ■Inno Micro Corporation 財務長 ■FOI Corporation 總經理 ■Verisity Design KK 經理 ■Candence Design Systems 經理	■本公司日本子公司董事	無	無	無

職稱	國籍	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
亞太營運處 General Manager	中華民國	湯治華	2007/09/10	70,000	0.11%	0	0%	0	0%	學歷: ■淡江大學 EMBA ■淡江大學電子工程學士 經歷: ■曜東光電股份有限公司總經理 ■Image Devices Inc 副總 ■鈺豐科技股份有限公司副總	無	無	無	無
系統單晶片設計處 VP	中華民國	鄭永力	2012/08/15	42,025	0.07%	0	0%	0	0%	學歷: ■美國南加州大學電子工程碩士 經歷: ■世芯電子晶片設計工程處協理 ■Cirrus Logic Inc. 資深工程師	■本公司無錫孫公司總經理	無	無	無
行銷企劃處 VP	中華民國	姜榮華	2009/09/09	50,000	0.08%	0	0%	0	0%	學歷: ■美國紐約州立大學賓漢頓校區電腦科學 博士/碩士 ■國立交通大學電子物理學士 經歷: ■台灣積體電路(TSMC) 經理 ■Cadence Design Systems 經理 ■Agere Systems 研發經理 ■Lucent Technologies 研發經理 ■AT&T Bell Labs 資深研發工程師	■本公司台灣子公司董事	無	無	無
財務長	中華民國	王德善	2011/12/29	20,000	0.03%	0	0%	0	0%	學歷: ■美國紐約市大伯魯克學院 MBA 經歷: ■富邦證券上海代表處代表	■本公司 BVI 子公司董事	無	無	無
Financial Controller	中華民國	詹舒媚	2004/09/18	20,000	0.03%	0	0%	0	0%	學歷: ■英國瑞汀大學(ISMA)風險管理碩士 ■台灣大學會計學士 經歷: ■勤業眾信聯合會計師事務所副理	■本公司 BVI 子公司董事	無	無	無

(三) 最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 董事(含獨立董事)之酬金：

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金												A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)(註 1)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		盈餘分配員工紅利(G)(註 2)				員工認股權憑證得認購股數(H)		取得限制員工權利新股股數(I)				
																本公司		財務報告內所有公司								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	關建英 Kwan, Kinying	5,099	6,756	0	0	4,228	4,228	2,546	2,546	5.62%	6.41%	4,008	5,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.52%	9.06%	0
董事	張國威																									
董事	Ng, Benjamin Jin-Ping																									
董事	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin																									
獨立董事	洪茂蔚																									
獨立董事	江善頌																									
獨立董事	莊彬甫																									

註 1:本公司董事會於 2015 年 3 月 5 日決議，擬分配之董事酬金計新台幣 4,228 仟元，此為暫估數字。

註 2:本公司董事會於 2015 年 3 月 5 日決議,擬議分配之員工紅利計新台幣 13,145 仟元,俟 2015 年 6 月 12 日股東會決議通過後進行作業。

截至本年報刊印日止，詳細分配各員工之紅利數目尚無決議。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 I	本公司	財務報告內所有公司 J
低於 2,000,000 元	張國威、Ng, Benjamin Jin-Ping、洪茂蔚、江善頌、莊彬甫、沈翔霖	張國威、Ng, Benjamin Jin-Ping、洪茂蔚、江善頌、莊彬甫、沈翔霖	張國威、Ng, Benjamin Jin-Ping、洪茂蔚、江善頌、莊彬甫	張國威、Ng, Benjamin Jin-Ping、洪茂蔚、江善頌、莊彬甫
2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	關建英	關建英	關建英、沈翔霖	關建英、沈翔霖
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7	7	7	7

2. 監察人之酬金：本公司未設置監察人，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金：

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		盈餘分配之員工紅利金額(D)(註 1)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		取得員工認股權憑證數額(仟股)		取得限制員工權利新股股數		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
								現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額							
總經理	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	16,016	32,285	-	628	0	0	0	0	0	0	7.58%	15.58%	546.75	546.75	0	0	0
日本營運處 General Manager	藤田 浩三																	
日本營運處 Deputy General Manager	保坂 純一郎																	
亞太營運處 General Manager	湯治華																	
系統單晶片設計處 VP	鄭永力																	
行銷企劃處 VP	姜榮華																	
財務長	王德善																	
Financial Controller	詹舒媚																	

註 1:本公司董事會於 2015 年 3 月 5 日決議,擬議分配之員工紅利計新台幣 13,145 仟元,俟 2015 年 6 月 12 日股東會決議通過後進行作業。截至本年報刊印日止，詳細分配各員工之紅利數目尚無決議。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元	藤田 浩三/保坂 純一郎/湯治華/姜榮華/王德善/詹舒媚	-
2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	沈翔霖/鄭永力	鄭永力/保坂 純一郎/湯治華/姜榮華/王德善/詹舒媚
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	-	沈翔霖/藤田 浩三
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	8	8

4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：

2014 年 12 月 31 日;單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經	總經理	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	0	0	0	0%
	日本營運處 General Manager	藤田 浩三				
	日本營運處 Deputy General Manager	保坂 純一郎				
理	亞太營運處 General Manager	湯治華				
	系統單晶片設計處 VP	鄭永力				
	行銷企劃處 VP	姜榮華				
	財務長	王德善				
人	Financial Controller	詹舒媚				

註 1:本公司董事會於 2015 年 3 月 5 日決議，擬議分配之員工紅利計新台幣 13,145 仟元，俟 2015 年 6 月 12 日股東會決議通過後進行作業。截至本年報刊印日止，詳細分配各員工之紅利數目尚無決議。

(四) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占合併稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

1. 本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占合併稅後純益比例之分析：

項目	酬金總額占合併稅後純益比例			
	2013 年度		2014 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	8.18%	8.18%	7.52%	9.06%
總經理及副總經理	32.26%	32.26%	7.58%	15.58%

2. 給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

(1) 董事之酬金，係根據其在本公司擔任之職位及對本公司營運參與程度及貢獻之價值核發。

(2) 總經理及副總經理之酬金，係根據職位、對公司的貢獻度及參考同業水準，依本公司人事規章辦理。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

本公司 2014 年度及截至年報刊印日止，董事會共開會 10 次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(B/A)(%)	備註
董事長	關建英 Kwan, Kinying	9	1	90%	
董事	張國威	10	0	100%	
董事	Ng, Benjamin Jin-Ping	5	5	50%	
董事	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	10	0	100%	
獨立董事	洪茂蔚	10	0	100%	
獨立董事	江善頌	8	2	80%	
獨立董事	莊彬甫	9	1	90%	

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

本公司先後於 2010 年及 2011 年成立審計委員會及薪酬委員會，並依審計委員會組織規程及薪資報酬委員會組織規程協助董事會執行其職責。

(二) 審計委員會運作情形資訊：

2014 年度及截至年報刊印日止，審計委員會開會 9 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
獨立董事	洪茂蔚	9	0	100%	
獨立董事	江善頌	8	1	89%	
獨立董事	莊彬甫	9	0	100%	

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

內部稽核主管定期呈交稽核報告予各獨立董事查閱，並於每季的董事會議中報告稽核執行情形，若有特殊狀況時，內部稽核主管將即時通知審計委員會委員。

本公司簽證會計師於2015年3月5日的審計委員會中報告2014年度財務報告查核結果以及其他相關法令要求之溝通事項，獨立董事與會計師溝通狀況良好。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」及考量公司運作及實際需要，訂定「公司治理實務守則」，根據各相關法規確實執行，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	尚無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
1. 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		1.由發言人負責處理股東之建議或糾紛等問題，並協調公司相關單位執行。	尚無重大差異。
2. 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形。	V		2.透過股務代理機構可提供實際資訊，本公司依法規定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單。	尚無重大差異。
3. 公司是否建立、執行與關係企業險控管機制及防火牆機制？	V		3.本公司訂有「集團、特定公司及關係人交易作業程序」，明確劃分與各關係企業間之人員、資產、財務管理權責，各關係企業間建立獨立之財務系統，並經內部檢核機制，確實執行風險控管及防火牆機制。	尚無重大差異。
4. 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		4.本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」，並定期向公司內部人適時提供教育宣導。	尚無重大差異。

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責				
1. 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？		V	1.本公司設有七席董事，其中三席為獨立董事且依照「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理，目前尚未擬定董事會成員組成多元化方針。	本公司尚未擬定董事會組成多元化方針。
2. 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？		V	2.本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，尚未設置其他各類功能性委員會。	本公司未設置其他各類功能性委員會。
3. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？		V	3.本公司董事會皆遵循「公開發行公司董事會議事辦法」規定辦理，目前尚未訂定董事會績效評估辦法及其績效評估。	本公司尚未訂定董事會績效評估辦法及其績效評估。
4. 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		4.本公司每年定期檢視會計師之獨立性，檢查其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人。另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避。會計師之輪調亦遵守相關規定辦理。	尚無重大差異。
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？		V	設有專責單位及人員與利害關係人之溝通管道暢通，隨時掌握資訊維護雙方合法、合理權益，目前正規畫公司網站設置利害關係人專區。	本公司尚未於公司網站設置利害關係人專區。
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司股務委任中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。	尚無重大差異。

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、資訊公開				
1. 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形？	V		1.本公司已設有中英文網站(http://www.alchip.com)，公司相關資訊將持續揭露，另外，本公司亦於公開資訊觀測站揭露相關財務業務及公司治理等資訊。	尚無重大差異。
2. 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		2.本公司已架設英文網站，設有專責人員負責資訊蒐集及揭露工作，包括法說會資訊等，並依規定設有發言人。	尚無重大差異。
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		1.本公司制定並執行符合政府勞工、福利及安全衛生法令之相關規定，保障員工權益並關懷雇員生活。 2.依公開發行公司相關法令規定揭露本公司營運及財務狀況供投資人瞭解，並妥善處理投資人各項詢問，以維持良好之投資人關係。 3.公司每年安排主管機關指定之訓練機構至本公司提供訓練課程予董事及獨立董事進修。 4.公司每年為董事及獨立董事購買責任保險，降低可能造成風險之損失。	尚無重大差異。
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形）		V	本公司尚無委託其他專業機構進行評鑑，而依照本公司董事會、內部控制、內部稽核及資訊揭露等事宜均已依照「上市上櫃公司治理實務守則」之精神推動及運作。	視實際經營狀況適時辦理。

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。本公司薪酬委員會共有三名成員，由三位獨立董事組成。本屆委員任期自2013 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 27 日止。

薪資報酬委員會成員資料

身份別（註1）	條件 / 姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註2）								兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註（註3）
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	洪茂蔚	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	江善頌			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	莊彬甫			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。

（2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。

（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

（7）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（8）未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

薪資報酬委員會運作情形資訊

薪酬委員會主席洪茂蔚教授於 2014 年度及截至年報刊印日止共召開 4 次常會，薪酬委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
獨立董事	洪茂蔚	4	0	100%	
獨立董事	江善頌	4	0	100%	
獨立董事	莊彬甫	4	0	100%	

(五) 履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。

項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、落實推動公司治理				
1.公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	V		1.本公司已制訂「企業社會責任實務守則」，並依循守則辦理本公司社會責任相關事務。	尚無重大差異。
2.公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	V		2.本公司定期推動教育訓練課程及宣導事項，目前已將部分列入績效考核中，爾後將持續推動及改進，使倫理教育與獎勵及懲戒制度能緊密結合。	尚無重大差異。
3.公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V		3.本公司將由行政管理處負責推動企業社會責任之運作，定期向總經理報告執行狀況，並匯整年度總執行報告呈報董事會。	尚無重大差異。
4.公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將其與員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵及懲戒制度？		V	4.目前尚未將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，未來將持續朝此方向進行規畫，結合員工績效落實公司企業社會責任政策。	未來將持續朝此方向進行規畫，結合員工績效落實公司企業社會責任政策。

項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、發展永續環境				
1.公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		1.本公司主要提供客戶之委託設計服務，後段量產工程解決方案皆為委外代工，包含晶圓製造、封裝、測試，所以並無其他生產設備，亦無其他之工業污染。	尚無重大差異。
2.公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		2.由於本公司並無工業之汙染，因此將著重於持續與員工進行環保節能之宣導，減少生活廢棄物達成節能減碳之目標。	尚無重大差異。
3.公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	V		3.本公司之主要營運活動並未直接對環境造成汙染，在產品開發方向，致力提供及發展低功耗及小尺寸之晶片設計，以符合現在節能減碳之環保趨勢。	尚無重大差異。
三、維護社會公益				
1.公司是否依照遵守相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		1.本公司依各子公司所在地之相關勞動法令之規定辦理員工相關福利及訂定管理程序，以保障員工之合法權益。	尚無重大差異。
2.公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	V		2.本公司設有申訴專用信箱，並由人力資源部主管負責員工申訴處理。	尚無重大差異。
3.公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		3.本公司提供員工安全及健康之工作環境，並定期對員工進行健康檢查及工作環境安全教育，以預防職業災害。	尚無重大差異。

項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
4.公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	V		4.本公司定期舉辦勞資會議，針對公司營運方針及現況對員工說明，員工也可藉由此管道表達對公司營運相關之疑問及建議。	尚無重大差異。
5.公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		5.本公司針對每位員工，依其工作屬性及專長，由部門主管負責其職涯規劃及相關訓練之執行。	尚無重大差異。
6.公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		6.本公司品保單位設有「品質政策」及「顧客滿意度及顧客抱怨程序書」，以確保消費者權益。	尚無重大差異。
7.對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	V		7.本公司對產品及服務之行銷及標示，係依照我國及客戶當地相關法規及國際準則遵循。	尚無重大差異。
8.公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	V		8.本公司品質系統處與供應商來往前，會瞭解供應商過去有無影響環境與社會之紀錄，且已於本年度將此紀錄納入供應商評估當中。	尚無重大差異。
9.公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V		9.本公司與主要供應商並無簽訂契約之情形，若未來有簽訂契約之需要將視需求添加。	尚無重大差異。
四、加強資訊揭露				
1.公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V		1.本公司設有發言人以及在中華民國境內設有訴訟及非訴訟代理人，並	尚無重大差異。

項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			依法規定誠實公開公司資訊，以期提供利害關係人高透明度之資訊。	
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已制訂「企業社會責任實務守則」，並依循此守則辦理本公司社會責任相關事務。				
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： 本公司於2008年取得世界級公司Green Partner(綠色夥伴)認證，擔任其綠色供應鏈之合作夥伴，未來仍將不斷地努力，持續提供品質優異之環保產品，善盡世界公民應有之環境責任。				
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。				

(六) 落實誠信經營情形：本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作，已制訂「誠信經營作業程序及行為指南」，並依循辦理相關事務。

項　　目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
1.公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層承諾積極落實經營政策之承諾？	V		1.本公司業依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露本公司誠信經營政策。	尚無重大差異。
2.公司是否訂定防範不誠信行為方案並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	V		2.本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中明確規範「提供或收受不正當利益」、「禁止疏通費」、「禁止提供非法政治現金」、「禁止不當慈善捐贈或	尚無重大差異。

項　　目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			贊助」。為塑造高度誠信經營理念，本公司定期舉辦教育訓練課程，提升同仁誠信及自律觀念，以落實執行。	
3.公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V		3.本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中明確規範「禁止提供或收受不正當利益」、「禁止疏通費」、「禁止提供非法政治獻金」、「禁止不當慈善捐贈或贊助」之相關防範措施。	尚無重大差異。
二、落實誠信經營				
1.公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		1.本公司與他人建立商業關係前，均先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄。另，本公司與他人簽訂契約時，均充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款。	尚無重大差異。
2.公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	V		2.本公司指定稽核部為專責單位辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告。	尚無重大差異。
3.公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		3.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明確要求董事對董事會所列	尚無重大差異。

項　　目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			議案有利害關係者，得陳述意見及答詢，討論及表決時應予以迴避；本公司同仁於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，須將相關情事同時陳報直屬主管及本公司稽核部，且直屬主管應提供適當指導。	
4.公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	V		4.本公司會計制度係參照公司法、證券交易法、證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋、解釋公告等相關法令規定，並依本公司業務實際情形訂定；內部控制係參照公開發行公司建立內控控制制度處理準則訂定，均落實執行。本公司「誠信經營作業程序及行為指南」並明確要求稽核室定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。	尚無重大差異。
5.公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		5.本公司定期對員工進行誠信經營之宣導及教育訓練。	尚無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
1.公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專	V		1.本公司將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有	尚無重大差異。

項　　目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
責人員？			效之獎懲及申訴制度，若員工有申訴情形，則可透過郵件(E-Mail)向專責人員反應，公司將直接處理並依法採取適當之保護措施以保護個人資料及隱私。	
2.公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	V		2.本公司已建立檢舉機制，不論內部或外部人員皆可舉報任何不法的行為，並由專人負責處理。	尚無重大差異。
3.公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		3.本公司針對提出檢舉的人員皆採保密機制，禁止揭露任何檢舉人之相關資料，以保護檢舉人不因檢舉不法而受到處置。	尚無重大差異。
四、加強資訊揭露 1.公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已設有中英文網站(http://www.alchip.com)，且持續揭露最近期財務報表、公司治理運作情形及其他法定公開揭露事項等。	尚無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：詳上述各欄。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之規範，以提升本公司誠信經營之成效。				

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：相關規章可參閱公開資訊觀測站。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：詳第 34 頁。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：詳第 35 頁。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：詳第 36~38 頁。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事及獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總：無此情形。

四、 會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	王儀雯	黃樹傑	103.1.1.~103.12.31	

單位：新臺幣仟元

金額級距 ＼ 公費項目		審計公費	非審計公費	合 計
1	低於 2,000 仟元	-	-	-
2	2,000 仟元（含）～4,000 仟元	-	-	-
3	4,000 仟元（含）～6,000 仟元	5,546	5,553	11,099
4	6,000 仟元（含）～8,000 仟元	-	-	-
5	8,000 仟元（含）～10,000 仟元	-	-	-
6	10,000 仟元（含）以上	-	-	-

公司有下列情事之一者，應揭露下列事項：

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓 名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備 註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小 計		
勤業眾信聯合會計師事務所	王儀雯	5,546	-	-	-	5,553	5,553	103.1.1.~103.12.31	上市輔導費、移轉訂價費用及內控審查費用
	黃樹傑								

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、 更換會計師資訊：2014 年更換會計師係因勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整。

六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或關係企業：無。

七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位: 股

職稱	姓　名	2014 年度		2015 年截至 04 月 14 日止	
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長	關建英 Kwan, Kinying	(40,000)	0	0	0
董事	張國威	0	0	0	0
董事	Ng, Benjamin Jin-Ping	0	0	0	0
獨立董事	洪茂蔚	0	0	0	0
獨立董事	江善頌	0	0	0	0
獨立董事	莊彬甫	0	0	0	0
總經理/董事	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	(40,000)	0	0	0
日本營運處 General Manager	藤田 浩三	0	0	0	0
日本營運處 Deputy General Manager	保坂 純一郎	10,000	0	0	0
亞太營運處 General Manager	湯治華	20,000	0	0	0
晶片設計工程處 VP	鄭永力	(51,725)	0	0	0
行銷企劃處 VP	姜榮華	20,000	0	0	0
財務長	王德善	20,000	0	0	0
Financial Controller	詹舒媚	20,000	0	0	0
大股東	SB Asia Infrastructure Fund L.P.	(521,000)	0	0	0
大股東	英屬開曼群島商旭揚半導體 II 創業投資股份有限公司	(939,000)	0	0	0

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊：

單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
SB Asia Infrastructure Fund L.P.	12,408,292	19.46%	0	0	0	0	Cisco Systems International B.V.	最終母公司相同	
英屬開曼群島商旭揚半導體 II 創業投資股份有限公司	6,581,092	10.32%	0	0	0	0	-	-	
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	2,558,978	4.01%	0	0	0	0	-	-	
Cisco Systems International B.V.	1,952,379	3.06%	0	0	0	0	SB Asia Infrastructure Fund L.P.	最終母公司相同	
呂善仕	1,539,000	2.41%	30,000	0.05%	0	0	-	-	
英屬維京群島商創義貳創業投資股份有限公司	1,449,207	2.27%	0	0	0	0	英屬維京群島商創義壹投資股份有限公司	董事一位相同	
英屬維京群島商創義壹投資股份有限公司	1,312,334	2.06%	0	0	0	0	英屬維京群島商創義貳創業投資股份有限公司	董事一位相同	
中國信託商業銀行受託保管健堡控股有限公司投資專戶	1,167,881	1.83%	0	0	0	0	-	-	
Shen,Johnny Shyang-Lin	941,652	1.48%	0	0	0	0	-	-	
中國信託商業銀行受託保管環球之星投資公司投資專戶	723,262	1.13%	0	0	0	0	-	-	

九、 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

2014 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Alchip(HK)	11,831,970,100	100%	-	-	11,831,970,100	100%
Alchip(US)	391,000,000	100%	-	-	391,000,000	100%
Alchip (JP)	2,000	100%	-	-	2,000	100%
Alchip(TW)	25,000,000	100%	-	-	25,000,000	100%
Alchip (SH)	(註 1)	100%	-	-	(註 1)	100%
Alchip(Wuxi)	(註 1)	100%			(註 1)	100%

註 1：Alchip(SH)及 Alchip(Wuxi)係有限公司，故未發行股份。

Alchip Technologies, Limited

內部控制制度聲明書

日期：2015 年 3 月 5 日

本公司 2014 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於2014年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司2015年3月5日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

Alchip Technologies, Limited
(英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司)

董事長：關建英 簽章

總經理：沈翔霖 簽章

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

內部控制制度審查報告

後附英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司民國 104 年 3 月 5 日謂經評估認為其與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 103 年 12 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師審查竣事。維持有效之內部控制制度及評估其有效性係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據審查結果對公司內部控制制度之有效性及上開公司之內部控制制度聲明書表示意見。

本會計師係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及一般公認審計準則規劃並執行審查工作，以合理確信公司上述內部控制制度是否在所有重大方面維持有效性。此項審查工作包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之意見提供合理之依據。

任何內部控制制度均有其先天上之限制，故英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制有效性判斷項目判斷，英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 103 年 12 月 31 日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性；英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司於民國 104 年 3 月 5 日所出具謂經評估認為其上述與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王儀雯

會計師 黃樹傑

中華民國 104 年 3 月 5 日

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

董事會決議事項：

1. 2014 年 3 月 7 日董事會重要決議如下：

案由一：核認本公司至 2013 年底的合併財務報告承認案。

案由二：核認本公司民國 102 年度盈餘分配案。

案由三：討論本公司 2014 股東常會議事手冊。

案由四：核認本公司內部控制制度聲明書。

案由五：核認本公司內控相關辦法修訂案。

案由六：討論本公司修訂章程案。

案由七：討論本公司修訂「衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業程序」、「背書及保證作業程序」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及其他治理辦法案。

案由八：討論本公司股票上市櫃後首次公開承銷，原股東放棄認購案。

案由九：核認本公司會計師更換案。

案由十：討論本公司董事薪酬案。

案由十一：討論本公司經理人薪酬案。

案由十二：核認本公司 OBU 帳戶開設案。

案由十三：討論本公司衍生性金融商品交易額度。

案由十四：討論本公司在中國信託商業銀行開立集合帳戶案。

案由十五：討論本公司與 TSMC 之背書保證合約展延案。

案由十六：討論本公司召集股東常會案。

臨時動議

案由一：討論本公司股票交易限制期間與 2010 員工認股權憑證發行及認股辦法修正案。

2. 2012 年 5 月 26 日董事會重要決議如下：

案由一：核認本公司 2014 年第一季財務報表。

案由二：討論本公司為申請第一上市案審議用之 2014 年第 2 季~第 3 季簡式財務預測案。

案由三：核認本公司內部控制聲明書。

案由四：討論本公司簽訂過額配售及價格穩定協議書案。

案由五：討論本公司擬辦理現金增資發行新股以供股票初次第一上市公開承銷案。

案由六：討論本公司擬向臺灣證券交易所提出第一上市申請案。

案由七：討論本公司申請綜合授信額度。

案由八：討論本公司擬調整董事每月車馬費補助案。

3. 2014 年 8 月 1 日董事會重要決議如下：

案由一：核認本公司 2014 年上半年財務報表案。

案由二：討論訂定本公司配發現金股利基準日等相關作業案。

案由三：討論世芯電子(上海)有限公司提供定存質押設定予上海渣打銀行案案。

案由四：討論本公司在台北富邦銀行開立新台幣帳戶案。

案由五：討論本公司設立台灣分公司案。

4. 2014 年 10 月 27 日董事會重要決議如下：

案由一：核認本公司 2014 年第三季財務報表案。

案由二：討論本公司擬訂 2015 年稽核計畫案。

案由三：討論本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」增訂及修正案。

案由四：討論台灣分公司在渣打銀行開立銀行存款帳號案。

5. 2015 年 1 月 5 日臨時董事會重要決議如下：

案由一：討論本公司擬投資 KnC Group AB 案。

案由二：討論本公司擬成立 Alchip BVI 公司案。

6. 2015 年 2 月 25 日董事會重要決議如下：

案由一：討論本公司於富邦證券開立 FINI 帳戶案。

7. 2015 年 3 月 5 日董事會重要決議如下：

案由一：核認本公司 2014 年度合併財務報表案。

案由二：核認本公司 2014 年度盈餘分配案。

案由三：討論本公司 2015 年股東常會議事手冊大綱及 2014 年營業報告書案。

案由四：討論修正本公司 2015 年度稽核計劃案。

案由五：核認本公司內部控制聲明書。

案由六：討論本公司「內部控制制度」修正案。

案由七：討論修訂本公司章程案。

案由八：討論本公司董事每月車馬費補助案。

案由九：討論本公司高階經理人薪酬案。

案由十：討論本公司追認董事案。

案由十一：討論本公司擬辦理第一次買回本公司股份並辦理註銷案。

案由十二：討論本公司擬發行 2015 年第一次員工認股權憑證案。

案由十三：討論本公司擬訂 2015 年股東常會日期及議程。

案由十四：討論本公司於台北富邦銀行香港分行開立帳戶案。

股東會決議事項及執行情形：

1. 2014 年 6 月 28 日股東會：

項次	決議事項	執行情形
案由一	核認本公司民國 102 年度營業報告書	決議通過
案由二	核認本公司審計委員會審查民國 102 年度決算表冊報告	決議通過
案由三	核認修訂董事會議事規則案	決議通過
案由四	承認本公司民國 102 年度營業報告書及財務報表案	決議通過
案由五	承認本公司民國 102 年度盈餘分配案	業依股東會決議完成股利分配
案由六	討論修訂公司章程案	業依修訂後之章程辦理。
案由七	討論修訂衍生性商品交易處理程序案	業依修訂後之處理程序辦理。
案由八	討論修訂取得或處分資產處理程序案	業依修訂後之處理程序辦理。
案由九	討論修訂資金貸與他人作業程序案	業依修訂後之作業程序辦理。
案由十	討論修訂背書及保證作業程序案	業依修訂後之作業程序辦理。
案由十一	討論修訂股東會議事規則案	業依修訂後之議事規則辦理。
案由十二	討論修訂董事選舉辦法案	業依修訂後之辦法辦理。
案由十三	討論擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷之現金增資優先認股權利案	決議通過

肆、 募資情形

一、 資本及股份、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形

(一) 股本來源：

單位：股/金額除另有註明外，係新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
2010.07	10	100,000,000	1,000,000,000	52,420,842	523,364,710	資本公積轉增資	無	-
2010.07	10	100,000,000	1,000,000,000	53,871,342	538,713,420	行使認股權發行新股	無	-
2013.11	10	100,000,000	1,000,000,000	53,947,342	539,473,420	行使認股權發行新股	無	-
2014.03	10	100,000,000	1,000,000,000	54,113,342	541,133,420	行使認股權發行新股	無	-
2014.04-08	10	100,000,000	1,000,000,000	54,753,342	547,533,420	行使認股權發行新股	無	-
2014.09	10	100,000,000	1,000,000,000	54,784,842	547,848,420	行使認股權發行新股	無	-
2014.10-12	10	100,000,000	1,000,000,000	62,465,842	624,658,420	現金增資發行新股	無	-
2014.10-12	10	100,000,000	1,000,000,000	63,481,815	634,818,150	行使認股權發行新股	無	-
2015.01-03	10	100,000,000	1,000,000,000	63,766,815	637,668,150	行使認股權發行新股	無	-

註：2010年7月以前股本形成如下：

單位：股/金額除另有註明外，係新台幣元

年月	核定股本	實收股本				備註		
	股數	股數	換股比例	發行股數	發行金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
普通股股本：								
2003 年 2 月 27 日	100,000,000	4,850,500	1:1	9,067,502	美元 $4,533.75	設立股本	無	—
2005 年		2,025,374				行使認股權發行新股	無	—
2006 年		640,194				行使認股權發行新股	無	—
2007 年		315,188				行使認股權發行新股	無	—
2008 年		623,246				行使認股權發行新股	無	—
2009 年		14,000				行使認股權發行新股	無	—

2010 年 7 月 9 日前		599,000				行使認股權發行新股	無	—
特別股股本：(註 2)								
2003 年 2 月(註 1)	2,500,000	1,250,000	1:1.08	1,346,914	美元 $673.46	發行 A 系列特別股	無	—
2003 年 4，5，8 月	11,500,000	8,750,000	1:1.08	12,071,574	美元 $6,035.79	發行 B 系列特別股	無	—
2008 年 4，5 月		2,452,991				發行 B 系列特別股	無	—
2004 年 10 月	10,052,000	10,052,000	1:1.08	10,831,346	美元 $5,415.67	發行 C 系列特別股	無	—
2009 年 2，9，10 月	666,666	480,770	1:1.08	519,231	美元 $259.61	發行 C-1 系列特別股	無	—
2006 年 3 月	3,864,668	3,864,668	1:1.5	5,806,705	美元 $2,903.35	發行 D 系列特別股	無	—
2006 年 3 月	3,099,616	3,099,616	1:2.19	6,777,570	美元 $3,388.78	發行 D-1 系列特別股	無	—
2010 年 6 月	6,000,000	6,000,000	1:1	6,000,000	美元 $3,000	發行 E 系列特別股	無	—
2010 年 7 月 9 日股東會通過以新台幣$32.19 元對美元$1 之匯率進行轉換，並於 2010 年 7 月 9 日生效，每股面額由美元$0.0005 變更為新台幣$10 元。								

註 1：A 系列特別股原始發行股數為 5,000,000 股，其中 2,500,000 股於 2004 年 10 月轉為 C 系列特別股，另 1,250,000 股於 2006 年 3 月轉為 D/D-1 系列特別股。

註 2：特別股股本已全數於 2010 年 6 月 30 日轉換為普通股。

2015 年 04 月 14 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	63,766,815	31,033,168	100,000,000	

總括申報制度相關資訊：不適用。

有價證券種類	預定發行數額		已發行數額		已發行部分之發行目的及預期效益	未發行部分預定發行期間	備註
	總股數	核准金額	股數	價格			
無							

(二) 股東結構：

2015年04月14日；單位：股

股東結構 / 數量	政府機構	金融機構	庫藏股	其他法人	個人	外國機構及外人	合　計
人數	0	1	1	23	4,926	50	5,001
持有股數（股）	0	281,000	60,000	436,000	28,687,426	34,302,389	63,766,815
持股比例（%）	0%	0.44%	0.09%	0.68%	44.99%	53.80%	100.00%

註：陸資持股比例為零。

(三) 股權分散情形：

每股面額 NT$10 元；2015 年 04 月 14 日；單位：股

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	96	15,825	0.02%
1,000 至 5,000	3,840	7,832,071	12.28%
5,001 至 10,000	539	4,241,210	6.65%
10,001 至 15,000	135	1,731,933	2.72%
15,001 至 20,000	130	2,409,744	3.78%
20,001 至 30,000	94	2,459,752	3.86%
30,001 至 40,000	52	1,875,652	2.94%
40,001 至 50,000	20	917,025	1.44%
50,001 至 100,000	50	3,411,593	5.35%
100,001 至 200,000	21	2,772,500	4.35%
200,001 至 400,000	7	1,889,287	2.96%
400,001 至 600,000	5	2,221,146	3.48%
600,001 至 800,000	3	2,078,262	3.26%
800,001 至 1,000,000	1	941,652	1.48%
1,000,001 以上	8	28,969,163	45.43%
合計	5,001	63,766,815	100.00%

(四) 主要股東名單：列明持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

2015年04月14日；單位：股

股份 / 主要股東名稱	持有股數	持股比例
SB Asia Infrastructure Fund L.P.	12,408,292	19.46%
英屬開曼群島商旭揚半導體II創業投資股份有限公司	6,581,092	10.32%
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	2,558,978	4.01%
Cisco Systems International B.V.	1,952,379	3.06%
呂善仕	1,539,000	2.41%
英屬維京群島商創義貳創業投資股份有限公司	1,449,207	2.27%
英屬維京群島商創義壹投資股份有限公司	1,312,334	2.06%
中國信託商業銀行受託保管健堡控股有限公司投資專戶	1,167,881	1.83%
Shen,Johnny Shyang-Lin	941,652	1.48%
中國信託商業銀行受託保管環球之星投資公司	723,262	1.13%

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：新台幣元：仟股

項目 \ 年度			2013 年度	2014 年度	當年度截至 2015 年 4 月 16 日
每股市價	最高		73.88	149.99	109.00
	最低		19.40	58.5	53.60
	平均		49.66	106	78.26
每股淨值	分配前		30.70	43.77	-
	分配後		30.52	(註 2)	-
每股盈餘	加權平均股數		53,878	56,021	-
	每股盈餘		2.10	3.77	-
每股股利	現金股利		0.18066	0.6282(註 1 及 2)	-
	無償配股	盈餘配股	-	-	
		資本公積配股	-	-	
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析	本益比(註3)		23.65	28.12	-
	本利比(註4)		274.88	(註 2)	-
	現金股利殖利率(註5)		0.36%	(註 2)	-

註 1：現金股利係依 2015 年 3 月 5 日董事會前一日美元兌新臺幣匯率(USD$1:31.41)計算。

註 2：2014 年度之盈餘尚未經股東會決議分配。

註 3：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 4：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 5：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

(六) 公司股利政策及執行狀況：

1. 本公司股利政策：依本公司之公司章程規定，關於股利發放之規定如下：

(1) 本公司得依董事會擬訂並經股東會以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫：本公司應依法提撥應繳納之稅款並就年度淨利先彌補歷年虧損。其次，依公開發行公司法令規定提撥法定盈餘公積，並依公開發行公司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積；並得提撥不超過所餘利潤之 2%作為董事酬勞以及不低於所餘利潤之 1%作為員工紅利，該員工紅利得按照依第 11.1 條規定同意之員工激勵計畫配發。董事會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工之紅利之成數，股東得於決議同意前修改該提案。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公司員工之紅利。任何所餘利潤除法令及公開發行公司法令另有規定外，公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之期待，就可分配盈餘擬定利潤分配計畫，提報股東會決議，盈餘之分派得以現金股利或股票股利（盈餘轉增資按比例分配股份予股東）之方式為之，股利總額至少應為當年度盈餘扣除上述規定之百分之十（10%），其中現金股利發放總額不得低於發放股東股利總額之 10%，最高以 100%為上限。

(2) 在不違反法令、章程及公開發行公司法令的情形下，董事會得公告股利和每股盈餘，並以公司於法律上可動用的資金支付股利或利益分派。除以公司已實現或未實現利益、股份發行溢價金額或法令允許的其他款項支付股利或為利潤分派外，不得支付股利或為利潤分派。

(3) 除另有相關約定外，應根據股東持股比例分派股利。如果股份發行的條件是從某一特定日期開始計算股利，則該股份之股利應依此計算。

(4) 股東如應向公司支付款項，董事會得從應支付予該股東的股利或利潤分派中扣除之。

(5) 董事會於經股東會之普通決議通過後，得宣佈以特定資產作為全部或部分股利之分派（特別是其他公司之股份、債券或證券），或以其中一種或多種方式支付，如分配發生困難時，董事會得以適當、有效率的方式解決，並確定就特定資產分配之價值或其一部之價值，且得決定依所確定價值向股東支付現金以調整股東的權利；如董事會認為適當有效率者，得就上述特定資產設立信託。

(6) 任何股利、分派、利息或與股份有關的其他現金支付，得匯款轉帳給股東，或以支票或認股憑證郵寄到股東的登記地址。每一支票或認股憑證應依收件人的指示支付。

(7) 任何股利或分派不得向公司要求加計利息。

(8) 不能支付予股東的股利及/或在股利公告日起六個月後仍無人主張的股利，得依董事會的決定，支付到以公司名義開立的獨立帳戶，但公司不得成為該帳戶的受託人，且該股利仍為應支付給股東的債務。如於股利公告日起六年之後仍無人請求的股利，將被認定為股東已拋棄其得請求之權利，該股利並轉歸公司所有。

2. 本次股東會擬議股利分配情形：

本公司已於 2015 年 3 月 5 日董事會通過 2014 年盈餘分配案，並提請 2015 年 6 月 12 日股東常會承認其分配情形如下表所示：

世芯電子股份有限公司
2014 度年盈餘分派表

單位：美金元

2014 年度期初未分配盈餘	13,031,484
本期稅後盈餘(註)	6,968,495
本期可供分配盈餘	19,999,979
分配項目	
現金股利（每股配發美金 0.02 元）	(1,275,336)
2014 年度期末未分配盈餘	18,724,643

註: 2014 稅後盈餘已扣除員工現金紅利美金 418,500 元及董監酬勞美金 139,500 元

(七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(八) 員工分紅及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：按本公司章程所訂定股利政策執行，詳見(六)1.之說明。
2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 2014 年度員工紅利及董事酬勞之估列金額分別為美金 418,500 元及 139,500 元，係分別按稅後淨利之 6%及 2%計算。年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過擬議配發員工分紅等資訊：
   (1) 董事會通過之擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額，若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無。
   (2) 董事會通過之擬議配發員工股票紅利金額占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：無。
   (3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：新台幣 3.77 元。
4. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司 2013 年度配發員工紅利及董事、監察人酬勞，實際配發情形與估列並無差異。

(九) 公司買回本公司股份情形：本公司於 2015 年 3 月 5 日董事會通過買回本公司已發行股份並註銷，相關事項如下：

2015 年 4 月 16 日

買回期次（註）	第 1 次（期）
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回期間	2015 年 3 月 6 日至 2015 年 5 月 5 日
買回區間價格	50.05 元至 123.82 元
已買回股份種類及數量	普通股 60 仟股
已買回股份金額	新台幣 3,942 仟元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	普通股 60 仟股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）	0.09%

(十) 公司債辦理情形：本公司截至年報刊印日止無辦理公司債（含海外公司債）。

(十一) 特別股辦理情形：不適用。

(十二) 海外存託憑證辦理情形：本公司截至年報刊印日止無發行海外存託憑證。

(十三) 員工認股權證辦理情形：

1. 公司尚未屆期之員工認股權憑證

2015 年 03 月 31 日

員工認股權憑證種類	2003 年員工 認股權憑證(註 3)
申報生效日期	不適用
發行日期	(註 3)
發行單位數	14,518,700 單位
發行得認購股數占已 發行股份總數比率	22.77%
認股存續期間	認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿 10 年後~存續期間屆滿
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率（%）	屆滿一年得執行 25%，其後每月既得四 十八分之一之認股權
已執行取得股數	6,913,875 股
已執行認股金額	美金 8,085,478.07 元
未執行認股數量	1,471,027 股
未執行認股者其每股認購價格	平均美金 2.34 元
未執行認股數量占已發行 股份總數比率（%）	2.31%
失效之股數(註 1)	6,133,798 股
對股東權益影響	(註 2)

註 1：因員工離職而失效之股數。

註 2：於財務報表表達上，依國際會計原則處理，惟本公司之認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿一年之日起，可行使被給與 25%之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權，對原股東權益之影響係逐年稀釋；惟預估 2015 年底前可執行股數為 1,471,027 股，占目前流通在外普通股發行股數 63,766,815 股之 2.31%。

註 3：

(1) 2003 年員工認股權憑證辦法已於 2010 年 7 月經董事會修訂並取代前述辦法。

(2) 2003/04/09 發行 1,500,000 股；2003/06/06 發行 505,200 股；2003/08/08 發行 940,000 股；2003/10/13 發行 179,600 股；2003/12/22 發行 964,000 股；2004/04/02 發行 374,200 股；2004/06/18 發行 293,000 股；2005/01/14 發行 732,400 股；2005/04/15 發行 219,000 股；2005/07/15 發行 995,000 股；2005/12/16 發行 318,000 股；2006/01/17 發行 230,000 股；2006/04/20 發行 610,600 股；2006/07/31 發行 412,000 股；2006/10/18 發行 644,000 股；2007/01/29 發行 474,000 股；2007/04/27 發行 411,500 股；2007/09/21 發行 950,000 股；2007/10/19 發行 892,500 股；2008/01/25 發行 357,000 股；2008/04/29 發行 627,300 股；2008/07/25 發行 421,000 股；2008/10/30 發行 530,000 股；2009/02/05 發行 282,000 股；2009/04/24 發行 248,000 股；2009/07/31 發行 321,000 股；2009/10/30 發行 424,000 股；2010/01/15 發行 392,000 股；2010/05/07 發行 139,000 股。

2. 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

2015 年 03 月 31 日

	職稱	姓名	取得認股數量(仟股)	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量(仟股)	認股價格(美金元)	認股金額(美金仟元)	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量(仟股)	認股價格(美金元)	認股金額(美金仟元)	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	沈翔霖 Shen, Johnny Shyang-Lin	1,256	1.97%	709.25	0.994	705.08	1.11%	546.75	2.376	1,299.42	0.86%
	日本營運處 General Manager	藤田 浩三										
	日本營運處 Deputy General Manager	保坂 純一郎										
	亞太營運處 General Manager	湯治華										
	晶片設計工程處 VP	鄭永力										
	行銷企劃處 VP	姜榮華										
	財務長	王德善										
	Financial Controller	詹舒媚										
員工	中國資深財務及人事經理	蔡穎怡	1,896.5	2.97%	1,583	0.973	1,540.15	2.48%	313.5	2.467	773.5	0.49%
	晶片設計工程處協理	古園 博幸										
	商務拓展部協理	葛　星										
	設計平台研發部協理	黃建棋										
	產品量產管理部資深協理	古漢平										
	人力資源處協理	Le, Jennie										
	總經理特別助理	林志堅										
	矽智財規劃管理部協理	司徒健瑜										
	晶片設計工程處協理	高嶋 光也										
	首席研究員	韋華放										

3. 最近三年度及截至年報刊印日止，私募員工認股權憑證辦理情形：無。

(十四) 限制員工權利新股辦理情形：無此情形，故不適用。

(十五) 併購辦理情形：無此情形，故不適用。

(十六) 受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形，故不適用。

二、資金運用計劃執行情形，包括計畫內容及執行情形：

本公司本次辦理現金增資發行新股暨股票初次上市公開承銷，業於 103 年第四季募集完成，募集資金總額為新台幣 660,566 仟元。截至 103 年第四季止，因公司營運符合預期，實際支用金額為 660,566 仟元，實際執行進度為 100.00%。

計畫項目	執行狀況		
充實營運資金	支用金額	預定	660,566
		實際	660,566
	執行進度(%)	預定	100%
		實際	100%
合計	支用金額	預定	660,566
		實際	660,566
	執行進度(%)	預定	100%
		實際	100%

伍、 營運概況

一、 業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

世芯電子從事特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)及系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產業務，尤其擅長高複雜度、深次微米高階製程晶片。

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元；%

產品	2013 年度		2014 年度	
	金額	營業比重	金額	營業比重
ASIC 及晶圓產品	2,392,158	92.59%	4,402,453	93.83%
委託設計(ＮＲＥ)	166,164	6.43%	272,366	5.81%
其他	25,241	0.98%	16,922	0.36%
合計	2,583,563	100%	4,691,741	100%

3. 公司目前之商品（服務）項目

(1) ASIC 及晶圓產品：提供客戶特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)及系統單晶片(System on chip；SoC)之委託設計服務(Non-recurring engineering，NRE)與後端晶圓製造、封裝及測試之量產管理服務。

(2) 委託設計(Non-Recurring Engineering; NRE)：主要提供設計產品時所需的電路設計元件資料庫和各種矽智慧財產(SIP)，以及製作產品光罩組的電路圖，並委託代工廠生產光罩、晶圓、切割與封裝，再由本公司工程人員做產品測試後，交付試產樣品予客戶。

(3) 其他：僅提供客戶後端晶圓製造、封裝、測試的服務。

4. 計畫開發之新商品（服務）

本公司將持續致力於尖端的積體電路的研發與製造，以強化技術與保證服務品質，包含開發 SoC 所需之特殊客製化設計軟體工具，研發內部設計法則(Design Methodology)及先進設計技術; 根據不同的市場區隔，提供最有效的解決方案，並建立相應的平台與矽智財解決方案(包括: DDR/ LVDS/ OSC/ AFE/ USB/ PCIE)。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

隨著半導體製程技術的大幅躍進，晶片複雜度愈來愈高，半導體業宣告進入完全專業分工的時代。本公司為專門提供高複雜度、高產量特殊應用積體電路(ASIC)及系統單晶片(SoC)設計及製造服務的公司。所屬產業現況與發展分述如下：

(1) 無晶圓廠 ASIC(Fabless ASIC)之興起

過去系統公司選擇自行研發 ASIC/SoC，使其系統產品擁有差異化優勢以維持競爭力，或是委託可靠的 ASIC 合作夥伴(如 IBM、LSI Logic)，統包生產流程，包含設計、製造及封測等。然而，當製程技術進入深次微米世代後，技術研發、機器設備及廠房投資的花費快速攀升，現存大型的整合元件廠商(Integrated Design Manufacturer: IDM)無法負荷基礎設施的投資而被專業晶圓代工廠所超越，於是更多的系統公司開始將資源集中於產品的規格及前端設計，將後端設計及產品生產外包給專業的 Fabless ASIC 公司。

Fabless ASIC 公司藉由與策略夥伴(包括晶圓製造、封裝、測試廠)合作，提供從 RTL/Netlist 到晶片製造、封裝及測試等完整的解決方案，系統公司藉此享有更快速的產品上市時間、更低的成本與更專業的設計能力。

過去三年，半導體製造商加速企業重整及瘦身，整合元件廠商加速轉型成輕晶圓廠(Fab-lite)或無晶圓廠營運模式；根據 2014 年市場研究機構 IC Insights 的報告指出，過去五年內全球半導體共關閉 72 座晶圓廠，IDM 廠如今花不到營收的 10%作為資本支出，不願再揹負龐大的產能壓力；另全由無晶圓廠晶片業者 2013 年營收總和成長了 8%，顯示 Fabless ASIC 取代 IDM 市場趨勢加速轉變。

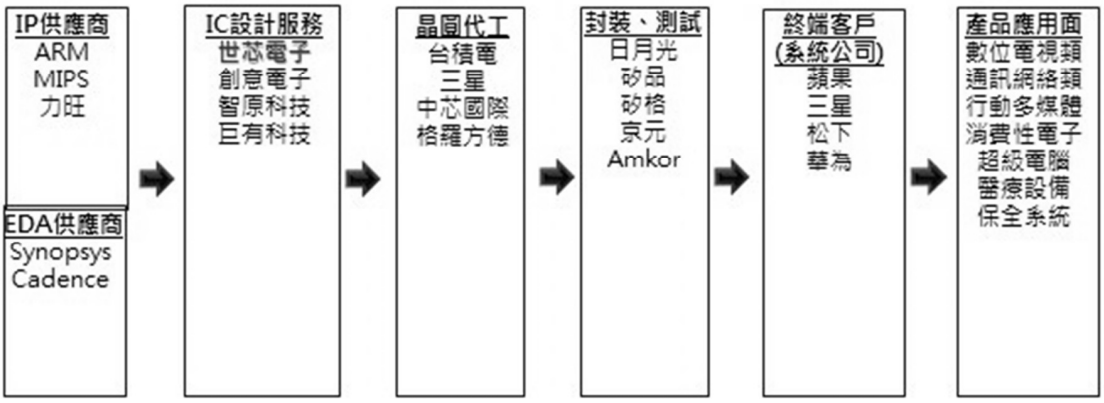
(2) 系統單晶片(SoC)之概況

隨著 IC 製程的演進，加上消費電子產品因朝微型化發展，對於輕薄、短小、省電多功能等市場需求加劇，使得系統單晶片(SoC)成為未來系統公司的發展趨勢。SoC 是將核心處理器、邏輯單元、記憶體單元和各種 I/O 介面功能結合為一的晶片，僅靠一顆晶片就能讓系統完整運作，並把多餘空間讓給其他不同功能的晶片，如 GPS 定位、WiMax、影音 IC、相機 IC、電視晶片等，藉以強化系統產品的運作功能。

由於系統單晶片（SoC）設計的各階段均遭遇驗證與分析的瓶頸，再加上若採用外部的 IP，整合的難度將大幅提高；又隨著製程邁向奈米級更精密節點(Node)發展，驟增的投資額和設計反覆風險增高，唯具有從佈局規範到設計法則的各項設計解決方案並與後端製程密切配合，才能提供客戶高附加價值服務。目前業界缺乏大型及有能力的 Fabless ASIC 公司，因此系統大廠釋出的 SoC 訂單並不多，市場成長空間很大。

2. 產業上、中、下游之關聯性

Fabless ASIC 產業，帶動含括各系統應用領域、矽智財元件(IP)、製造、封裝、測試等發展，形成專業分工各司其職的產業鏈，如下圖：



3. 產品之發展趨勢

(1) 特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit; ASIC)：指在特殊應用上所使用的積體電路元件，在電路板上均可發現有一顆各家所設計特有的 ASIC 晶片。ASIC 晶片應用市場大致可區分成六大塊，分別為電腦及其周邊(Computers and Peripherals)、有線通信(Wired Communications)、無線通信(Wireless Communications)、消費性電子(Consumer)、汽車應用電子(Automotive)與工業及其他(Industrial and Others)。其中主要仍以消費性電子所占比重最高，其主要成長動能來自於行動通訊及高解析度電視應用，其次為無線通信和電腦及其周邊領域。

(2) 系統單晶片(System on chip; SoC)應用市場：隨著製程演進，一塊晶片已能整合所有的系統功能，即靠著高度整合的 SoC，達成基於平台的設計方法。此設計

方法能有效解決不同等級產品之複雜性與上市時間等問題。未來，可以預見消費性產品因為 SoC 整合晶片的設計趨勢也將會平台化。

4. 競爭情形

Fabless ASIC 公司主要的競爭對手為整合元件廠商(IDM)及其他同型公司。隨著進入深次微米世代後，由於生產成本過高，大型 IDM 廠商已開始走下坡，無法與 Fabless ASIC 公司競爭，目前大部分的 IDM 廠商均逐漸轉型成輕/無晶圓廠模式。另外，在與其他同型公司的競爭中，產品能否及時上市為 Fabless ASIC 客戶最主要的訴求。隨著晶片的處理速度不斷提升，同時調變和解調演算法也愈趨複雜，設計人員需審慎評估如何在最短的設計週期內，針對整顆晶片的低功耗策略作定義及最佳化，並思考如何讓封裝設計包容超高的功耗，確保高速介面的訊號品質。因此，擁有專業的技術能力，並能提供整合服務的 Fabless ASIC 公司，才能在競爭激烈的情況下保持領先地位。

(三) 技術及研發概況

1. 本公司 2013 年及 2014 年度，投入之研發費用分別為新台幣 338,024 仟元及新台幣 368,021 仟元。
2. 開發成功之技術

世芯電子結合商用的設計軟體工具(EDA)與內部研發的設計技術，包含線路、實體設計及獨特的設計軟體工具，提供給客戶提高效能、縮小面積、降低功耗及快速完成的服務。內部研發技術如下：

(1) 階級式實體設計（hierarchial physical design）及時序分配(timing budgeting)方法：此法可在晶片的設計上分為幾個部分同時進行設計的工作，同時掌握各部份的時序，以符合晶片對於時序的要求。
(2) 實體設計(physical design)方法：此法將各種矽智財(IP)用於高密度的晶片設計，以縮小晶片面積，達到降低成本的目標。
(3) 時序與電氣(timing and electrical)的設計方法：此法可以藉由調整一些參數以提高良率。
(4) 時序及耗電分佈(power consumption distribution)方法：此法可以達到降低功耗，提高電氣效能。
(5) 可測試電路的設計(DFT)方法：此法可將晶片的可測試範圍極大化，並減少其他不必要的測試，以降低測試時間與成本。
(6) 產品規劃及制訂規格階段之技術：世芯電子為客戶做成本的規劃，包含選擇 SoC(系統晶片)或是 SiP(系統封裝)、系統成本及零件成本(BOM)的規劃、製程成熟度及智財元件(IP)穩定度考量、次世代製程可行性(Half node)、靜態隨機存取記憶體修復與否(SRAM Repair)之評估。並做測試成品選擇與解決方案，包含與矽智財元件供應商共同開發測試解決方案，建立內置測試模組(DFT，BIST)與配合可大量生產的測試機台，量產時採用兩組、四組甚至八組同時測試的線路板以節約測試成本。最後與封裝廠研擬最合適的封裝方式，建立良好的合作關係，以替客戶開發最佳的成品品質與市場效益。
(7) 原型及生產階段之技術：在原型的製作及晶片量產，世芯電子以專業的設備與技術(內建測試機台和測試冶具)與供應商緊密合作，幫助客戶縮短產品進入量產的時程，同時分析產品特性與敏感度，訂立量產製程條件及測試規格，並提供客戶少量的原型成品，供其製作系統工程原型機。在客戶原型機驗收過程中，世芯電子為晶片量產做準備，包括可靠性(reliability) / 合適性(qualification)分析。進入量產後，持續經由良率提升與縮短測試時間，為客戶降低生產成本。

3. 開發成功之產品

世芯電子成立至今開發超過兩百顆產品，產品共分為四大領域，分述如下：

四大領域	產品應用	現況/製程	設計展望與規畫
數位電視類	高解析度數位電視相關應用	• 含 65nm/40nm/32nm • 2010：七項設計案，已量產 • 2011：六項設計案，已量產 • 2012：五項設計案，已量產 • 2013：八項設計案，已量產 • 2014：一項設計案，已量產	• 持續為日本數位電視大廠設計及量產相關晶片 • 新一代產品已開始設計
通訊網絡類	資訊網路設備	• 含 65nm/55nm/40nm • 2010：一項設計案，已量產 • 2011：三項設計案，已量產 • 2012：二項設計案，已量產 • 2013：二項設計案，已量產	持續為通訊大廠設計及量產通訊網路 LTE, TD-SCDMA 所需相關晶片
	超級電腦 (Networking)	• 含 90nm/65nm/40nm/28nm • 2006：一項設計案，已量產 • 2010：一項設計案，已量產 • 2012：二項設計案，已量產 • 2013：二項設計案，已量產 • 2014：一項設計案，已量產	• 持續為學術單位量產超級電腦 networking 晶片 • 2006與Z大學合作，為當時世界最快超級電腦
行動多媒體消費性電子類	高解析度攝錄影機	• 含 65nm/55nm/40nm • 共八項設計案，已量產	持續為日本 DSC 大廠設計及量產所需相關晶片
	數位相機	• 含 65nm/55nm/40nm • 從設計到生產 9 個月 • 2010：三項設計案，已量產 • 2011：三項設計案，已量產 • 2012：三項設計案，已量產 • 2013：二項設計案，已量產	持續為全球第一數位相機大廠設計及量產相關晶片
	行動電話	• 含 90/55/40nm/28nm • 2010：二項設計案，已量產 • 2011：三項設計案，已量產 • 2012：二項設計案，已量產 • 2013：一項設計案，已量產 • 2014：一項設計案，已量產	持續為通訊大廠設計及量產所需相關晶片
	多媒體撥放器	• 含 180nm/130nm/90nm • 2009：四項設計案，已量產 • 2011：一項設計案，已量產 • 2012：一項設計案，已量產	持續為多媒體大廠設計及量產所需相關晶片
	平板電腦	• 含 55m • 2011：一項設計案，已量產	持續為多媒體大廠設計及量產所需相關晶片
	遊戲機	• 90nm/65nm/40nm/28nm • 2012：一項設計案，已量產	持續為日本電玩遊戲機大廠設計及量產所需相關晶片

利基市場類	比特幣/萊特幣挖礦機	• 28nm/20nm/16nm • 2013：三項設計案，已量產 • 2014：五項設計案，已量產	• 為瑞典公司設計及量產全球最快 28nm 比特幣挖礦機晶片；新一代 16nm 晶片設計完成 • 為多家中國礦機廠商設計晶片
	遊戲機台	• 28nm • 2014：一項設計案，已量產	為日系大廠設計及量產 28nm 遊戲機台繪圖晶片
	醫療影像設備	• 130nm/28nm • 共三項設計案，已量產	為日本醫療設備大廠設計及量產所需相關晶片
	保全系統設備	• 180nm • 2010：一項設計案，已量產 • 2012：一項設計案，已量產 • 2013：一項設計案，已量產	為數家保全晶片設備廠設計及量產所需相關晶片
其他類	車用電子設備	• 180nm • 2011：一項設計案，已量產 • 2012：一項設計案，已量產	為日本系統大廠設計及量產所需相關晶片

(1) 成功案例-全球最高速超級電腦系統晶片

世芯電子於 2011 年替客戶完成運用於超級電腦的通訊網絡晶片，此顆超高速電腦系統晶片,首次投片生產即成功通過功能驗證。本項設計採用台積電 65nm 製程，從實體設計、電性、時脈以及散熱等方面同時著眼，在 20mmX 17mm 的晶片尺寸下，透過獨到的時脈架構設計，克服了超過 6000 萬個邏輯閘、800MHz 時脈速度的高設計複雜度，並解決在超過 54 瓦功率所面臨的散熱問題；有別於傳統環狀方式而以獨特的二微陣列 AreaI/O 技術縮小經驗面積，最後以覆晶封裝技術成功產出,其終端產品的運算能力奪下世界最高速運算器的冠軍頭銜。

(2) 成功案例-系統大廠

A.A 公司：自 2003 年起日本系統廠陸續將最重要的產品線交給世芯電子，包含：高解析度數位電視、遊戲機、數位相機及攝影機等。

B.B 公司：自 2009 年起台灣 I 公司與世芯電子合作生產數位相機晶片，最新一代的產品已交由世芯生產。

(四) 長、短期業務發展計劃

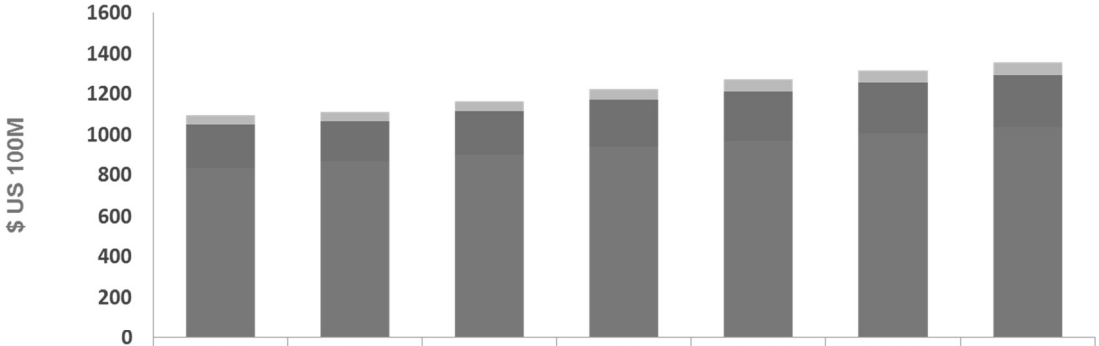
世芯電子未來仍持續專注其本身的核心業務-高階製程 SoC 之研發、設計及製造，並與世界級的晶片製造代工廠緊密合作，以領先的技術提升臺灣在晶片設計產業的國際地位。以下就研發、業務、生產三方面分述本公司之短期及長期的業務發展計畫。

項目	短期業務發展計畫	長期業務發展計畫
研發	1. 類比電路客製化及驗證。 2. 設計流程之優化，縮短設計流程的時間。 3. 加強先進製程產品技術的研發，強化 SoC 整合能力與設計品質的精進。 4. 省電設計的方法研發。 5. 在產品設計的時候，清楚考量如 DFT、DFM、DFP…等，使得量產的成本可預估和可控制。	1. 深化高階類比電路客製化及驗證研發，擴充矽智財庫。 2. 與晶圓廠合作，持續深耕先進製程 IC 產品設計的研發。 3. 持續精進設計流程標準化，縮短設計時間，降低耗電設計的方法研發。 4. 強化矽智財之性能及節能如 ARM 的高階處理器之應用。 5. 加強 SoC 前段設計能力，開發各式應用平台架構。 6. 加強系統分析能力以確保客戶將晶片整合進系統的可預測性，如：SI, PI。
業務	1. 以系統客戶為主，選擇具市場潛力的產品。 2. 將系統客戶的現有產品導入先進製程，以降低成本與耗電。 3. 增加系統整合如 SoC 或是 SiP。 4. 以市場導向開發客戶，尋找具發展潛力的客戶，專注於本公司四大領域客戶。	1. 建立全球主要客戶服務據點，深耕系統客戶之長期合作關係及核心技術，提升市場知名度及佔有率。 2. 加強與矽智財供應商之策略結盟與長期合作關係。 3. 與客戶合作開發各式應用平台架構，並協助客戶建立合作結盟關係，增加系統整合如 SoC 或是 SiP 的競爭力。 4. 持續加強與上下游廠商之間的合作關係，並建立更寬廣的市場資訊觸角。
生產	1. 加強上下游之合作。 2. 提供客戶優質的供應鏈管理，以創造生產的附加價值。 3. 與晶圓廠建立長期的合作關係。	1. 加強設計與生產的銜接，持續降低生產成本，提高生產良率。 2. 提供客戶更優質的供應鏈管理及更專業的後段諮詢能力，以創造生產的附加價值。 3. 與晶圓廠建立長期緊密的合作關係，包括矽智財之驗證研發。

二、 市場及產銷概況

(一) 市場分析：

1. ASIC 的市場規模正在成長:



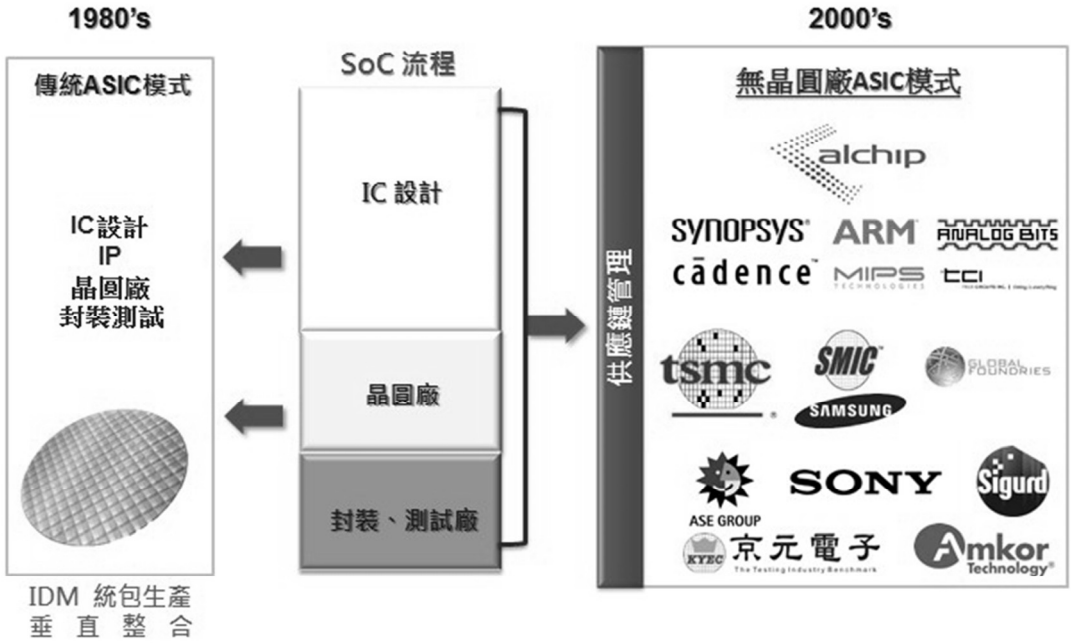
	2012	2013	2014e	2015F	2016F	2017F	2018F
FPGA/PLD	44.26	45.19	48.61	53.26	58.43	63.32	67.64
ASIC	213.2	198.35	212.34	227.67	237.47	246.3	254.34
ASSP	837.16	868.59	903.16	941.32	972.9	1007	1037.7

Source: Dataquest March 2014

半導體發明至今經過60年的發展，綜觀在進入深次微米世代後的半導體產業發展趨勢有三，包含商業模式從系統公司垂直整合到現今的專業分工；製程技術依循摩爾定律發展到今日已邁向16奈米製程節點(process node)；系統商品採用SiP(堆疊封裝技術)與整合系統單晶片(SoC)模式，以求最大的市場競爭力。

(1) 趨勢一：專業分工的產業

半導體產業直到八零年代初期，主要為垂直整合上、中、下游的封閉生產體系，系統公司包辦所有的項目。自1987年第一家專業晶圓代工廠台積電及聯華電子的成立，專業晶圓代工的商業模式正式確立。 2000年以後除大型IDM仍擁有IC設計與晶圓廠外，半導體產業的專業分工愈來愈明顯，如今，系統公司專注於研發核心技術以及經營其品牌行銷，將後端設計及生產供應練管理委託給無晶圓廠 ASIC (Fabless ASIC)公司，Fabless ASIC公司與策略合作夥伴結盟，形成專業分工的產業。



(2)趨勢二：高階製程取代低階製程

ASIC設計追求高階製程以降低成本、降低功耗及縮減體積。在晶圓的製造上，進入次微米及深次微米世代，一顆中型(5~10M GATE)的SoC成本為數百萬美元，光罩的費用在90奈米約為70萬美元，進入65奈米製程的光罩費用超過百萬美元，40奈米製程約二百萬美元的費用，根據市場機構IC Insights統計，2013年全球晶圓代工的市場規模約428億美元，以台積電為例，台積電因製程技術領先，市場規模已達198億美元。

(3)趨勢三：系統整合逐漸走向將SoC(系統設計)/SiP(封裝技術)

系統產品市場競爭激烈，較短的開發時間和具成本效益的設計為客戶首要需求。ASIC設計除了矽智財的整合，也是系統層次的整合；在追求高階製程，需要將晶片封裝測試技術納入考量，以取得成本、耗電、體積的競爭優勢。為了因應全新的SoC可能需要耗費大量的時間和金錢，SiP堆疊封裝技術因而產生。與傳統的IC封裝相比，SiP封裝技術最多可減少設計時間、增加封裝密度、降低風險與節約系統成本支出。未來系統單晶片漸走向跨平台的合作，透過SiP整合系統單晶片(SoC)的模式，將各平台作最具競爭力的整合。

(4)趨勢四：系統廠商將逐漸走向將ASIC外包設計及生產

各個市場需求量大的系統產品，在面對功能多樣化及成本競爭力的壓力下， 如相機、平板電腦及智慧型手機等產品的主要廠商都面臨成本及未來競爭的壓力，進而開始思考並進入自行開發ASIC的策略，以得到差異化及競爭力的優勢。系統廠商將更集中於掌握核心的韌體及軟體技術逐漸走向將ASIC外包設計及生產。

2. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位:新台幣仟元

銷售地區	2013 年度		2014 年度	
	金額	比率	金額	比率
臺灣	239,953	9.29%	564,667	12.04%
日本	1,253,095	48.50%	1,729,154	36.86%
中國大陸	359,491	13.91%	712,460	15.19%
韓國	449,380	17.40%	898,856	19.16%
歐洲	229,355	8.88%	741,741	15.81%
其他	52,289	2.02%	44,863	0.96%
合計	2,583,563	100.00%	4,691,741	100.00%

3. 市場占有率

根據各公司財務資訊公告，2014 年國內設計服務業之營業合計約為 200 億新台幣，本公司之營業額約 46.9 億新台幣，市場占有率為 23%，排名第三。

4. 市場未來之供需狀況與成長性

隨著系統單晶片的應用層面越來越廣與終端產品多元化的需求，IC 製造商與設計業者明顯感受到其設計生產力遠不及製程技術之精進，為達縮短產品上市時間、降低 IC 設計成本的目標，系統廠商需與有能力整合不同矽智財的 Fabless ASIC 業者合作，因而 Fabless ASIC 需求將日益成長。

另外，在 IDM 持續放出系統廠訂單以及持續有小型 IC 設計公司成立之下，我們預見整體 ASIC 產業將持續成長。2014 年 03 月國際研究暨顧問機構 Gartner 發布預測，2015 全球 ASIC 產業營收預估約 230 億美元，又因客製化行動通訊應用處理器與新一代超高清電視的帶動下，ASIC 產業成長率將達 9%。

以各區域的成長情形來看，亞太地區仍是未來成長的重心，中國龐大的內需市場為其成長動力。本公司長期積極研發先進製程(40 奈米及以下)的設計流程與技術

，針對一般商用研發設計軟體(EDA)的使用作改良，並加強供應鏈管理，通過豐富的設計資源與技術支援，使客戶群的產品能領先市場，而本公司在 2015 年的營收也能持續成長。

5. 競爭利基

(1) 高階製程經驗：

目前絕大部分 Fabless ASIC 公司技術經驗仍停留在 90 奈米或其以上節點，世芯電子設計團隊專注於先進製程(40 奈米及以下)、高複雜度(大於 20million gates)的設計案，成功為世界級的系統公司開發並量產一系列的系統級晶片，對於 electrical closure(包含電源管理、時序收斂、系統介面及信號完整度)、可測性設計(Design for Test；DFT)，可製造性設計(Design for Manufacturing；DFM)或系統層級的挑戰都能有效的解決，進一步縮短設計時程及提升晶片效能，幫助客戶降低成本、增加生產效能、減少功耗以及晶片尺寸最佳化。

(2) 客製化服務：

本公司為滿足客戶的需求，提供適度的靈活度配合客戶替其打造客製化的設計。世芯的市場定位在於高複雜度及先進製程的 SoC 設計，對於客戶的要求都會先做充分的溝通與瞭解，提供從設計到量產的全方位服務，並將客戶未來將上市之產品所需的矽智財納為本公司之研發計畫，提前做好準備以縮短日後的設計時程。

(3) 品質保證：

世芯的目標是開發與提供最高品質的解決方案給客戶，達到最高卓越標準，並持續提升創新力。為協助客戶掌握市場的先機，本公司在設計階段即導入可測試性(DFT)的方法，在晶片上增設硬體電路，使晶片在測試時能檢測出缺陷及製造瑕疵，進而降低測試成本，並強化晶片量產的良率，確保每項工作皆能快速有效地完成，降低 IC 設計的風險。同時，世芯也實行嚴格的品質政策，持續檢討及強化其服務，以便用高時效性、高度成本效益的方式，完成客戶所交付的各工作項目，確保產品與品質能合乎客戶的需要。

(4) 掌握先進製程設計技術：

本公司核心團隊掌握先進製程的設計能力，對於先進製程的變異性皆有相當了解，對於一般商用 EDA 軟體因缺乏先進製程的變異所產生的風險，能夠適度的預測及規避。尤其是在先進製程中系統更為複雜，為確保晶片的可預測性，於晶片設計及封裝過程中亦將系統分析考量進來，以確保客戶將晶片整合進系統的可預測性，如：SI(Signal Integrity)、PI(Power Integrity)。世芯的先進製程設計解決方案已在超過 2 億顆量產晶片中獲得實證，今年也開始提供客戶最先進的 16 奈米製程服務，客戶採用世芯的設計方案，能在最短時間完成產品設計的目標並在高量產下得到成本效益。

(5) 可靠性：

高複雜度的 SoC 設計面臨著可靠性、品質、成本以及產品上市周期的挑戰，本公司自 2003 年成立已完成超過 250 個設計專案，並獲得世界及系統公司的品質認證。無論高階系統晶片、高複雜度晶片以及先進製程晶片，迄今均可達成一次投片成功，世芯電子在電路的設計初期即考慮可能發生的環境變異因素，減少重新設計(re-design)、再次光罩(re-spin)的時間與成本，以達成一次成功及高良率。世芯透過縝密的規劃、執行，以及對可靠度的專注、售前支援及持續改善相關產品可靠性，以達成可靠度保證。

(6) 長期的客戶關係和策略結盟夥伴：

本公司和客戶之間皆有長期合作關係，共同追求越做越好、越做越快、成本越來越低的目標。在供應鏈管理部分，也和上下游之策略夥伴維持良好的合作關

係，提供客戶完整的解決方案及更具競爭力的產品。

6. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

A. 臺灣半導體的產業供應鏈完整：半導體產業分工專業且上下游關係密切，臺灣擁有製程先進的晶圓、封裝、測試廠商及完整的衛星廠商，對於發展 IC 設計服務相當有利，加上地理位置的便利性，吸引全球的廠商在臺灣下單，擁有一流的國際競爭力。

B. 臺灣具有大量的半導體產品需求：臺灣的代工商業模式不僅止於半導體，在系統產品製造代工上，也擁有非常高的生產效率和經濟規模，因此臺灣的內需市場上即具備很大的需求以支持國外廠商的訂單。

C. 政府的政策支持:電子產業一直受到政府大力支持,投入製造代工(OEM)、設計代工(ODM)到半導體產業，培植資訊、消費性電子及 IC 製造產業，使得人才和產業結構都有利於長期發展。

(2) 不利因素與因應對策：

A. 對於有先進製程經驗的工程師有限、人才尋求及養成不易且 IC 產業蓬勃發展,專業人員的取得日益競爭,公司往往需付出高額成本網羅優秀人才，因此為凝聚對員工公司的向心力，公司所付出之人力成本也較高。

【因應措施】

①本公司透過內部與外部的專業教育訓練與在職訓練,長期自行培育自有人才，並提高員工福利，降低流動率。

②採用員工認股權憑證以留住人才。

B. 產業前景看好，產能需求日增，需積極擴充產能以提昇服務品質。IDM 之產業模式已漸不具競爭力，系統客戶尋求合作夥伴的市場趨勢已經漸漸明顯；目前的設計服務業者之規模有限，需要擴充規模以贏取國際級系統公司的大單。

【因應措施】

①簡化開發設計流程以提高生產力。

②建立特定應用的矽智財平台，縮短設計時程及資源投入。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：

世芯電子的主要產品共分四大類別：

(1) 數位電視市場：本公司成立至今設計超過四十顆數位電視相關晶片。高解析度電視並非如以前只是一個娛樂的設備，透過網路傳輸，成為家庭的資訊多媒體中心,可連接保全系統並能儲存、分享及運算,未來與電腦的界限會越加模糊。

(2) 通訊網絡市場：網路、儲存及運算設備正在成長，這些設備為了滿足更高的效能標準，必須使用日益複雜的高效能、高密度系統單晶片。本公司與中國系統大廠合作完成多項 3G、4G TD/LTE 行動通訊基頻晶片並量產；並持續為學術單位量產超級電腦 networking 晶片,項目產品並被評選世界最快之超級電腦，其特質在於高複雜難度、大量的客製化設計或是特別嚴謹的製程條件及測試，例如通訊設備之主晶片，動輒數千萬個邏輯閘，其複雜難度除設計外，連帶對於測試、封裝，都必須納入考量。

(3) 消費性電子產品：包含手機、數位相機/攝影機、娛樂系統、可攜式媒體播放器，平板電腦主晶片及周邊晶片等應用領域之設計。其中行動通訊裝置已整合 MP3、照相、定位系統、行動電視、無線上網、遊戲機等功能，未來將成為個人理財、身分辨識的工具。在半導體產業中，消費性市場是成長最快的區段，

為因應激烈的市場競爭，世芯提供可預估的晶片實現時程、採行已歷經實證的應用功效電路、儘速完成原型晶片，及儘速進入大量生產，使客戶的投資獲得最大報酬。

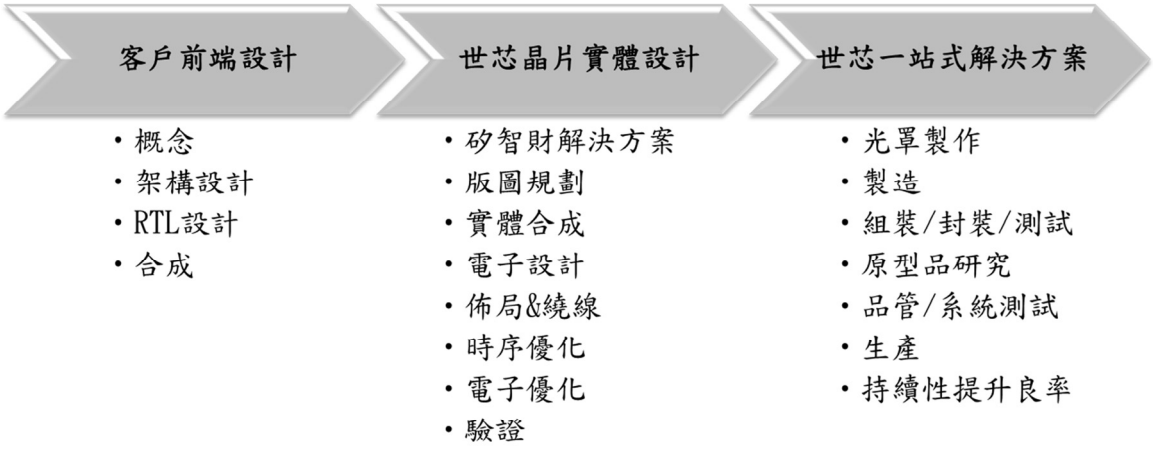
(4) 利基市場產品：包含監視系統、娛樂機台與醫療設備器材等特殊應用領域的 ASIC 設計，2013 年並投入比特幣挖礦機市場，項目產品為當時世界最快最高端礦機晶片。

2. 主要產品之產製過程：

晶片設計是由前端設計和後端設計所組成，前端設計由系統公司提供，後端設計及生產製造即委託給世芯電子。

在前端設計中，由客戶決定產品的概念，以 RTL(Register Transform Level)描述 IC 所需功能，並決定產品的運作速度，最後建立一個包含所有細節(基本功能邏輯)的目標資料庫。通過運用合成軟體(Synthesis Software)，將 RTL 轉換為 Net List，在 Net List 中將電子線路轉換為邏輯閘，並將所定義的功能，以合成軟體實現，同時優化設計師所定義的運作時脈，把完成的設計交由 Fabless ASIC 廠商做後端設計。

後端的設計分為兩個階段，第一階段為設計案起始至收到客戶最終 Net List，大約六到八周的時間；第二階段為工程師使用實體設計軟體將 Net List 轉換為實際的佈線，產生一個稱為 GDSⅡ的檔案，以製造光罩(俗稱 Tape Out)，此階段大約四到六周的時間。



世芯電子除了提供後端設計服務，也提供客戶從設計到晶圓製造、封裝及測試的一站式(Turn-Key)完整服務。在世芯電子的服務流程，晶圓製造階段是從將 GDSⅡ的檔案交付給晶圓廠製造開始算起，從 GDSⅡ之交付到晶片成品測試完成，大約費時八到十二周不等。晶片製造過程可概分為晶圓處理製程(Wafer Fabrication；簡稱 Wafer Fab)、晶圓針測製程（Wafer Probe）、封裝（Assembling）、測試製程（Initial Test and Final Test）等幾個步驟。世芯電子與整體後端設計生產的供應商，皆有緊密的合作關係。

(1) 矽智財供應商：世芯電子與各個矽智財(IP)供應商緊密的合作，謀取最適合的性價比。全球主要的 IP 供應商的產品，世芯都可以提供，客戶可採用自主 IP，再靈活搭配世芯提供的 IP 。

(2) 晶圓廠：世芯電子依據客戶需求選擇合作廠商，採用的開放式晶圓廠的商業模式，不需依附固定晶圓廠限制本身的設計能力及發展。本公司與大部分晶圓廠(如:台積電、三星、中芯國際、格羅方德…等)皆有良好的合作關係；在深次微米高階製程 SoC 後端設計上的研發並與台積電緊密合作。

(3) 封裝測試廠：考量產品生產時的封裝測試，設計之初，世芯電子製造生產團隊與設計工程團隊將會和客戶以及供應鏈中的封裝測試廠一起合作，確保產品化的過程中的每一個環節無誤。同時世芯電子的物流團隊透過良善規劃的生產流程，以及與供應鏈廠商的良好互動，讓晶片能及時生產，交付客戶。

以下為半導體產業鏈個別供應商之列表：

(三) 主要原料之供應狀況

主要原料名稱	主要來源	供應情形
晶圓	台灣	良好

(四) 主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

單位：新台幣仟元；%

	2013 年度				2014 年度			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比例(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比例(%)	與發行人之關係
1	TSMC 公司	777,780	98.98	無	TSMC 公司	2,220,130	98.14	無
2	其他	7,965	1.02	無	其他	42,043	1.86	無
	進貨淨額	785,745	100.00		進貨淨額	2,262,173	100.00	

變動原因說明：本集團係專業之 IC 設計公司，主要進貨項目為晶圓，本集團在追求品質及交期確保，與晶圓代工廠商均長期配合並建立穩定之合作關係。
2014 年進貨金額較 2013 年增加係因 2014 年晶圓產品量產銷貨增加所致。

2. 最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

單位：新台幣仟元；%

	2013 年度				2014 年度			
項目	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比例(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比例(%)	與發行人之關係
1	A 公司	931,179	36.04	無	A 公司	1,484,343	31.64	無
2	M 公司	296,388	11.47	無	M 公司	873,126	18.61	無
3	N 公司	229,355	8.88	無	N 公司	736,892	15.71	無
4	其他	1,126,641	43.61	無	其他	1,597,380	34.04	無
	銷貨淨額	2,583,563	100.00		銷貨淨額	4,691,741	100.00	

變動原因說明：本集團最近二年度第一大客戶相同，銷售 A 公司之金額增加係 2014 年客戶產品銷售上升，產品需求增加所致。銷售予 M 公司及 N 公司金額增加係因 2014 年客戶產品進入量產。

(五) 最近二年度生產量值

單位：新台幣仟元；仟顆

年度 生產量值 主要商品	2013 年度		2014 年度	
	產量	產值	產量	產值
ASIC 及晶圓產品	65,943	1,504,755	72,560	3,248,321
委託設計(ＮＲＥ)	-	113,506	-	123,846
其他	3,811	50,875	2,170	25,869
合計	69,754	1,669,136	74,730	3,398,036

註：本集團屬專業 IC 設計公司，無自備晶圓製造產能，一般製造業之產能尚不適用；委託設計係接受委託 IC 設計之各項服務，逐案之承攬、投入成本等事項不同，故不適用產量及產能算。

變動分析：2014 年度之產量及產值較 2013 年度增加，係因 2014 年度承接晶圓產品訂單增加所致。

(六) 最近二年度銷售量值

單位：新台幣仟元；仟顆

年度 銷售量值 主要商品	2013 年度				2014 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
ASIC 及晶圓產品	32,145	237,855	33,456	2,154,303	23,263	562,599	48,889	3,839,854
委託設計(ＮＲＥ)	-	638	-	165,526	-	-	-	272,366
其他	218	1,460	3,624	23,781	186	2,068	1,925	14,854
合計	32,363	239,953	37,080	2,343,610	23,449	564,667	50,814	4,127,074

註：外銷係指銷售至臺灣以外之地區。

變動分析：2014 年度之銷售量及銷值均較 2013 年度增加，係因 2014 年度承接晶圓產品訂單增加所致。

三、 從業員工

本公司最近二年度從業員工人數，平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

單位：人

年度		2013 年度	2014 年度	當年度截至 2015 年 04 月 16 日止
員工人數	經理級以上主管	64	74	73
	一般職員	160	166	165
	合計	224	240	238
平均年歲		31.34	31.81	31.96
平均服務年資		3.18	3.32	3.39
學歷分佈比率	博士	1%	1%	1%
	碩士	44%	44%	44%
	大專	52%	52%	52%
	高中以下(含)	3%	3%	3%

四、 環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無。

五、 勞資關係

(一) 公司各項福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施：
   本集團之員工福利措施，依各子公司所在地之相關法令規定辦理，包含勞健保、團體保險、退休金之提撥及年度健康檢查。本集團各子公司亦設有員工福利委員會，負責規劃辦理員工之相關福利事項，包含年節禮金、員工旅遊、定期團康活動及年終尾牙。
2. 進修及訓練情形：
   本公司為提昇員工之專業能力及達成企業培育人才之目標，每年依公司發展策略及員工之需求訂定員工之年度訓練計劃，並依 ISO 訓練管理程序確實執行訓練並定期做訓練績效的檢討及稽核。
3. 退休制度與實施狀況：
   本集團之退休制度，依各子公司所在地之相關法令規定辦理，依法每月提撥退休金至員工專戶中，提供給員工安全無虞之保障。
4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
   本集團一向重視員工權益及員工意見，勞資關係和諧，員工可透過定期之勞資會議進行溝通並提供公司營運之建議。因此，迄今並無重大勞資糾紛情事發生。

(二) 說明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：
本集團勞資關係一向和諧，並無因勞資糾紛所遭受的損失，預計未來年度亦無因勞資糾紛而產生之損失。

六、 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約列示如下：

(一) Alchip Technologies, Limited （世芯電子股份有限公司，Alchip (Holdco)）

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
產品服務	A公司	2004 年 11 月 12 日起 10 年	Alchip (Holdco)提供服務並交付雙方約定生產製造之產品予 A 公司	無
買賣	A公司	2009 年 6 月 25 日起 1 年（如任一方未於契約到期前三個月書面終止契約，則續約一年，其後亦同）	Alchip (Holdco)提供製造並交付雙方協議生產製造之產品予 A 公司 雙方並於 2014 年 6 月 24 日共同簽署一份增補合約，修改本約之部分條款，期限與本約同	無
設計服務	M 公司	2011年12月29日起(如雙方未提出終止契約，則自動續約)	Alchip (Holdco)提供產品研發設計服務並交付雙方約定生產製造之產品予 M 公司	無
設計服務	J 公司	2010 年 10 月 22 日起 5 年	Alchip (Holdco)根據契約和所附之工作說明提供一種或多種積體電路產品的研發服務，並將生產或委外生產的積體電路產品銷售給 J 公司	無
設計與生產	N公司	2014 年 12 月 30 日起 5 年	Alchip (Holdco)根據契約和所附之工作說明提供產品研發服務，製造並出售積體電路產品予 N 公司	無
生產	C 公司	2010 年 6 月 14 日起生效	C 公司同意由 Alchip 提供晶圓製造服務，雙方如就產品價錢、品質及運送方式合意後，C 公司應以書面	無

			方式發出 Production Order，並經 Alchip 以書面回應後，Alchip 始有義務製造並運送產品	
技術授權	E公司	2008年3月4日	E公司將其相關專利技術授權予Alchip (Holdco)使用	無
合作夥伴	F公司	2009年3月13日起1年（每年自動續約一年）	F公司委任Alchip (Holdco)成為其價值鏈供應商「Value Chain Aggregator」	無
軟體授權及維護	G公司	2003年4月1日起迄今	G公司授權 Alchip (Holdco)得使用授權產品（Licensed Products）之權利（於2013年10月29日，G公司再與Alchip (Holdco)、Alchip (TW)、Alchip (JP)、Alchip (Wuxi)及Alchip (Shanghai)共同簽署一份軟體授權之補充合約，G公司授權 Alchip (Holdco)、Alchip (TW)、Alchip (JP)、Alchip (Wuxi)及Alchip (Shanghai)得使用授權產品（Licensed Products）及專利技術之權利，期限至2016年10月30日）	無
技術授權	G公司	2003年4月1日起迄今	G公司公司授權Alchip (Holdco)得使用授權產品（Licensed Products）之權利（於2012年11月2日，G公司再與Alchip (Holdco)、共同簽署一份軟體授權之補充合約，G公司公司將其相關專利技術授權予Alchip (Holdco)使用，期限至2016年1月1日)	無
技術授權	G公司	2003年4月1日起迄今	G公司授權Alchip (Holdco)得使用授權產品（Licensed Products）之權利（於2013年5月21日，G公司再與Alchip (Holdco)及Alchip (Shanghai)共同簽署一份軟體授權之補充合約，G公司將其相關專利技術授權Alchip (Holdco)及Alchip (Shanghai)使用，期限至2016年5月21日)	無
技術授權	G公司	2003年4月1日起迄今	G公司授權Alchip (Holdco)得使用授權產品（Licensed Products）之權利（於2014年8月1日，G公司再與Alchip (Holdco)及Alchip(Shanghai)共同簽署一份軟體授權之補充合約，G公司將其相關專利技術授權Alchip (Holdco)及Alchip(Shanghai)使用，期限至2017年8月4日)	無
軟體授權及維護	H公司	2006年6月29日至H公司依照本合約約定終止為止	H公司授權Alchip (Holdco)得使用授權產品（Licensed Materials）之權利	無
技術授權	H公司	2014年1月6日至2017年1月5日	H公司將其相關專利技術授權予Alchip (Holdco)使用	無

(二) Alchip Technologies, Limited 臺灣子公司（世芯電子股份有限公司，Alchip(TW)）

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃合約	訊連科技股份有限公司	2014年8月1日至2019年7月31日	承租「臺北市內湖區文湖街12號9樓」及「臺北市內湖區文湖街12號9樓之1」，作為辦公之用	無

(三) Alchip Technologies, Limited 臺灣分公司（英屬開曼群島商世芯股份有限公司台灣分公司，Alchip(TW Branch)）

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
設計與生產	I公司	2014年10月29日起 5年	Alchip (TW Branch)根據契約和所附之工作說明提供產品研發服務，製造並出售積體電路產品予I公司	無
租賃合約	台元紡織股份有限公司	2011年1月1日至2015年12月31日	承租新竹縣竹北市竹北里台元一街一號11樓之1，作為辦公之用	無

(四) Alchip Technologies, Limited 上海子公司(世芯電子(上海)有限公司，Alchip(China))

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
軟體授權及維護	G公司	2003年4月1日起 迄今	G公司授權 Alchip (Shanghai)得使用授權產品（Licensed Products）之權利（於2013年10月29日，G公司再與Alchip (Holdco)、Alchip (TW)、Alchip (JP)、Alchip (Wuxi)及Alchip (Shanghai)共同簽署一份軟體授權之補充合約，G公司授權 Alchip (Holdco)、Alchip (TW)、Alchip (JP)、Alchip (Wuxi)及 Alchip (Shanghai)得使用授權產品（Licensed Products）及專利技術之權利，期限至2016年10月30日）	無
技術授權	G公司	2003年4月1日起 迄今	G公司授權 Alchip(Shanghai)得使用授權產品（Licensed Products）之權利（於2013年5月21日，G公司再與Alchip (Holdco)及 Alchip (Shanghai)共同簽署一份軟體授權之補充合約，G公司將其相關專利技術授權予Alchip (Holdco)及 Alchip (Shanghai)使用，期限至2016年5月21日)	無
技術授權	G公司	2003年4月1日起 迄今	G公司授權 Alchip (Holdco)得使用授權產品(Licensed Products)之權利(於2014年8月1日，G公司再與Alchip (Holdco)及 Alchip (Shanghai)共同簽署一份軟體授權之補充合約，G公司將其相關專利技術授權 Alchip (Holdco)及 Alchip (Shanghai)使用，期限至2017年8月4日)	無
租賃契約	上海綠地濱江置業	2012年9月1日至2015年8月31日	承租上海市徐匯區龍華路 1775 號1101-1110室，作為辦公之用	無

	有限公司			
租賃契約	上海張江企業諮詢服務有限公司	2012年8月28日至2015年8月27日	承租上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓632-19室，作為科研用房使用	無

陸、 財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一) 簡明資產負債表及損益

1. 簡明資產負債表

(1) 簡明資產負債表-依國際財務報導準則編製

單位：新台幣仟元

項目＼年度		最近五年度財務資料				
		2010 年度(註 1)	2011 年度(註 1)	2012 年度(註 1)	2013 年度（註 2）	2014 年度（註 2）
流動資產		-	-	1,357,185	1,344,212	2,689,501
不動產、廠房及設備		-	-	245,359	327,780	358,202
無形資產		-	-	95,832	206,642	179,262
其他資產		-	-	44,519	26,318	92,237
資產總額		-	-	1,742,895	1,904,952	3,319,202
流動負債	分配前	-	-	237,636	248,750	540,679
	分配後	-	-	237,636	258,496	(註 3)
非流動負債		-	-	-	-	-
負債總額	分配前	-	-	237,636	248,750	540,679
	分配後	-	-	237,636	258,496	(註 3)
歸屬於母公司業主之權益		-	-	-	-	-
股本		-	-	538,713	539,473	634,818
資本公積		-	-	731,345	731,887	1,418,141
保留盈餘	分配前	-	-	301,089	414,213	615,653
	分配後	-	-	301,089	404,467	(註 3)
其他權益		-	-	(65,888)	(29,371)	109,911
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	-	-	1,505,259	1,656,202	2,778,523
	分配後	-	-	1,505,259	1,646,456	(註 3)

註 1：2010~2011 年度係依我國會計準則編製之財務資料，請參考下表(3)。

註 2：2012~2014 年為經會計師查核之合併財務報告。

註 3：2014 年度之盈餘尚未經股東會決議分配。

(2) 簡明綜合損益表-依國際財務報導準則編製

單位：新台幣仟元

年度 項目	最近五年度財務資料				
	2010 年度(註 1)	2011 年度(註 1)	2012 年度(註 1)	2013 年度(註 2)	2014 年度(註 2)
營業收入	-	-	2,671,121	2,583,563	4,691,741
營業毛利	-	-	610,147	757,863	953,307
營業損益	-	-	59,227	186,058	342,198
營業外收入及支出	-	-	(24,530)	(33,883)	(42,690)
稅前淨利	-	-	34,697	152,175	299,508
繼續營業單位本期淨利	-	-	21,855	113,124	211,186
本期淨利	-	-	21,855	113,124	211,186
本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	(65,888)	36,517	139,282
本期綜合損益總額	-	-	(44,033)	149,461	350,468
淨利歸屬於母公司業主	-	-	21,855	113,124	211,186
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	-	-	(44,033)	149,461	350,468
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
每股盈餘(元)	-	-	0.41	2.10	3.77

註 1：2010~2012 年度係依我國會計準則編製之財務資料，請參考下表(4)。

註 2：2012~2014 年為經會計師查核之合併財務報告。

(3) 簡明資產負債表-依我國財務會計準則編制

單位：新台幣仟元

項目＼年度		最近五年度財務資料				
		2010 度 (註 1)	2011 年度 (註 1)	2012 年度 (註 1)	2013 年度 (註 2)	2014 年度 (註 2)
流動資產		1,363,345	1,415,886	1,384,481	-	-
基金及投資		-	-	-	-	-
固定資產		330,380	367,918	249,377	-	-
無形資產		87,122	68,820	95,766	-	-
其他資產		39,890	37,667	23,112	-	-
資產總額		1,820,737	1,890,291	1,752,736	-	-
流動負債	分配前	329,203	332,840	241,566	-	-
	分配後	386,286	340,732	241,566	-	-
長期負債		-	-	-	-	-
其他負債		2,691	1,750	-	-	-
負債總額	分配前	331,894	334,590	241,566	-	-
	分配後	388,977	342,482	241,566	-	-
股本		538,713	538,713	538,713	-	-
資本公積		637,910	667,131	641,020	-	-
保留盈餘	分配前	255,345	274,737	264,904	-	-
	分配後	198,262	266,845	264,904	-	-
金融商品未實現損益		-	-	-	-	-
累積換算調整數		56,875	75,120	66,533	-	-
未認列為退休金成本之淨損失		-	-	-	-	-
股東權益總額	分配前	1,488,843	1,555,701	1,511,170	-	-
	分配後	1,431,760	1,547,809	1,511,170	-	-

註1：2010~2011年為經會計師查核之合併財務報告。

註2：2012~2014年係依國際財務報導準則編製之財務資料，請參考上表(1)。

(4) 簡明損益表-依我國財務會計準則編制

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	最近五年度財務資料				
	2010 年度 (註 1)	2011 年度 (註 1)	2012 年度 (註 1)	2013 年度 (註 2)	2014 年度 (註 2)
營業收入	2,424,978	2,665,705	2,623,365	-	-
營業毛利	675,412	643,698	589,305	-	-
營業損益	265,261	105,994	47,186	-	-
營業外收入及利益	15,468	15,563	14,181	-	-
營業外費用及損失	(7,975)	(38,903)	(39,786)	-	-
繼續營業部門稅前損益	272,754	82,654	21,581	-	-
繼續營業部門損益	255,345	66,440	9,196	-	-
停業部門損益	-	-	-	-	-
非常損益	-	-	-	-	-
會計原則變動之累積影響數	-	-	-	-	-
本期損益	255,345	66,440	9,196	-	-
每股盈餘(元)	7.95	1.23	0.17	-	-

註1：2010~2011年為經會計師查核之合併財務報告。

註2：2012~2014年係依國際財務報導準則編製之財務資料，請參考上表(2)。

(二) 影響財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報表之影響：無。

(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	簽證會計師	所屬單位名稱	查核意見
2009年度	范有偉、林文欽	勤業眾信聯合會計師事務所	無保留意見
2010年度	王儀雯、范有偉	勤業眾信聯合會計師事務所	無保留意見
2011年度	王儀雯、范有偉	勤業眾信聯合會計師事務所	無保留意見
2012年度	王儀雯、范有偉	勤業眾信聯合會計師事務所	無保留意見
2013年度	王儀雯、范有偉	勤業眾信聯合會計師事務所	無保留意見
2014年度	王儀雯、黃樹傑	勤業眾信聯合會計師事務所	無保留意見

二、最近五年度財務分析

1. 財務比率分析-依國際財務報導準則

分析項目 \ 年度		最近五年度財務分析				
		2010年度(註1)	2011年度(註1)	2012年度(註2)	2013年度(註2)	2014年度(註2)
財務結構(%)	負債佔資產比率	-	-	13.63	13.06	16.29
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	-	-	613.49	505.28	775.69
償債能力%	流動比率	-	-	571.12	540.39	497.43
	速動比率	-	-	467.69	476.67	412.39
	利息保障倍數	-	-	8,675.25	-	-
經營能力	應收款項週轉率（次）	-	-	6.61	5.87	8.30
	平均收現日數	-	-	55	62	44
	存貨週轉率（次）	-	-	9.29	10.83	20.74
	應付款項週轉率（次）	-	-	10.95	14.46	35.35
	平均銷貨日數	-	-	39	34	18
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	-	-	8.71	9.02	13.68
	總資產週轉率（次）	-	-	1.47	1.42	1.8
獲利能力	資產報酬率（%）	-	-	1.20	6.20	8.08
	權益報酬率（%）	-	-	1.43	7.16	9.52
	稅前純益占實收資本額比率（%）	-	-	6.44	28.21	47.18
	純益率（%）	-	-	0.82	4.38	4.5
	每股盈餘(元)	-	-	0.41	2.10	3.77
現金流量	現金流量比率（%）	-	-	182.24	187.25	145.69
	現金流量允當比率(%)	-	-	56.70	69.06	87.62
	現金再投資比率（%）	-	-	20.79	20.77	19.92
槓桿度	營運槓桿度	-	-	15.98	5.93	5.68
	財務槓桿度	-	-	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達20% 者可免分析）

(1) 負債佔資產比率:2014年較2013年上升24.73%，係因2014年購料增加，應付帳款增加及預收客戶款增加所致。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率: 2014年較2013年上升53.52%，係2014年現金增資及獲利成長，股東權益增加所致。

(3) 應收款項週轉率、平均收現日數: 2014年應收款項週轉率較2013年度上升1.40%，主係2014年度營收成長，另因與部分客戶(如比特幣運算晶片專案)之授信條件為預收，致應收帳款週轉率上升及收款天數下降。

(4) 存貨週轉率、平均銷貨日數: 2014年存貨週轉率較2013年度上升91.51%，主係2014年度日系及韓系電視晶片量產需求增加，銷貨成本大幅提升，致存貨周轉率上升及銷貨天數下降。

(5) 應付帳款週轉率: 2014年較2013年上升144.47%，主係2014年度日系及韓系電視晶片量產需求增加致銷貨成本大幅提升。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率: 2014年較2013年上升51.66%，係因2014年營收成長比率大於不動產、廠房及設備增加比率所致。

(7) 總資產週轉率: 2014年較2013年上升26.76%，係因2014年營收成長所致。

(8) 資產報酬率:2014年較2013年上升30.32%，係2014年獲利上升所致。

(9) 權益報酬率: 2014年2013年上升32.96%，係2014年獲利上升所致。

(10)稅前純益佔實收資本額比率: 2014年較2013年上升67.25%，係2014年獲利上升所致。

(11)每股盈餘: 2014年較2013年上升79.52%，係2014年獲利上升所致。

(12)現金流量比率:2014年較2013年下降22.19%，係因2014年流動負債增加比率大於營業活動淨現金流入比率增加所致。

(13)現金流量允當比率: 2014年較2013年上升26.88% ，係2014年獲利上升，營業活動淨現金流入增加所致。

註1：2010~2012年度係依我國會計準則編製之財務資料，請參考下表2。

註2：2012~2014年為經會計師查核之合併財務報告。

註3：計算公式如下:

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／ 不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／ 平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 4）

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。(註 5)

6.槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／ 營業利益(註 6)。

(2)財務槓桿度＝營業利益 ／ (營業利益－利息費用)。

註 4：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。

2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。

3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。

4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註 5：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。

4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

註 6：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

註 7：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

2. 財務比率分析-依我國財務會計準則

年度 分析項目			最近五年度財務分析				
			2010 年度(註 1)	2011 年度(註 1)	2012 年度(註 2)	2013 年度(註 2)	2014 年度(註 2)
財務結構(%)	負債佔資產比率		18.23	17.70	13.78	-	-
	長期資金佔固定資產比率		450.65	422.84	605.98	-	-
償債能力%	流動比率		414.14	425.40	573.13	-	-
	速動比率		327.87	351.87	470.74	-	-
	利息保障倍數		50.53	473.31	5,396.25	-	-
經營能力	應收款項週轉率（次）		8.42	7.88	7.88	-	-
	平均收現日數		43	46	46	-	-
	存貨週轉率（次）		8.52	8.38	9.09	-	-
	應付款項週轉率（次）		9.78	9.79	10.78	-	-
	平均銷貨日數		43	44	40	-	-
	固定資產週轉率（次）		7.34	7.25	10.52	-	-
	總資產週轉率（次）		1.33	1.41	1.50	-	-
獲利能力	資產報酬率（%）		16.89	3.59	0.5	-	-
	股東權益報酬率（%）		38.74	4.36	0.6	-	-
	占實收資本比率（%）	營業利益	49.24	19.68	8.76	-	-
		稅前純益	50.63	15.34	4.01	-	-
	純益率（%）		10.53	2.49	0.35	-	-
	每股盈餘(元)		7.95	1.23	0.17	-	-
現金流量	現金流量比率（%）		49.63	105.92	163.59	-	-
	現金流量允當比率（%）		11.90	32.58	52.01	-	-
	現金再投資比率（%）		5.92	17.36	17.55	-	-
槓桿度	營運槓桿度		3.22	9.63	21.3	-	-
	財務槓桿度		1.02	1.00	1.00	-	-

註 1：2010~2012 年為經會計師查核之合併財務報告。

註 2：2012~2014 年係依國際財務報導準則編製之財務資料，請參考上表 1。

註 3：計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債佔資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金佔固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／ 固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)總額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一百零三年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配之議案，其中合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯、黃樹傑會計師進行查核。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分配之議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司一百零四年股東常會

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

審計委員會召集人：洪茂蔚

中　華　民　國　　一　　百　　零　　四　　年　　三　　月　　五　　日

四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表及附註或附表：不適用。

五、最近年度(2014 年)經會計師查核簽證之合併財務報告(不含重要會計項目明細表)：詳第 105 頁至第 161 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

柒、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析：最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未來因應計劃：

(一) 財務狀況比較分析：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	2013 年度	2014 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,344,212	2,689,501	1,345,289	100.08%
長期投資	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	327,780	358,202	30,422	9.28%
無形資產	206,642	179,262	(27,380)	(13.25%)
資產總額	1,904,952	3,319,202	1,414,250	74.24%
流動負債	248,750	540,679	291,929	117.36%
長期負債	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-
負債總額	248,750	540,679	291,929	117.36%
股本	539,473	634,818	95,345	17.67%
資本公積	731,887	1,418,141	686,254	93.77%
保留盈餘(待彌補虧損)	414,213	615,653	201,440	48.63%
其他權益	(29,371)	109,911	139,282	474.22%
股東權益總額	1,656,202	2,778,523	1,122,321	67.76%

重大變動項目說明：(金額變動達10%以上，且金額達當年度資產總額1%)

(1) 流動資產：主係因2014年度現金增資所致。

(2) 資產總額：主係因2014年度現金增資所致。

(3) 流動負債、負債總額：係因2014年晶圓產品量產增加，應付購料金額、加工費、矽智財權金額及預收貨款金額增加所致。

(4) 股本、資本公積：係因2014年現金增資及員工行使認股權所致。

(6) 保留盈餘：主係因2014年獲利大幅上升所致。

(7) 其他權益：主要係匯率變動造成外幣財務報表換算之兌換差額變動。

(8) 股東權益總額：主係因2014年獲利大幅上升及現金增資所致。

(二) 影響：無重大影響。

(三) 未來因應計劃：不適用。

二、財務績效分析：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業之可能影響及因應計劃：

(一) 經營結果比較分析：

單位：新台幣仟元；%

年度 / 項目	2013 年度	2014 年度	增減變動	
			金額	變動比例%
營業收入淨額	2,583,563	4,691,741	2,108,178	81.60%
營業成本	1,825,700	3,738,434	1,912,734	104.77%
營業毛利	757,863	953,307	195,444	25.79%
營業費用	571,805	611,109	39,304	6.87%
營業淨利	186,058	342,198	156,140	83.92%
營業外支出	(33,883)	(42,690)	8,807	25.99%
稅前淨利	152,175	299,508	147,333	98.62%
所得稅費用	39,051	88,322	49,271	126.17%
本期損益	113,124	211,186	98,062	86.69%
重大變動項目說明：(金額變動達 10%以上，且金額達當年度資產總額 1%) (1) 營業收入：係因2014年晶圓產品量產收入增加所致。 (2) 營業成本，營業毛利：主要係 2014 年晶圓產品量產營業收入增加，相關製造成本增加，致營業成本及營業毛利增加。 (3) 所得稅費用：主要係 2014 年獲利增加，所得稅費用增加及認列日本子公司之前年度所得稅費用所致。				

(二) 預期銷售數量與其依據：

本公司除參照各研究機構之市場分析外，並依客戶之預估需求，考量產能規劃及過去經營績效為依據，訂定年度出貨目標。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

本公司所處行業仍處成長階段，且金融危機所造成的影響逐漸消弭，本公司將隨時注意市場需求的變動情勢，擴大市場占有率，提昇公司獲利，公司未來業務應可持續成長，財務狀況亦良好。

三、現金流量分析：

(一) 最近年度(2014 年)現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	2013 年	2014 年	增(減)金額	增(減)比例(%)
營業活動	465,790	787,738	321,948	69.12%
投資活動	(513,055)	(810,474)	297,419	57.97%
融資活動	90	769,815	769,725	8552.50%
變動分析： (1) 營業活動：2014 年營業活動淨現金流入增加 321,948 仟元，係因 2014 年獲利成長所致。 (2) 投資活動：2013 年度投資活動淨現金流出增加 297,419 仟元，係因購置機器設備款增加及無活絡市場之債券投資增加所致。 (3) 籌資活動：2014 年籌資活動淨現金流入增加，係因現金增資所致。				

(二) 未來一年(2016 年)現金流動性分析及流動性不足之改善計畫：

本公司自有資金充足，營業活動呈現淨現金流入狀態，應可支應投資活動及融資活動之現金流出，尚無流動性不足之虞。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

(一) 本公司轉投資政策：

本公司目前轉投資政策以基本業務相關投資標的為主，並不從事其他行業之投資，由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序並經董事會或股東會討論通過。

(二) 最近年度轉投資獲利或損失之主要原因：

單位：新台幣仟元

項目	2014 年度認列(損)益	轉投資政策	獲利或虧損原因	改善計劃
Alchip (HK)	19,480	轉投資大陸上海及無錫子公司。	為控股公司，認列權益法投資損益，並支付相關費用所致。	不適用
Alchip (US)	(8,468)	作為美國市場之銷售據點為目的。	為銷售據點，須負擔日常營運之費用，致使產生稅後淨損。	不適用
Alchip (JP)	(28,565)	拓展日本市場之重要據點，並提供有關銷售及研發支援。	因 2014 年度認列之前年度所稅費用，致產生稅後淨損。	不適用
Alchip (TW)	228,780	本集團營運總部，提供產品製造及研發服	營運狀況穩定成長，獲利水準尚屬穩	不適用

		務，並作為拓展亞太市場之據點。	定。	
Alchip (Shanghai)	2,326	開發中國市場之重要據點，並提供有關銷售及研發支援服務。	營運狀況穩定成長，獲利水準尚屬穩定。	不適用
Alchip (Wuxi)	17,367	提供研發支援服務。	營運狀況穩定成長，獲利水準尚屬穩定。	不適用

六、最近年度及截至年報刊日止風險事項評估：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率：

本公司 2013 年度及 2014 年無利息費用支出，惟本公司日後若有向金融機構融資之需要，且利率水準走高，利息支出將影響本公司獲利能力。

2. 匯率：

本集團係以美金為功能性貨幣，銷售及採購多以美金結算，另持有新臺幣，人民幣及日幣做為各子公司之日常營運資金所需。本公司 2013 及 2014 年度兌換(損)益分別為2,977仟元及(11,874)仟元，佔當期營業利益之比率分別為1.6%及3.47%，影響比例極低。

本集團目前尚無重大的匯率波動風險，然申請在台上市掛牌之開曼控股公司預料未來可能因發放新台幣股利予國內投資人或在國內籌資取得新台幣資金後必須兌回美金使用，將會有美元對台幣的匯率變動風險，本公司財務部門可能採取之因應措施如下：

(1)財務人員依據匯率未來走勢於適當時機維持適當之外匯部位，以提供集團內各子公司之營運所需，降低匯率變動對該發行公司獲利之影響。

(2)與主要往來銀行保持密切聯繫，隨時監控外匯市場之變化，以供相關主管人員充分掌握匯率變動趨勢，若因應偶發收付款幣別改變之情事可即時進行適時調節。

(3)對外貨幣風險採取自然沖銷原則（即外銷與進口全部以美元報價），並視需要在適當時機運用遠期外匯合約以及舉借外幣債務等方式，以降低匯兌變化對公司損益的影響。

3. 通貨膨脹/緊縮：

本公司致力加速推出新產品，以高品質、高效能或整合性單晶片產品來減緩價格下滑速度，並隨時調整銷貨策略、成本結構及交易條件以因應通貨緊縮帶來之影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 從事高風險、高槓桿投資投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司自成立以來即專注本業之耕耘發展，重視本業技術之研發及業務行銷之拓展，且本公司向以穩健經營為原則，並以財務健全為發展前提，故最近年度及截至年報刊印日止並未從事高風險、高槓桿投資之行為。

2. 從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」等辦法，作為本公司及從屬公司從事相關行為之遵循依據。最近年度及截至年報刊印日止，本公司有對從屬公司從事資金貸予及背書保證事項，皆依照上述管理辦法辦理。另最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未從事衍生性商品交易，故風險尚屬有限。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：
為因應未來的成長，本公司將持續投入研發資源發展先進製程(28 奈米及以下)高階系統晶片(SoC)與客製化電路矽智財(IP)之設計研發，主要研發項目包括：低功耗設計流程(Low Power Design Flow)；時脈電路(Clocking Optimization)自動優化技術；信號完整性(Signal Integrity)管理技術；客製化電路矽智財設計開發例如高速行動產業處理器介面(MIPI)電路之設計開發；高階 E 公司微處理器及其周邊矽智財之效能提升，以及高階多晶片封裝設計技術等。
本公司 2013 年及 2014 年研發費用金額分別為 338,024 仟元及 368,021 仟元，均有臺幣上億元之水準。未來將視產品開發計畫持續投入研發資源。惟本公司未來若未持續投入研發資源，產品發展及相關研發計畫將受限，或將使本公司無法滿足市場潮流或客戶需求，進而發生訂單流失之可能，本公司之營運將產生重大不利影響。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：
本公司註冊地國為開曼群島，開曼群島係以金融服務為主要經濟活動，經濟開放且無外匯管制，政經環境穩定。主要營運地國則為臺灣及中國，本公司設計、生產及銷售之晶片多數終端應用係 3C（Computing 電腦、Communication 通信及 Consumer electronics 消費性電子）產品，屬民生消費品應非屬特許或限制行業，且本公司各項業務之執行均依照各營運地國主管機關法令規定辦理，最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
本公司一向著重研發能力之提升，目前設計及生產之晶片多數為 28nm 或以下製程之產品，預期中長期尚無因科技改變或產業變化而對公司財務業務產生重大不利影響。惟本公司若無法及時掌握市場脈動與未來產業變化及發展趨勢，本公司將無法推出市場所需產品，營運可能面臨重大不利影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：
本公司本著穩健踏實的精神經營企業，自成立以來，積極強化內部管理，提升品質及效率，並無企業形象改變造成危機管理之情事。若未來有企業形象改變導致影響本公司對企業危機管理能力，將使本公司無法即時因應景氣或市場變化，進而對本公司營

運造成不利影響。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度截至公開說明書刊印日止，本公司並無進行任何併購行為。若本公司未來從事併購或業務重整行為，並不保證此併購或業務重整行為對本公司營運一定有正面影響，因為併購或業務重整行為將使本公司無法專注本業或有企業文化衝擊、人才流失等負面效應，進而對本公司營運造成不利影響。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為一 IC 設計公司，且採無晶圓廠(Fabless)營運模式，目前及未來並無擴充廠房之計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中：

本公司主要原料為晶圓(Wafer)，且 9 成係向台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱台積電)採購，確實有進貨集中現象。由於本公司並未與晶圓代工廠簽訂長期供貨合約，若晶圓代工廠未給予充足之產能支援，本公司可能發生供貨短缺或中斷之風險。惟本公司針對晶圓產能採取與廠商策略聯盟以及業務結合的關係，適時提供產品在市場上最新應用趨勢及產品預估銷售量，以便晶圓廠能夠及時支援產能需求，同時每月取得台積電半年以上的產能計畫以供生產備料所需；另本公司已建立第二供貨來源(second source)，以增加供貨來源之機動性，避免供貨短缺或中斷之情事。

2. 銷貨集中：

本公司 2013 年及 2014 年第一大銷售客戶為某日系消費性電子大廠，銷貨比重分別為 36%及 32%，致本公司營收較易受該客戶之績效影響而波動。惟本公司於過去年度以來，已持續致力於新客戶之開拓，分散客源，以期降低此風險，其營收比重已逐年下降。

本公司於 2012 年底取得韓系數位電視大廠訂單，其效益已於 2013 年顯現，2013 及 2014 年營收比重分別占本公司全年度營收之 11.47%及 17.62%。另本公司於 2013 年投入比特幣挖礦機相關市場，屬本公司新的利基市場，2013 年及 2014 年營收比重分別占本公司全年度營收之 9.74%及 23.22%，然因該市場屬尚在初期發展階段，未來是否能繼續穩定成長並成熟，尚取決於各國政府未來對該市場相關法規、政策，以及市場狀況等因素。本公司將持續致力於新客戶拓展，以降低風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

1. 本公司持股超過百分之十之 SB Asia Infrastructure Fund L.P.與大股東英屬開曼群島商旭揚半導體 II 創業投資股份有限公司 2014 年度減少本公司持股別為 521 仟股與 939 仟股。其減持比例占其總持股比例甚微，為正常之持股調節對公司財務或業務並無重大影響。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司尚無經營權改變之情事。本公司已加強各項公司治理措施，以期提升整體股東權益之保障。且本公司日常營運多倚賴專業經理人，目前堅強的專業經理人團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻，將來應可持續獲得股東的支持，故若經營權改變，對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

事實	標的金額(新台幣元)	訴訟開始日期	涉訟當事人	目前處理情形	備註
客戶應收帳款催款	4,893,908	2014 年 1 月 28 日	債權人:世芯電子(台灣) 債務人:常翔科技(股)公司	已取得支付命令確定證明書	
客戶應收帳款催款	2,566,681	2014 年 4 月 10 日	債權人:世芯電子(台灣) 債務人:常翔科技(股)公司	已取得支付命令確定證明書	

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司,最近二年度及截至本年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

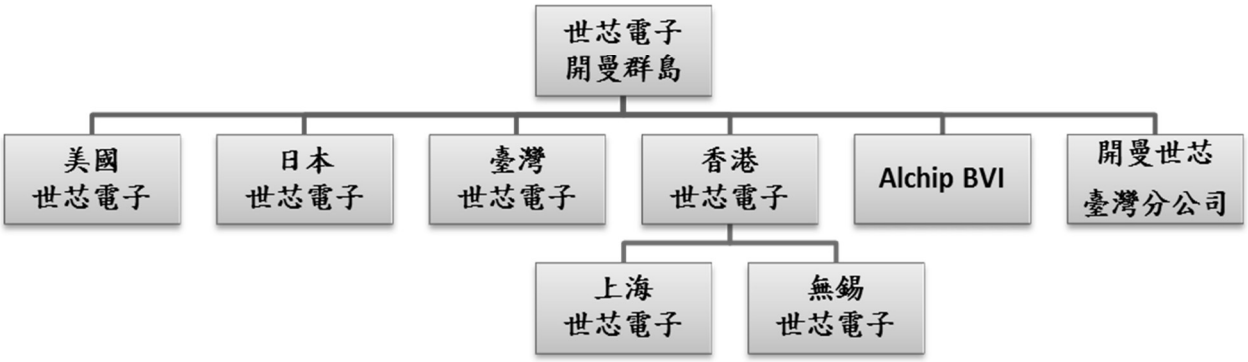
(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項: 無。

捌、 特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖



註: Alchip BVI 係於 2015 年 1 月成立

(二) 各關係企業基本資料

2014 年 12 月 31 日

轉投資事業	主要營業	投資年度	投資金額(仟元)	投資目的	持股比率	會計處理方法
香港世芯電子	一般投資	2002 年	HKD126,161	轉投資大陸上海及無錫子公司	100%	權益法
美國世芯電子	研究、開發及設計ASIC 及 SOC 並提相關服務與銷售	2003 年	USD3,910	美國市場之銷售據點	100%	權益法
日本世芯電子	研究、開發及設計ASIC 及 SOC 並提相關服務與銷售	2004 年	JPY210,000	日本市場之重要據點，並提供有關銷售及研發支援	100%	權益法
臺灣世芯電子	研究、開發及設計ASIC 及 SOC 並提相關服務與銷售	2005 年	NTD250,000	營運總部，目前負責產品製造管理，並提供有關銷售及研發支援	100%	權益法
上海世芯電子	研究、開發及設計ASIC 及 SOC 並提相關服務與銷售	2002 年	USD12,800	中國市場之重要據點，並提供有關銷售及研發支援	100%	權益法
無錫世芯電子	研究、開發及設計ASIC 及 SOC 並提相關服務	2012 年	USD2,000	研究、開發設計支援	100%	權益法

(三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司整體關係企業皆從事專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)及系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產業務。

(五) 各關係企業董事、監察人及總經理資料

2014 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
台灣世芯電子	董事長 總經理 董事 董事 監察人	關建英(Kwan,Kinying) 沈翔霖 沈翔霖(Shen,Johnny Shyang-Lin) 姜榮華 張國威	開曼世芯電子持有25,000,000股	100%
日本世芯電子	董事長 總經理 董事 董事 監察人	藤田浩三 藤田浩三 保坂純一郎 關建英(Kwan,Kinying) 長島博之	開曼世芯電子持有2,000股	100%
美國世芯電子	董事	關建英(Kwan,Kinying)	開曼世芯電子持有391,000,000股	100%
香港世芯電子	董事長 董事	關建英 關建英(Kwan,Kinying)	開曼世芯電子持有11,831,970,100股	100%
上海世芯電子	執行董事 總經理	關建英(Kwan,Kinying) 沈翔霖(Shen,Johnny Shyang-Lin)	開曼世芯電子出資額美金12,800仟元	100%
無錫世芯電子	執行董事 總經理	沈翔霖(Shen, Johnny Shyang- Lin) 鄭永力	開曼世芯電子出資額美金2,000仟元	100%

(六) 各關係企業營運概況

2014 年 12 月 31 日；單位:新台幣仟元

企業名稱	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利(淨損)	本期淨利(淨損)	每股盈餘(元)
台灣世芯電子	1,525,603	620,742	904,861	3,915,808	321,034	228,780	-
日本世芯電子	207,345	173,149	34,196	316,776	11,233	(28,565)	-
美國世芯電子	23,232	24,903	(1,671)	33,393	(8,468)	(8,468)	-
上海世芯電子	359,529	26,567	332,962	189,191	6,693	2,326	-
無錫世芯電子	52,377	7,249	45,128	60,227	12,693	17,367	-
香港世芯電子	382,105	329	381,776	-	(213)	19,480	-

(七) 關係企業合併財務報表聲明書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明

(一) 公司章程或組織文件中訂定保障股東權益行使之具體內容與台灣法規有關股東權益保護重要事項差異處：

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
壹、公司資本之形成及變動			
1. 公司非依股東會決議減少資本，不得銷除其股份；減少資本，應依股東所持股份比例減少之。 2. 公司減少資本，得以現金以外財產退還股款；其退還之財產及抵充之數額，應經股東會決議，並經該收受財產股東之同意。 3. 前項財產之價值及抵充之數額，董事會應於股東會前，送交中華民國會計師查核簽證。	公司法第 168 條	1.開曼公司法第 14 條允許公司得減少已發行之資本，但須經股東會以特別決議（Special Resolution）之方式，並經開曼法院確認後，始得為之。 2.除開曼公司法第 14 條外，公司已發行之資本，只有在公司根據開曼公司法第 37 條或第 37B 條之規定，買回、繳回或回贖時，才可消除。 3.開曼公司法第 37 條規定，公司得依公司章程或經由股東會決議之方式及條件，買回自身股份。除第 37 條之規定外，開曼公司法並無規定：(1)應依股東持股之比例予以買回，(2)以現金以外之財產退還股款時應經批准，或(3)對退還之財產價值應經評估。但得以公司章程加以規定。	公司章程第 10.7 條與左列股東權益保護重要事項略有差異，蓋於開曼公司法下，已發行股份之減少需股東會以特別決議之方式，並經開曼法院確認後，始得為之。有鑑於此，公司章程第 14.1 條、第 10.7 條規定公司減少資本之程序，係透過股份買回之方式為之，此等差異係因開曼公司法規定所生，惟公司章程並未對公司減少資本之程序加以限制，故該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
1. 公司與員工簽訂認股權契約或發行員工認股權憑證之程序。 2. 員工認股權憑證不得轉讓，但因繼承者不在此限。	公司法第 167 條之 2	開曼公司法並未就員工認股權契約或發行員工認股權憑證之程序等事項，訂有特別規定。發行員工認股權憑證及該憑證得否轉讓等，應於員工認股權契約或認股權憑證中訂定之。	雖公司章程第 11.1 至 11.4 條已經依據左列股東權益保護重要事項進行修正，惟依開曼法律之規定，若欲限制員工認股權憑證之轉讓，仍應於員工認股權契約或認股權憑證中訂定之。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
貳、股東會之召集程序與決議方式			
1. 股東常會每年至少須召集一次；應於每會計年度終了後六個月內召開。股東會由董事會召集之。 2. 股東會應於中華民國境內召開之。若於中華民國境外召開股東會，應於董事會決議或股東取得主管機關召集許可後二日內申報證券交易所同意。 3. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案股東持股未達百分之一、提案非股東會得決議、或提案超過一項者，均不列入議案。 4. 股東繼續一年以上，持有已發	1. 公司法第 170 條 2. 公司法第 172 條之 1 3. 公司法第 173 條第 1 項、第 2 項 4. 公司法第 172 條、證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之 6	1.(a)開曼公司法第 58 條規定，除豁免公司（exempted company）外，每家公司每年應至少召開一次股東大會。 (b)開曼公司法並未強制規定豁免公司應召開股東常會，公司得自行於其章程中規定公司每年應召開股東會之次數。 2.開曼公司法並未限制豁免公司之股東會應於特定地點召開，但得以公司章程加以規定。 3.開曼公司法對於股東召集股東會或股東提案權並無規定，相關程序得訂定於章程中。 4.開曼公司法對股東會通知內容並無規定，但得以公司章程加以規定。 5.開曼公司法並未規定股東會召	外國發行人係開曼法律下之豁免公司，依開曼公司法之規定，雖無必要每年召開股東大會，惟已於公司章程第 16.2 條規定：「公司應於每一會計年度終了後六個月內召開一次股東會作為年度股東常會，並應在股東會召集通知中詳細說明。在股東會上，董事會應作相關報告（如有）。」。 其他事項分別規定於公司章程第 16.2、16.3、16.4、18.9 條、16.5 至 16.8、及 17.5 條。 依據臺灣證券交易所 99 年 4 月 13 日臺證上字第 0991701319 號函：

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
行股份總數百分之三以上者，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會。請求提出後十五日內，董事會不為召集之通知時，股東得報經主管機關許可，自行召集。 5. 下列事項，應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出： (1) 選任或解任董事、監察人； (2) 變更章程； (3) 公司解散、合併、股份轉換、分割； (4) 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與或他人經常共同經營之契約； (5) 讓與全部或主要部分之營業或財產； (6) 受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者； (7) 私募發行具股權性質之有價證券。 (8) 董事從事競業禁止行為之許		集之細節，相關程序得以章程加以規定。	「說明：二、(三)外國發行人於不抵觸註冊地法令之前提下，應於章程訂定少數股東請求召集股東臨時會之權，至許可召集之主管機關部分，應可刪除。」故公司章程第16.8 條規定：「如董事會於前述股東提出請求日起十五日內未為股東臨時會召集之通知者，則提出請求之股東得依據公開發行公司法令自行召集股東臨時會。」。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
可； (9) 以發行新股方式，分派股息及紅利之全部或一部分； (10) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積，以發行新股方式，分配與原股東者。			
1. 公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；但公司符合中華民國證券主管機關頒布之「公司應採電子投票之適用範圍」者，應將電子方式列為表決權行使管道之一。 2. 公司於中華民國境外召開股東會者，應提供股東得採行以書面或電子方式行使表決權。 3. 公司以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。	1. 公司法第 177 條之 1 2. 公司法第 177 條之 2	1. 股東不得以書面或電子方式於股東會行使其投票權。但如公司章程有明訂者，股東得以書面或電子方式委任代理人在會議中行使其股份之投票權。 2. 股東如透過代理人行使其表決權者，不會被視為親自出席股東會。 3. 公司章程中得訂定交付委託書之規定。 4. 開曼公司法並無股東撤銷委託書之規定。但根據普通法之原則，不論公司章程有無任何相反之規定，親自出席股東大會進行表決的股東應有優先效力。但公司章程仍得訂定非由股東親自出席股東大會時有關撤銷委託之相關規定。	公司章程第 19.6 條係規定：「以前述方式行使表決權的股東應被視為已指派股東會主席為其代理人，並依書面或電子文件中之指示，在股東會中行使其股份之表決權」。開曼法律雖認為透過此種方式行使表決權之股東將不會被視為親自出席股東會，但該股東實質上仍得享有依據中華民國法令以書面或電子方式行使表決權股東之所有權利，對公司股東之權益應無重大不利影響。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
4. 股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 5. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 6. 股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。			
股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得訴請法院撤銷其決議，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。	公司法第 189 條	公司章程加入此種規定，在開曼法律下可能無法被執行，因為開曼法院無法在未重新檢視系爭糾紛之法律依據前，承認及執行一個非金錢給付之外國判決。	公司章程第 18.7 條規定：「章程任何內容不得妨礙任何股東向有管轄權之法院提起訴訟，以尋求與股東會召集程序之不當或不當通過決議有關的適當救濟，因前述事項所生之爭議得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。」該規定與左列股東權益保護重要事項略有

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
			差異。左列股東權益保護重要事項實為股東法定撤銷訴權之規定，其法律效果並非章程規定所能達成，需有法律規定賦予股東此項撤銷訴權。公司章程第 18.7 條之規定，雖與左列股東權益保護重要事項之規定略有不同，然如股東會之召集程序或其決議方法有違反法令或章程時，公司章程並未限制股東向法院提起訴訟或救濟之權利，至於法院是否受理，及受理之法院是否撤銷該召集程序或決議方法違反法令或公司章程之股東會決議，則應由該法院（不論係中華民國或開曼或其他有管轄權國家之法院）審酌其所應適用之法律，是否有賦予股東撤銷訴權，並依其職權裁判之。此等差異係因股東撤銷訴權本質所致，且公司章程並未限制股東向法院提起訴訟或救濟之權利。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
下列涉及股東重大權益之議案，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數同意為之。出席股東之股份總數不足前述定額者，得以有代	1. 公司法第 185 條 2. 公司法第 227 條 3. 公司法第 277 條 4. 公司法第 240 條第 1 項 5. 公司法第 316 條	1.依據開曼公司法第 60 條之規定，特別決議（Special Resolution）係指於股東會上以投票方式進行表決者，經不低於有權於該股東會行使表決權並親	1. 公司章程第 1.1 條 （a） 公司章程規定 公司章程第 1.1 條規定，特別決議係指：「指經有權於該股東會行使表決權之股東表決權數三分之二

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之： 1. 公司締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與或他人經常共同經營之契約、讓與全部或主要部分之營業或財產、受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者 2. 變更章程 3. 章程之變更如有損害特別股股東之權利者，另需經特別股股東會之決議 4. 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部 5. 解散、合併或分割之決議		自或委託代理人(如該股東會允許委託書)行使表決權之股東表決權數之三分之二(如章程訂有較高表決權數者,從其規定)之同意所為之決議。在一般開曼公司章程中，通常會規定該股東會通知應載明該議案應以特別決議為之。如經公司章程授權時，亦得以全體股東所簽署之書面決議，視為已作成特別決議。在需要以計票方式作為表決方式，以計算是否屬特別決議之多數決時，公司章程得規定每一股東所享有之表決權數。 2.依開曼公司法之規定，應經特別決議之事項包括： (i) 變更公司名稱(第 31 條)； (ii) 修改或增訂公司章程(第 24 條)； (iii) 修改或增訂章程大綱有關宗旨、權力或其他特別載明之事項(第 10 條)； (iv) 減資及資本贖回準備金(第 14 條及第 37(4)(d)條)； (v) 因無法於其債務到期時清償以外之事由，所為之自願解散(第 90(b)(i)條及第 116(c)條)。	以上同意之決議。該股東得親自行使表決權或委託經充分授權之代理人（如允許委託代理人，須於股東會召集通知中載明其為特別決議）代為行使表決權。」依據開曼法律意見書，應經特別決議之事項應包括但不限於：(i)變更公司名稱；(ii)修改或增訂公司章程；(iii)修改或增訂章程大綱有關宗旨、權力或其他特別載明之事項；(iv)減資及資本贖回準備金;(v)因無法於其債務到期時清償以外之事由，所為之自願解散者；及(vi)與其他公司合併（merger）或整合（consolidation）。另依公司章程第 18.1 條規定：「除出席股東代表股份數達到法定出席股份數，股東會不得為任何決議。除章程另有規定外，代表已發行股份總數過半數之股東親自或委託代理人出席，應構成股東會之出席法定權數。」亦即如欲作成公司之特別決議，至少須經代表該公司已發行股份總數過半數之股東親自或委託代理人出席，且以出席股東（包括以委託書委託代理人出席者）並行使表決權之三分之二表決權數以上同意為之。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
		(vi) 與其他公司合併(merger)或整合(consolidation)。 依開曼公司法須經特別決議之事項，不得以較低之多數決方式加以通過。 3.對於上述所列以外之事項，開曼公司法並未要求須達到某特定多數，但得以公司章程加以規定。	（b） 差異原因 依據開曼法律意見書，特別決議為開曼公司法之規定，且依開曼公司法之規定，應經特別決議之事項，不得以較低之多數決方式加以通過。又公司章程第 1.1 條中另對「特別（重度）決議」（Supermajority Resolution）加以定義，係指「(i)由代表公司已發行股份總數三分之二或以上之股東（包括股東委託代理人）出席股東會，出席股東表決權過半數同意通過的決議，或(ii)若出席股東會的股東代表股份總數雖未達公司已發行股份總數三分之二，但超過公司已發行股份總數之半數時，由出席股東表決權三分之二或以上之同意通過的決議。」 對於左列股東權益保護重要事項，如依據開曼公司法係應經特別決議者，則於公司章程中仍列為「特別決議」事項；否則，則列為「特別（重度）決議」事項。 2. 公司章程第 14.3 條 （a） 公司章程規定： 公司章程第 14.3 條規定：「在不違反法令、章程及公開發行公司法令之規定下，有關公司解散之程序：

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
			(a)如公司係因無法於其債務到期時清償而決議自願解散者，公司應以股東會特別（重度）決議為之；或(b)如公司係因前述第 14.3 條(a)款以外之事由而決議自願解散者，公司應以股東會特別決議為之」。與左列股東權益保護重要事項略有不同之處在於：公司章程就解散之決議，係依其決議解散之事由，而分別列為「特別（重度）決議」及「特別決議」事項，相較於此，左列股東權益保護重要事項則要求以一律要求以「特別（重度）決議」為之。 （b） 差異原因： 依據開曼法律意見書，依開曼公司法之規定，如公司係因無法於其債務到期時清償以外之其他事由而決議自願解散者，須以特別決議為之。由上可知，此等差異係因開曼法律所致。故公司章程規定「公司係因無法於其債務到期時清償而決議自願解散者」，應以特別（重度）決議為之；第 14.3 條(a)款以外之事由，則依開曼公司法之要求，列為「特別決議」事項。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
			上開差異，是因開曼法令之限制所致，該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
參、董事、監察人之權限與責任			
1. 公司董事或監察人，在任期中轉讓股份超過選任當時所持有公司股份數額二分之一時，當然解任。 2. 公司董事或監察人當選後，於就任前轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，或於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，其當選失其效力。	公司法第 197 條、公司法第 227 條	開曼公司法並未就董事持有開曼公司股份（無論是選任前或選任後）作明文規範，因此，有關董事持股之限制、當選無效或解任之效力等條文應於公司章程中明定。此外，建議應在各董事與公司間的委任契約中納入上開條文（全部列入或指示應遵照公司章程之規定），以確保將來公司如依章程解任董事或認定其當選無效時，董事不會主張公司違反委任契約。 開曼公司法並未規範公司應指派監察人。因此，有關監察人持股之限制、當選無效或解任之效力等條文應在其與公司簽訂之委任契約中明確規範。此等條文亦可在公司章程中記載，但能否在開曼法下執行尚不明確，除非委任契約中已包含該等規定。	左列股東權益保護重要事項，係於 2014 年 11 月 10 日由臺灣證券交易所所新增訂，公司擬於 2015 年股東常會通過章程修訂案，於章程第 28.2 條之增訂左列股東權益保護重要事項之內容。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
董事之報酬，未經章程訂明者，應由股東會議定，不得事後追認。	公司法第 196 條第 1 項	開曼公司法並未明文規定董事報酬如何決定，但得以公司章程加以規定。	公司雖未於章程中訂明董事報酬，或訂定應由股東會議訂之，惟參照經濟部民國 93 年 3 月 8 日商字第 09302030870 號解釋之意旨，以及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，公司董事會已設置薪資報酬委員會，故左列規定對於公司股東權益應無重大不利影響。
董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反法令或章程之重大事項者，股東會未為決議將其解任者，持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得於股東會後三十日內訴請法院裁判解任之，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。	公司法第 200 條	1. 開曼公司法並未特別明文規定少數股東得向開曼法院聲請解任董事。 2. 一般而言，董事解任之程序係規定於公司章程中，且通常規定應經股東會普通決議。 3. 依據普通法關於股東救濟之規定，在一個指控董事對公司為侵害之訴訟中，形式上適格之原告應為公司本身，而非股東個人或少數股東。上述原則只有少數之例外情形，包括當董事之行為構成對少數股東詐欺時，且該等為詐欺行為之人係公司之控制者，則受詐欺之少數股東得向法院提起訴訟。	(1)公司章程規定： 公司章程第 28.2(i)條(於 2015 年股東常會新版本通過後移為同條(j)款)規定：「除所應適用之相關法令另有規定外，董事若在其執行職務期間所從事之行為對公司造成重大損害，或嚴重違反相關適用之法律及/或規章或章程大綱和章程，但未經公司依特別（重度）決議將其解任者，則持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東有權自股東會決議之日起三十日內，以公司之費用，訴請有管轄權之法院解任該董事，而該董事應於該有管轄權法院為解任董事之終局判決時被解任之。為免疑義，倘一相關法

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
		4.公司章程中加入此等規定在開曼法律下可能無法被執行，因為開曼法院無法在未重新檢視系爭糾紛之法律依據前，承認及執行一個非金錢給付之外國判決。董事得以公司章程所規定之程序加以解任。	院有管轄權而得於單一或一連串之訴訟程序中判決前開所有事由者，則為本條款之目的，終局判決應係指該有管轄權法院所為之終局判決。」與左列之股東權益保護重要事項略有差異。 (2)差異原因： 由於開曼公司法並未明文規定允許少數股東得向開曼法院申請解任董事。在普通法下，股東代位訴訟僅在極少數之情況下被提起，爰於公司章程中，規定股東應向有管轄權之法院起訴。由於股東仍得依公司章程之規定解任董事，故對於公司股東權益應無重大不利影響。
1. 公司設置監察人者，由股東會選任之，監察人中至少須有一人在國內有住所。 2. 監察人任期不得逾三年。但得連選連任。 3. 監察人全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之。 4. 監察人應監督公司業務之執行，並得隨時調查公司業務及	公司法第 216 至 222 條。	開曼公司法並無相當於「監察人」之概念。對於以公司章程創設監察人之效力如何，並不明確。	公司章程第 32.6 條。 依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第 28-4 條第 2 項前段規定：「外國發行人應擇一設置審計委員會或監察人」。公司已設置由全體獨立董事組成之審計委員會(章程第 32.6 條)，故無須另設置監察人。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
財務狀況，查核簿冊文件，並得請求董事會或經理人提出報告。 5. 監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊，應予查核，並報告意見於股東會。 6. 監察人辦理查核事務，得代表公司委任會計師、律師審核之。 7. 監察人得列席董事會陳述意見。董事會或董事執行業務有違反法令、章程或股東會決議之行為者，監察人應即通知董事會或董事停止其行為。 8. 監察人各得單獨行使監察權。 9. 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員。			
1. 繼續一年以上持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得以書面請求監察人為公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。 2. 股東提出請求後三十日內，監察人不提起訴訟時，股東得為	公司法第 200、214、227 條。	1.開曼公司法並無相當於「監察人」之概念。對於以公司章程創設監察人之效力如何，並不明確。 2.依據普通法關於股東救濟之規定，在一個指控董事對公司為侵害行為之訴訟中，形式上適格之原告應為公司本身，而非股東個人或少數股東。上述原則只有少	公司章程第 25.6 條。 依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第 28-4 條第 2 項前段規定：「外國發行人應擇一設置審計委員會或監察人」。公司已設置由全體獨立董事組成之審計委員會，故無須另設置

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
公司提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。		數之例外情形，包括當董事之行為構成對少數股東詐欺時，且該等為詐欺行為之人係公司之控制者，則受詐欺之少數股東得向法院提起訴訟。 3. 公司章程中加入此等規定在開曼法律下可能無法被執行，因為開曼法院無法在未重新檢視系爭糾紛之法律依據前，承認及執行一個非金錢給付之外國判決。	監察人。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
董事或監察人(設置監察人公司適用)以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。	公司法第 197 條之 1、277 條。	開曼公司法並未規定（於何種情形下）董事所持有之股份無表決權，但得以公司章程加以規定。	公司章程第 24.3 條。 另，依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第 28-4 條第 2 項前段規定：「外國發行人應擇一設置審計委員會或監察人」。公司已設置由全體獨立董事組成之審計委員會，故無需另設置監察人。因此，前述章程之規定並不包括監察人在內。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
1. 公司之董事應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。該行為若係為	公司法第 8 條第 2 項、第 3 項、第 23 條第 3 項	1. 開曼公司法並特別規定董事之義務為具體規範。依據開曼之普通法，董事應對公司負(1)受託人義務(fiduciary duties)，以及(2)善良管理人之注意義務(duty of	公司章程第 26.5 條。 惟董事對於公司業務之執行，如有違反該法定義務致他人受有損害

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
自己或他人所為時，股東會得以決議，將該行為之所得視為公司之所得。 2. 公司之董事對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。 3. 公司之經理人、監察人在執行職務範圍內，應負與公司董事相同之損害賠償責任。		care)。公司得向違反上述義務之董事請求賠償。此外，若董事違反其義務並因此獲得利益者，公司得將該利益歸於公司。 2.根據普通法之原則，在管理公司業務的經營過程中，董事代表公司所為之行為將視為公司本身之行為。若其行為造成任何第三人之損害，應由公司而非由該董事，就其行為對該第三人負責。請求損害賠償之第三人並無法依據公司章程之規定請求及加諸義務於董事，非股東之第三人並無法依據公司章程而為執行。公司因董事違反義務而須對第三人負損害賠償責任時，公司得向造成損害之董事請求賠償。 3.經理人一般而言對公司並無受託人義務。因經理人並非章程之當事人，所以即使以章程加以規定，仍將不具執行力。上述義務應以契約方式與經理人約定。	時，該他人在開曼法律下不一定得直接對該董事訴請賠償，即使在公司章程中訂定董事對他人應與公司負連帶賠償責任者，亦無法創設該項請求權基礎。 此外，雖公司章程第 26.5 條已經規定該條義務於經理人亦有適用，惟依開曼法律應以契約方式與經理人約定。因此，若欲貫徹左列股東權益保護事項對於經理人之責任，應由公司與經理人以契約加以約定。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。
法人為股東時，得由其代表人當選為董事或監察人。代表人有數人時，得分別當選，但不得同時當選或擔任董事及監察人。	公司法第 27 條第 2 項	1.開曼公司法並未就法人股東之代表人當選董事為規範，但得以公司章程加以規定。 2.開曼公司法並無相當於「監察人」之概念。對於以公司章程創	公司章程第 27.4 條。 復依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第 28-4 條第 2 項前段規定：「外國發行人應擇一設置審計委員會或監

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	外國發行人註冊地國公司法令相關規定	公司章程規定及差異原因
		設監察人之效力如何，並不明確。	察人」。公司已設置由全體獨立董事組成之審計委員會，故無需另設置監察人。因此，前述章程之規定並不包括監察人在內。該差異對於公司股東權益應無重大不利影響。

六、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

會計師查核報告

Alchip Technologies, Limited　公鑒：

Alchip Technologies, Limited 及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達 Alchip Technologies, Limited 及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　王　儀　雯　　會計師　黃　樹　傑

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中　華　民　國　104　年　3　月　5　日

Alchip Technologies, Limited 及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	103年12月31日 金額	%	102年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$1,356,724	41	$ 556,552	29
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註六）	118,766	4	48,123	2
1170	應收帳款淨額（附註四、七及二二）	643,083	19	470,438	25
1200	其他應收款（附註四及七）	17,674	-	30,439	2
130X	存貨（附註四及八）	224,229	7	86,492	5
1410	預付款項（附註十一）	235,568	7	72,004	4
1470	質押定存單－流動（附註二三）	63,300	2	59,610	3
1470	其他流動資產	30,157	1	20,554	1
11XX	流動資產總計	2,689,501	81	1,344,212	71
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及九）	358,202	11	327,780	17
1821	無形資產（附註四及十）	179,262	5	206,642	11
1840	遞延所得稅資產（附註四及十七）	20,312	1	12,759	-
1920	存出保證金	14,626	-	13,253	1
1990	預付設備款	56,970	2	-	-
1980	質押定存單－非流動（附註二三）	329	-	306	-
15XX	非流動資產總計	629,701	19	560,740	29
1XXX	資產總計	$3,319,202	100	$1,904,952	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付帳款	$ 127,881	4	$ 83,618	4
2200	其他應付款（附註十二）	230,104	7	145,265	8
2230	當期所得稅負債（附註四及十七）	62,369	2	18,557	1
2310	預收貨款	119,223	3	-	-
2399	其他流動負債	1,102	-	1,310	-
21XX	流動負債總計	540,679	16	248,750	13
2XXX	負債總計	540,679	16	248,750	13
	歸屬於本公司業主之權益（附註四、十四及十五）				
3110	普通股股本	634,818	19	539,473	28
3200	資本公積	1,418,141	43	731,887	38
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	67,693	2	67,693	4
3350	未分配盈餘	547,960	17	346,520	18
3300	保留盈餘總計	615,653	19	414,213	22
3400	其他權益	109,911	3	(29,371)	(1)
3XXX	權益總計	2,778,523	84	1,656,202	87
	負債及權益總計	$3,319,202	100	$1,904,952	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：關建英　　經理人：沈翔霖　　會計主管：詹舒媚

Alchip Technologies, Limited 及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：美金仟元

代碼	資產	103年12月31日 金額	%	102年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 42,866	41	$ 18,673	29
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註六）	3,752	4	1,615	2
1170	應收帳款淨額（附註四、七及二二）	20,318	19	15,784	25
1200	其他應收款（附註四及七）	559	-	1,021	2
130X	存貨（附註四及八）	7,085	7	2,902	5
1410	預付款項（附註十一）	7,443	7	2,416	4
1470	質押定存單－流動（附註二三）	2,000	2	2,000	3
1470	其他流動資產	953	1	690	1
11XX	流動資產總計	84,976	81	45,101	71
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及九）	11,318	11	10,997	17
1821	無形資產（附註四及十）	5,664	5	6,933	11
1840	遞延所得稅資產（附註四及十七）	642	1	428	-
1920	存出保證金	462	-	445	1
1990	預付設備款	1,800	2	-	-
1980	質押定存單－非流動（附註二三）	10	-	10	-
15XX	非流動資產總計	19,896	19	18,813	29
1XXX	資產總計	$104,872	100	$ 63,914	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付帳款	$ 4,040	4	$ 2,806	4
2200	其他應付款（附註十二）	7,270	7	4,874	8
2230	當期所得稅負債（附註四及十七）	1,971	2	621	1
2310	預收貨款	3,767	3	-	-
2399	其他流動負債	35	-	44	-
21XX	流動負債總計	17,083	16	8,345	13
2XXX	負債總計	17,083	16	8,345	13
	歸屬於本公司業主之權益（附註四、十四及十五）				
3110	普通股股本	19,901	19	16,762	26
3200	資本公積	45,438	43	22,846	36
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	2,799	3	2,799	4
3350	未分配盈餘	20,001	19	13,356	21
3300	保留盈餘總計	22,800	22	16,155	25
3400	其他權益	(350)	-	(194)	-
3XXX	權益總計	87,789	84	55,569	87
	負債及權益總計	$104,872	100	$ 63,914	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：關建英　　經理人：沈翔霖　　會計主管：詹舒媚

Alchip Technologies, Limited 及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元或美金元外，餘係新台幣仟元或美金仟元

代碼		103年度			102年度		
		美金	新台幣	%	美金	新台幣	%
4000	營業收入淨額（附註四、十六及二二）	$ 154,815	$4,691,741	100	$ 87,021	$2,583,563	100
5000	營業成本（附註八及十六）	123,358	3,738,434	80	61,495	1,825,700	71
5900	營業毛利	31,457	953,307	20	25,526	757,863	29
	營業費用（附註十六）						
6100	推銷費用	3,084	93,463	2	3,018	89,612	3
6200	管理費用	4,937	149,625	3	4,865	144,169	6
6300	研究發展費用	12,144	368,021	8	11,376	338,024	13
6000	營業費用合計	20,165	611,109	13	19,259	571,805	22
6900	營業淨利	11,292	342,198	7	6,267	186,058	7
	營業外收入及支出（附註四及十六）						
7010	其他收入	346	10,490	-	231	6,846	-
7020	其他利益及損失	(1,732)	(52,474)	(1)	(1,366)	(40,554)	(1)
7050	財務成本	23	706	-	6	175	-
7000	營業外收入及支出合計	(1,409)	(42,690)	(1)	(1,141)	(33,883)	(1)
7900	稅前淨利	9,883	299,508	6	5,126	152,175	6
7950	所得稅費用（附註四及十七）	2,914	88,322	2	1,315	39,051	2
8200	本期淨利	6,969	211,186	4	3,811	113,124	4
	其他綜合損益						
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註四）	(156)	139,282	3	(118)	36,517	2
8500	本期綜合損益總額	$ 6,813	$ 350,468	7	$ 3,693	$ 149,641	6
	淨利歸屬於：						
8610	本公司業主	$ 6,969	$ 211,186	4	$ 3,811	$ 113,124	4
	綜合損益總額歸屬於：						
8710	本公司業主	$ 6,813	$ 350,468	7	$ 3,693	$ 149,641	6
	每股盈餘（附註十八）						
9710	基本	$ 0.12	$ 3.77		$ 0.07	$ 2.10	
9810	稀釋	$ 0.12	$ 3.65		$ 0.07	$ 2.08	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：關建英　　經理人：沈翔霖　　會計主管：詹舒媚

Alchip Technologies, Limited 及子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股股利為美元

代碼		股本	資本公積			保留盈餘			其他權益項目	權益總額
		股本	發行溢價	認股權	合計	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
A1	102 年 1 月 1 日餘額	$ 538,713	$ 693,996	$ 37,349	$ 731,345	$ -	$ 301,089	$ 301,089	($ 65,888)	$ 1,505,259
B3	依金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	67,693	(67,693)	-	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	1,212	1,212	-	-	-	-	1,212
K1	員工認股權計畫下發行普通股	760	(670)	-	(670)	-	-	-	-	90
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	113,124	113,124	-	113,124
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	36,517	36,517
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	113,124	113,124	36,517	149,641
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	539,473	693,326	38,561	731,887	67,693	346,520	414,213	(29,371)	1,656,202
B5	102 年度盈餘分配： 現金股利－每股 0.2 元	-	-	-	-	-	(9,746)	(9,746)	-	(9,746)
E1	現金增資	76,810	585,688	(1,932)	583,756	-	-	-	-	660,566
T1	股份發行成本	-	(6,952)	-	(6,952)	-	-	-	-	(6,952)
N1	股份基礎給付交易	-	-	2,038	2,038	-	-	-	-	2,038
K1	員工認股權計畫下發行普通股	18,535	119,606	(12,194)	107,412	-	-	-	-	125,947
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	211,186	211,186	-	211,186
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	139,282	139,282
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	211,186	211,186	139,282	350,468
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	$ 634,818	$ 1,391,668	$ 26,473	$ 1,418,141	$ 67,693	$ 547,960	$ 615,653	$ 109,911	$ 2,778,523

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：關建英　　經理人：沈翔霖　　會計主管：詹舒媚

Alchip Technologies, Limited 及子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：美金仟元，惟每股股利為美元

代碼		股本	資本公積			保留盈餘			其他權益項目	
			發行溢價	認股權	合計	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
A1	102 年 1 月 1 日餘額	$ 16,736	$ 21,654	$ 1,174	$ 22,828	$ -	$ 12,344	$ 12,344	($ 76)	$ 51,832
B3	依金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	2,799	(2,799)	-	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	41	41	-	-	-	-	41
K1	員工認股權計畫下發行之普通股	26	(23)	-	(23)	-	-	-	-	3
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	3,811	3,811	-	3,811
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(118)	(118)
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	3,811	3,811	(118)	3,693
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	16,762	21,631	1,215	22,846	2,799	13,356	16,155	(194)	55,569
B5	102 年度盈餘分配： 現金股利－每股 0.006 元	-	-	-	-	-	(324)	(324)	-	(324)
E1	現金增資	2,527	19,272	(63)	19,209	-	-	-	-	21,736
T1	股份發行成本	-	(229)	-	(229)	-	-	-	-	(229)
N1	股份基礎給付交易	-	-	67	67	-	-	-	-	67
K1	員工認股權計畫下發行之普通股	612	3,947	(402)	3,545	-	-	-	-	4,157
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	6,969	6,969	-	6,969
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(156)	(156)
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	6,969	6,969	(156)	6,813
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	$ 19,901	$ 44,621	$ 817	$ 45,438	$ 2,799	$ 20,001	$ 22,800	($ 350)	$ 87,789

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：關建英　　經理人：沈翔霖　　會計主管：詹舒媚

Alchip Technologies, Limited 及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
或美金仟元

代　碼		103年度 美　金	103年度 新　台　幣	102年度 美　金	102年度 新　台　幣
	營業活動之現金流量				
A10000	本年度稅前淨利	$ 9,883	$ 299,508	$ 5,126	$ 152,175
A20010	不影響現金流量之收益費損項目				
A20100	折舊及攤銷	21,342	646,787	11,624	345,119
A20300	呆帳費用	163	4,951	246	7,316
A21200	利息收入	(234)	(7,085)	(203)	(6,029)
A21900	員工認股權酬勞成本	67	2,038	41	1,212
A22500	處分設備損失（利益）	(11)	(328)	36	1,063
A23700	資產減損損失	1,349	40,879	1,431	42,468
A23800	存貨跌價損失(迴轉利益）	95	2,893	(230)	(6,825)
A24100	外幣淨兌換損失（利益）	285	8,679	(183)	(5,408)
A29900	預付款項攤銷	2,539	76,938	2,896	85,964
A30000	營業資產及負債之淨變動數				
A31150	應收帳款	(4,697)	(142,378)	(2,406)	(71,428)
A31180	其他應收款	553	16,768	(189)	(5,597)
A31200	存　　貨	(4,278)	(129,652)	4,071	120,852
A31230	預付款項	(6,780)	(205,497)	(3,593)	(106,649)
A31240	其他流動資產	(263)	(7,977)	(301)	(8,935)
A32150	應付帳款	1,235	37,426	(3,010)	(89,391)
A32180	其他應付款	2,856	86,571	501	14,882
A32210	預收款項	3,767	114,158	-	-
A32230	其他流動負債	(9)	(277)	(153)	(4,563)
A33000	營運產生之現金	27,862	844,402	15,704	466,226
A33500	支付之所得稅	(1,869)	(56,664)	(16)	(436)
AAAA	營業活動之淨現金流入	25,993	787,738	15,688	465,790
	投資活動之現金流量				
B00600	無活絡市場之債券投資增加	(6,824)	(206,815)	(1,615)	(47,936)
B00800	無活絡市場之債券投資減少	4,668	141,470	1,226	36,390
B02700	取得不動產、廠房及設備	(17,643)	(534,670)	(11,825)	(351,053)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	42	1,260	8	235
B03700	存出保證金增加	(54)	(1,635)	-	-
B03800	存出保證金減少	18	539	6	171
B04500	購置無形資產	(5,382)	(163,133)	(5,286)	(156,938)
B07100	預付設備款增加	(1,800)	(54,550)	-	-
B07500	收取之利息	233	7,060	205	6,076
BBBB	投資活動之淨現金流出	(26,742)	(810,474)	(17,281)	(513,055)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		103年度 美　金	103年度 新台幣	102年度 美　金	102年度 新台幣
	籌資活動之現金流量				
C04500	支付本公司業主股利	($ 324)	($ 9,746)	$ -	$ -
C04600	發行本公司新股	21,736	660,566	-	-
C04800	取得員工行使認股權價款	4,157	125,947	3	90
C09900	支付股份發行成本	(229)	(6,952)	-	-
CCCC	籌資活動淨現金流入	25,340	769,815	3	90
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(398)	53,093	47	16,660
EEEE	現金及約當現金增加（減少）	24,193	800,172	(1,543)	(30,515)
E00100	年初現金及約當現金餘額	18,673	556,552	20,216	587,067
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 42,866	$1,356,724	$ 18,673	$ 556,552

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：關建英　　經理人：沈翔霖　　會計主管：詹舒媚

Alchip Technologies, Limited 及子公司

合併財務報表附註

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（除另予註明者外，金額係以美金仟元及新台幣仟元為單位）

一、公司沿革

Alchip Technologies, Limited（以下稱「本公司」）於 92 年 2 月 27 日註冊於英屬開曼群島，主要經營研究開發、設計及製造特殊應用積體電路設計（ASIC）和系統單晶片（SOC）及提供相關服務等。

本公司股票自 99 年 12 月起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之興櫃股票櫃檯交易，於 103 年 10 月 28 日終止興櫃交易，並於同日起轉至台灣證券交易所掛牌交易。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告於 104 年 3 月 5 日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 尚未生效之證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之 2013 年版國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）

依據金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）發布之金管證審字第 1030029342 號及金管證審字第 1030010325 號函，合併公司應自 104 年起開始適用業經國際會計準則理事會（IASB）發布且經金管會認可之 2013 年版 IFRS、IAS、IFRIC 及 SIC（以下稱「IFRSs」）及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定。

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日（註）
IFRSs 之修正「IFRSs 之改善－對 IAS 39 之修正（2009 年）」	2009 年 1 月 1 日或 2010 年 1 月 1 日
IAS 39 之修正「嵌入式衍生工具」	於 2009 年 6 月 30 日以後結束之年度期間生效
「IFRSs 之改善（2010 年）」	2010 年 7 月 1 日或 2011 年 1 月 1 日

（接次頁）

（承前頁）

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB發布之生效日（註）
「2009-2011週期之年度改善」	2013年1月1日
IFRS 1之修正「IFRS 7之比較揭露對首次採用者之有限度豁免」	2010年7月1日
IFRS 1之修正「嚴重高度通貨膨脹及首次採用者固定日期之移除」	2011年7月1日
IFRS 1之修正「政府貸款」	2013年1月1日
IFRS 7之修正「揭露－金融資產及金融負債之互抵」	2013年1月1日
IFRS 7之修正「揭露－金融資產之移轉」	2011年7月1日
IFRS 10「合併財務報表」	2013年1月1日
IFRS 11「聯合協議」	2013年1月1日
IFRS 12「對其他個體之權益之揭露」	2013年1月1日
IFRS 10、IFRS 11及IFRS 12之修正「合併財務報表、聯合協議及對其他個體之權益之揭露：過渡指引」	2013年1月1日
IFRS 10、IFRS 12及IAS 27之修正「投資個體」	2014年1月1日
IFRS 13「公允價值衡量」	2013年1月1日
IAS 1之修正「其他綜合損益項目之表達」	2012年7月1日
IAS 12之修正「遞延所得稅：標的資產之回收」	2012年1月1日
IAS 19之修訂「員工福利」	2013年1月1日
IAS 27之修訂「單獨財務報表」	2013年1月1日
IAS 28之修訂「投資關聯企業及合資」	2013年1月1日
IAS 32之修正「金融資產及金融負債之互抵」	2014年1月1日
IFRIC 20「露天礦場於生產階段之剝除成本」	2013年1月1日

註：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

除下列說明外，適用上述2013年版IFRSs及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定將不致造成合併公司會計政策之重大變動：

1. IFRS 13「公允價值衡量」

IFRS 13「公允價值衡量」提供公允價值衡量指引，該準則定義公允價值、建立衡量公允價值之架構，並規定公允價值衡量之揭露。此外，該準則規定之揭露內容較現行準則更為廣泛，例如，現行準則僅要求以公允價值衡量之金融工具須按公允價

值三層級揭露，依照 IFRS 13「公允價值衡量」規定，適用該準則之所有資產及負債皆須提供前述揭露。

IFRS 13 之衡量規定係自 104 年起推延適用。

2. IAS 1 之修正「其他綜合損益項目之表達」

依修正之準則規定，其他綜合損益項目須按性質分類且分組為(1)不重分類至損益之項目及(2)後續可能重分類至損益之項目。相關所得稅亦應按相同基礎分組。適用該修正規定前，並無上述分組之強制規定。

合併公司將於 104 年追溯適用上述修正規定。後續可能重分類至損益之項目預計將為國外營運機構財務報表換算之兌換差額，其金額為損失 4,728 仟元（美金 156 仟元）；不重分類至損益之金額為利益 134,554 仟元。惟適用上述修正並不影響本年度淨利、本年度稅後其他綜合損益及本年度綜合損益總額。

(二) IASB 已發布但尚未經金管會認可之 IFRSs

合併公司未適用下列業經 IASB 發布但未經金管會認可之 IFRSs。截至本合併財務報告通過發布日止，金管會尚未發布生效日。

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB發布之生效日(註1)
「2010-2012 週期之年度改善」	2014 年 7 月 1 日（註 2）
「2011-2013 週期之年度改善」	2014 年 7 月 1 日
「2012-2014 週期之年度改善」	2016 年 1 月 1 日（註 4）
IFRS 9「金融工具」	2018 年 1 月 1 日
IFRS 9 及 IFRS 7 之修正「強制生效日及過渡揭露」	2018 年 1 月 1 日
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	2016 年 1 月 1 日（註 3）
IFRS 11 之修正「聯合營運權益之取得處理」	2016 年 1 月 1 日
IFRS 14「管制遞延帳戶」	2016 年 1 月 1 日
IFRS 15「來自客戶合約之收入」	2017 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「揭露計畫」	2016 年 1 月 1 日
IAS 16 及 IAS 38 之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	2016 年 1 月 1 日
IAS 16 及 IAS 41 之修正「農業：生產性植物」	2016 年 1 月 1 日
IAS 19 之修正「確定福利計畫：員工提撥金」	2014 年 7 月 1 日

（接次頁）

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB發布之生效日(註1)
IAS 36之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	2014年1月1日
IAS 39之修正「衍生工具之合約更替及避險會計之繼續」	2014年1月1日
IFRIC 21「公課」	2014年1月1日

註1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

註2：給與日於2014年7月1日以後之股份基礎給付交易開始適用IFRS 2之修正；收購日於2014年7月1日以後之企業合併開始適用IFRS 3之修正；IFRS 13於修正時即生效。其餘修正係適用於2014年7月1日以後開始之年度期間。

註3：推延適用於2016年1月1日以後開始之年度期間所發生之交易。

註4：除IFRS 5之修正採推延適用外，其餘修正係適用於2016年1月1日以後開始之年度期間。

除下列說明外，適用上述新發布／修正／修訂準則或解釋將不致造成合併公司會計政策之重大變動：

1. IFRS 9「金融工具」

金融資產之認列及衡量

就金融資產方面，所有原屬於IAS 39「金融工具：認列與衡量」範圍內之金融資產後續衡量係以攤銷後成本衡量或以公允價值衡量。IFRS 9對金融資產之分類規定如下。

合併公司投資之債務工具，若其合約現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息，分類及衡量如下：

(1) 以收取合約現金流量為目的之經營模式而持有該金融資產，則該金融資產係以攤銷後成本衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益，並持續評估減損，減損損益認列於損益。

(2) 藉由收取合約現金流量與出售金融資產而達成目的之經營模式而持有該金融資產，則該金融資產係以透過其他綜合損益按公允價值衡量。此類金融資產後續係按有效利率認列利息收入於損益，並持續評估減損，減損損益與兌換損益亦認列於損益，其他公允價值變動則認列於其他綜合損益。於該金融資產除列或重分類時，原先累積於其他綜合損益之公允價值變動應重分類至損益。

合併公司投資非屬前述條件之金融資產，係以公允價值衡量，公允價值變動認列於損益。惟合併公司得選擇於原始認列時，將非持有供交易之權益投資指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。此類金融資產除股利收益認列於損益外，其他相關利益及損失係認列於其他綜合損益，後續無須評估減損，累積於其他綜合損益之公允價值變動亦不重分類至損益。

金融資產之減損

IFRS 9 改採用「預期信用損失模式」認列金融資產之減損。以攤銷後成本衡量之金融資產、強制透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、應收租賃款、IFRS 15「來自客戶合約之收入」產生之合約資產或放款承諾及財務保證合約，係認列備抵信用損失。若前述金融資產之信用風險自原始認列後並未顯著增加，則其備抵信用損失係按未來 12 個月之預期信用損失衡量。若前述金融資產之信用風險自原始認列後已顯著增加且非低信用風險，則其備抵信用損失係按剩餘存續期間之預期信用損失衡量。但未包括重大財務組成部分之應收帳款必須按存續期間之預期信用損失衡量備抵信用損失。

此外，原始認列時已有信用減損之金融資產，合併公司考量原始認列時之預期信用損失以計算信用調整後之有效利率，後續備抵信用損失則按後續預期信用損失累積變動數衡量。

2. IAS 36 之修正「非金融資產可回收金額之揭露」

IASB 於發布 IFRS 13「公允價值衡量」時，同時修正 IAS 36「資產減損」之揭露規定，導致合併公司須於每一報導期間增

加揭露資產或現金產生單位之可回收金額。本次 IAS 36 之修正係釐清合併公司僅須於認列或迴轉減損損失當期揭露該等可回收金額。此外，若可回收金額係以現值法計算之公允價值減處分成本衡量，合併公司須增加揭露所採用之折現率。

除上述影響外，截至本合併財務報告通過發布日止，合併公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之 IFRSs 編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具外，本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。歷史成本通常係依取得資產所支付對價之公允價值決定。

本公司之功能性貨幣為美元。由於本公司於台灣證券交易所掛牌交易，為增加財務報表之比較性及一致性，本合併財務報表以新台幣為表達貨幣，其換算方式係資產及負債科目按報導期間結束日之匯率、股東權益按歷史匯率及損益科目按各該期間之平均匯率換算為新台幣，財務報表換算所產生之兌換差額列入國外營運機構財務報表換算之兌換差額。

(三) 合併基礎

1. 合併報告編製原則

本合併財務報告係包含本公司及由本公司所控制個體（即子公司）之財務報告。

子公司之財務報告已予調整，以使其會計政策與合併公司之會計政策一致。

於編製合併財務報告時，合併各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。

2. 列入合併財務報告之子公司

本合併財務報告編製主體如下：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比 103年12月31日	所持股權百分比 102年12月31日	說明
本公司	Alchip Technologies, Limited（註冊於香港）（以下簡稱 Alchip HK）	一般投資	100%	100%	-
	AlChip Technologies, Inc.（註冊於美國）（以下簡稱 Alchip USA）	提供 ASIC 及 SOC 銷售	100%	100%	-
	Alchip Technologies, KK（註冊於日本）（以下簡稱 Alchip KK）	研究、開發及設計 ASIC 及 SOC 並提供相關服務與銷售	100%	100%	-
	世芯電子股份有限公司（註冊於台灣）	研究、開發及設計 ASIC 及 SOC 並提供相關服務、銷售與製造	100%	100%	-
Alchip HK	世芯電子（上海）有限公司（註冊於中國）	研究、開發及設計 ASIC 及 SOC 並提供相關服務與銷售	100%	100%	-
	世芯電子科技（無錫）有限公司（註冊於中國）	研究、開發及設計 ASIC 及 SOC 並提供相關服務	100%	100%	-

3. 未併入合併財務報表之子公司：無

(四) 外　　幣

各個體編製財務報告時，以個體功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一報導期間結束日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製合併財務報告時，合併公司國外營運機構之資產及負債以每一報導期間結束日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當年度平均匯率換算，所產生之兌換差額列於其他綜合損益。

(五) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於報導期間結束日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於報導期間結束日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 預期於報導期間結束日後 12 個月內到期清償之負債，以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至報導期間結束日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(六) 存　　貨

存貨包括原料、物料、製成品及在製品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

(七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備係採直線基礎提列折舊，對於每一重大部分則單獨提列折舊。合併公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視。

除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當期損益。

(八) 無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。合併公司以直線

基礎進行攤銷，並且至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視。除合併公司預期於該無形資產經濟年限屆滿前處分該資產外，有限耐用年限無形資產之殘值估計為零。

除列無形資產所產生之利益或損失金額，係淨處分價款與該資產帳面金額間之差額，並且認列於當期損益。

(九) 有形及無形資產之減損

合併公司於每一報導期間結束日評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，合併公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至最小現金產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十) 金融工具

金融資產與金融負債於合併公司成為該工具合約條款之一方時認列於合併資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

合併公司所持有之金融資產種類為放款及應收款。放款及應收款主要包括現金及約當現金、應收帳款、其他應收款、無活絡市場之債券投資及質押定存單，係採用有效利息法按攤銷後成本減除減損損失後之金額衡量，惟短期應收帳款之利息認列不具重大性之情況除外。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、具高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款及短期投資，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產之減損

合併公司係於每一報導期間結束日評估其他金融資產是否有減損客觀證據，當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事項，致使金融資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

按攤銷後成本列報之金融資產，該資產經個別評估未有減損後，另再集體評估減損。

按攤銷後成本列報之金融資產之減損損失金額係該資產帳面金額與估計未來現金流量按該金融資產原始有效利率折現之現值間之差額。

按攤銷後成本列報之金融資產於後續期間減損損失金額減少，且經客觀判斷該減少與認列減損後發生之事項有關，則先前認列之減損損失直接或藉由調整備抵帳戶予以迴轉認列於損益，惟該迴轉不得使金融資產帳面金額超過若未認列減損情況下於迴轉日應有之攤銷後成本。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當判斷應收帳款無法收回時，係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。除因應收帳款無法收回而沖銷備抵帳戶外，備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

(3) 金融資產之除列

合併公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

於一金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。

2. 金融負債

所有金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量。除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

(十一) 收入認列

收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。

1. 商品之銷售

銷售商品係於下列條件完全滿足時認列收入：

(1) 合併公司已將商品所有權之重大風險及報酬移轉予買方；

(2) 合併公司對於已經出售之商品既不持續參與管理，亦未維持有效控制；

(3) 收入金額能可靠衡量；

(4) 與交易有關之經濟效益很有可能流入合併公司；及

(5) 與交易有關之已發生或將發生之成本能可靠衡量。

2. 勞務之提供

依合約提供勞務所產生之收入，按合約完成程度予以認列。

3. 利息收入

金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入合併公司，且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(十二) 租　　賃

營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用。

(十三) 退職後福利

屬確定提撥退休計畫之退休金，係於員工提供服務之期間，將應提撥之退休金數額認列為當期費用。

(十四) 股份基礎給付協議

合併公司給與員工之員工認股權係屬權益交割股份基礎給付，係以給與日權益工具之公允價值衡量。按給與日所決定之公允價值及預期既得員工認股權之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積—員工認股權。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。

合併公司於每一報導期間結束日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積—員工認股權。

(十五) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵 10%所得稅列為股東會決議年度之所得稅費用。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依合併財務報表帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異予以認列。遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備及研究發展支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一報導期間結束日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資

產者，亦於每一報導期間結束日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以報導期間結束日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映企業於報導期間結束日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 本年度之當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

合併公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得資產及負債帳面金額之相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

(一) 存貨之減損

存貨淨變現價值係正常營業過程中之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額估計，該等估計係依目前市場狀況及類似產品之歷史銷售經驗評估，市場情況之改變可能重大影響該等估計結果。

(二) 設備及無形資產之減損

與設計及生產晶片相關之設備及無形資產減損係按該等設備之可回收金額（即該等資產之公允價值減出售成本與其使用價值之較高者）評估，市場價格或未來現金流量變動將影響該等資產可回收金額，可能導致合併公司須額外認列減損損失或迴轉已認列之減損損失。

六、現金及約當現金

	103年12月31日	102年12月31日
新台幣		
活期存款	$ 666,527	$ 543,518
原始到期日在3個月以內之定期存款	664,034	8,649
支票存款	25,956	4,155
零用金	207	230
	$1,356,724	$ 556,552
美金		
活期存款	$ 21,058	$ 18,236
原始到期日在3個月以內之定期存款	20,981	290
支票存款	820	139
零用金	7	8
	$ 42,866	$ 18,673

原始到期日在3個月以上之定期存款帳列無活絡市場之債券投資。

銀行存款及無活絡市場之債券投資於報導期間結束日之利率區間如下：

	103年12月31日	102年12月31日
銀行存款	0.01%~3.4%	0.01%~2.10%
無活絡市場之債券投資	0.53%~3.3%	0.6%~3.25%

七、應收帳款及其他應收款

	103年12月31日	102年12月31日
新台幣		
應收帳款		
應收帳款	$649,213	$481,046
減：備抵呆帳	(6,130)	(10,608)
	$643,083	$470,438
其他應收款		
讓售應收帳款	$ -	$ 19,445
應收退稅款	17,333	9,239
其他	341	1,755
	$ 17,674	$ 30,439

（接次頁）

	103年12月31日	102年12月31日
美　　金		
應收帳款		
應收帳款	$ 20,511	$ 16,140
減：備抵呆帳	(193)	(356)
	$ 20,318	$ 15,784
其他應收款		
讓售應收帳款	$ -	$ 660
應收退稅款	548	310
其　　他	11	51
	$ 559	$ 1,021

應收帳款

合併公司對商品銷售之平均授信期間為30至60天，對應收帳款不予計息。決定應收帳款可回收性時。合併公司係參考帳齡分析、歷史收款經驗及客戶財務狀況，以估計無法回收之金額。

於報導期間結束日已逾期但合併公司尚未認列備抵呆帳之應收帳款，因其信用品質並未重大改變，合併公司管理階層認為仍可回收其金額，帳齡分析如下：

	103年12月31日	102年12月31日
新台幣		
已逾期未減損		
0～60天	$ 2,358	$ -
90～120天以上	18,990	-
合　　計	$ 21,348	$ -
美　　金		
已逾期未減損		
0～60天	$ 75	$ -
90～120天以上	600	-
合　　計	$ 675	$ -

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

應收帳款之備抵呆帳變動資訊如下：

	個別評估減損損失	群組評估減損損失	合計
新台幣			
102年1月1日餘額	$ 3,949	$ -	$ 3,949
加：本年度提列呆帳費用	6,286	1,030	7,316
減：本年度實際沖銷	(654)	(131)	(785)
外幣換算差額	123	5	128
102年12月31日餘額	9,704	904	10,608
加：本年度提列呆帳費用	2,366	2,585	4,951
減：本年度實際沖銷	(9,867)	-	(9,867)
外幣換算差額	267	171	438
103年12月31日餘額	$ 2,470	$ 3,660	$ 6,130
美金			
102年1月1日餘額	$ 136	$ -	$ 136
加：本年度提列呆帳費用	212	34	246
減：本年度實際沖銷	(22)	(4)	(26)
102年12月31日餘額	326	30	356
加：本年度提列呆帳費用	78	85	163
減：本年度實際沖銷	(326)	-	(326)
103年12月31日餘額	$ 78	$ 115	$ 193

截至103年及102年12月31日止，處於重大財務困難之個別已減損應收帳款金額分別為新台幣2,470仟元（美金78仟元）及9,704仟元（美金326仟元）。合併公司對該等應收帳款餘額並未持有任何擔保品。

八、存貨

	103年12月31日	102年12月31日
新台幣		
製成品	$ 9,016	$ 3,178
在製品	208,762	71,104
原料	6,451	12,210
	$224,229	$ 86,492
美金		
製成品	$ 285	$ 106
在製品	6,596	2,386
原料	204	410
	$ 7,085	$ 2,902

103 及 102 年度與晶片製造相關之銷貨成本分別為 3,299,871 仟元（美金 108,887 仟元）及 1,427,583 仟元（美金 48,085 仟元）。

103 年度之銷貨成本包括存貨跌價損失 2,893 仟元（美金 95 仟元），102 年度之銷貨成本包括存貨價值回升利益 6,825 仟元（美金 230 仟元），係因合併公司調降存貨庫存水準，致迴轉備抵存貨跌價損失所致。

九、不動產、廠房及設備

	機器設備	電腦設備	辦公設備	租賃改良	運輸設備	合計
新台幣						
成本						
102 年 1 月 1 日餘額	$ 822,371	$ 64,042	$ 7,105	$ 21,233	$ 4,244	$ 918,995
增添	345,045	16,415	1,163	641	-	363,264
處分及報廢	(172,258)	(5,283)	(3,393)	-	(1,286)	(182,220)
淨兌換差額	22,493	(1,584)	6	916	(558)	21,273
102 年 12 月 31 日餘額	$1,017,651	$ 73,590	$ 4,881	$ 22,790	$ 2,400	$1,121,312
累計折舊及減損						
102 年 1 月 1 日餘額	($ 622,936)	($ 37,102)	($ 3,919)	($ 5,859)	($ 3,820)	($ 673,636)
折舊費用	(228,655)	(9,550)	(829)	(7,011)	-	(246,045)
處分及報廢	172,123	4,753	2,888	-	1,158	180,922
減損損失	(39,332)	-	-	-	-	(39,332)
淨兌換差額	(16,730)	1,115	(46)	(283)	503	(15,441)
102 年 12 月 31 日餘額	($ 735,530)	($ 40,784)	($ 1,906)	($ 13,153)	($ 2,159)	($ 793,532)
102 年 12 月 31 日淨額	$ 282,121	$ 32,806	$ 2,975	$ 9,637	$ 241	$ 327,780
成本						
103 年 1 月 1 日餘額	$1,017,651	$ 73,590	$ 4,881	$ 22,790	$ 2,400	$1,121,312
增添	498,177	12,132	2,998	6,772	1,399	521,478
處分及報廢	(60,821)	(536)	-	-	(1,124)	(62,481)
淨兌換差額	82,380	705	184	1,712	160	85,141
103 年 12 月 31 日餘額	$1,537,387	$ 85,891	$ 8,063	$ 31,274	$ 2,835	$1,665,450
累計折舊及減損						
103 年 1 月 1 日餘額	($ 735,530)	($ 40,784)	($ 1,906)	($ 13,153)	($ 2,159)	($ 793,532)
折舊費用	(449,402)	(10,921)	(862)	(8,462)	(84)	(469,731)
處分及報廢	60,063	474	-	-	1,012	61,549
減損損失	(40,879)	-	-	-	-	(40,879)
淨兌換差額	(64,597)	1,238	(10)	(1,192)	(94)	(64,655)
103 年 12 月 31 日餘額	($1,230,345)	($ 49,993)	($ 2,778)	($ 22,807)	($ 1,325)	($1,307,248)
103 年 12 月 31 日淨額	$ 307,042	$ 35,898	$ 5,285	$ 8,467	$ 1,510	$ 358,202
美金						
成本						
102 年 1 月 1 日餘額	$ 28,319	$ 2,205	$ 245	$ 731	$ 146	$ 31,646
增添	11,622	553	39	22	-	12,236
處分及報廢	(5,802)	(178)	(114)	-	(43)	(6,137)
淨兌換差額	5	(111)	(6)	12	(22)	(122)
102 年 12 月 31 日餘額	$ 34,144	$ 2,469	$ 164	$ 765	$ 81	$ 37,623

（接次頁）

（承前頁）

	機器設備	電腦設備	辦公設備	租賃改良	運輸設備	合計
累計折舊及減損						
102年1月1日餘額	($ 21,450)	($ 1,278)	($ 135)	($ 202)	($ 132)	($ 23,197)
折舊費用	(7,701)	(322)	(28)	(236)	-	(8,287)
處分及報廢	5,797	160	97	-	39	6,093
減損損失	(1,325)	-	-	-	-	(1,325)
淨兌換差額	1	71	2	(3)	19	90
102年12月31日餘額	($ 24,678)	($ 1,369)	($ 64)	($ 441)	($ 74)	($ 26,626)
102年12月31日淨額	$ 9,466	$ 1,100	$ 100	$ 324	$ 7	$ 10,997
成本						
103年1月1日餘額	$ 34,144	$ 2,469	$ 164	$ 765	$ 81	$ 37,623
增添	16,438	400	99	223	46	17,206
處分及報廢	(2,007)	(18)	-	-	(37)	(2,062)
淨兌換差額	-	(42)	(5)	-	-	(47)
103年12月31日餘額	$ 48,575	$ 2,809	$ 258	$ 988	$ 90	$ 52,720
累計折舊及減損						
103年1月1日餘額	($ 24,678)	($ 1,369)	($ 64)	($ 441)	($ 74)	($ 26,626)
折舊費用	(14,829)	(361)	(28)	(279)	(3)	(15,500)
處分及報廢	1,982	16	-	-	33	2,031
減損損失	(1,349)	-	-	-	-	(1,349)
淨兌換差額	-	40	2	-	-	42
103年12月31日餘額	($ 38,874)	($ 1,674)	($ 90)	($ 720)	($ 44)	($ 41,402)
103年12月31日淨額	$ 9,701	$ 1,135	$ 168	$ 268	$ 46	$ 11,318

因部分產品屆其生命週期尾聲，合併公司預期用於生產該產品所使用之設備無未來經濟效益，故合併公司於103年度及102年度分別認列減損損失40,879仟元(美金1,349仟元)及39,332仟元(美金1,325仟元)，該減損損失已列入合併綜合損益表之其他利益及損失項下。

合併公司之不動產、廠房及設備係以直線基礎按下列耐用年數計提折舊：

機器設備	1至6年
電腦設備	3至5年
辦公設備	3至5年
租賃改良	3至5年
運輸設備	5年

十、無形資產

	矽智財權	電腦軟體成本	合計
新台幣			
成本			
102年1月1日餘額	$ 178,642	$ 11,164	$ 189,806
取得	209,996	66	210,062
除列	(26,984)	-	(26,984)
淨兌換差額	5,374	307	5,681
102年12月31日餘額	$ 367,028	$ 11,537	$ 378,565
累計攤銷及減損			
102年1月1日餘額	($ 88,968)	($ 5,006)	($ 93,974)
攤銷費用	(96,563)	(2,511)	(99,074)
除列	26,984	-	26,984
減損損失	(3,136)	-	(3,136)
淨兌換差額	(2,578)	(145)	(2,723)
102年12月31日餘額	($ 164,261)	($ 7,662)	($ 171,923)
102年12月31日淨額	$ 202,767	$ 3,875	$ 206,642
成本			
103年1月1日餘額	$ 367,028	$ 11,537	$ 378,565
取得	138,006	584	138,590
除列	(7,228)	-	(7,228)
淨兌換差額	28,573	741	29,314
103年12月31日餘額	$ 526,379	$ 12,862	$ 539,241
累計攤銷及減損			
103年1月1日餘額	($ 164,261)	($ 7,662)	($ 171,923)
攤銷費用	(174,845)	(2,211)	(177,056)
除列	7,228	-	7,228
淨兌換差額	(17,657)	(571)	(18,228)
103年12月31日餘額	($ 349,535)	($ 10,444)	($ 359,979)
103年12月31日淨額	$ 176,844	$ 2,418	$ 179,262
美金			
成本			
102年1月1日餘額	$ 6,152	$ 384	$ 6,536
取得	7,074	2	7,076
除列	(909)	-	(909)
102年12月31日餘額	$ 12,317	$ 386	$ 12,703

（接次頁）

（承前頁）

	矽智財權	電腦軟體成本	合計
累計攤銷及減損			
102年1月1日餘額	($ 3,064)	($ 172)	($ 3,236)
攤銷費用	(3,252)	(85)	(3,337)
除列	909	-	909
減損損失	(106)	-	(106)
102年12月31日餘額	($ 5,513)	($ 257)	($ 5,770)
102年12月31日淨額	$ 6,804	$ 129	$ 6,933
成本			
103年1月1日餘額	$ 12,317	$ 386	$ 12,703
取得	4,554	19	4,573
除列	(239)	-	(239)
103年12月31日餘額	$ 16,632	$ 405	$ 17,037
累計攤銷及減損			
103年1月1日餘額	($ 5,513)	($ 257)	($ 5,770)
攤銷費用	(5,769)	(73)	(5,842)
除列	239	-	239
103年12月31日餘額	($ 11,043)	($ 330)	($ 11,373)
103年12月31日淨額	$ 5,589	$ 75	$ 5,664

因部分產品屆其生命週期尾聲，合併公司預期其所使用之矽智財權無未來經濟效益，故102年度認列減損損失3,136仟元（美金106仟元）。

上述有限耐用年限無形資產係以直線基礎按下列耐用年數計提攤銷費用：

矽智財權	1至3年
電腦軟體成本	3至5年

十一、預付款項

	103年12月31日	102年12月31日
新台幣		
預付原料款	$126,672	$ 5,490
預付設計軟體使用費	76,752	53,674
預付矽智財權	24,845	-
其　　他	7,299	12,840
	$235,568	$ 72,004
美　　金		
預付原料款	$ 4,002	$ 184
預付設計軟體使用費	2,425	1,801
預付矽智財權	785	-
其　　他	231	431
	$ 7,443	$ 2,416

十二、其他應付款

	103年12月31日	102年12月31日
新台幣		
應付矽智財權	$110,099	$ 61,413
應付薪資及年獎	72,596	44,639
應付營業稅	17,253	124
應付勞務費	9,162	11,212
應付技術服務費	6,102	2,783
應付設備款	910	13,832
其　　他	13,982	11,262
	$230,104	$145,265
美　　金		
應付矽智財權	$ 3,479	$ 2,061
應付薪資及年獎	2,294	1,498
應付營業稅	545	4
應付勞務費	289	376
應付技術服務費	193	93
應付設備款	29	464
其　　他	441	378
	$ 7,270	$ 4,874

十三、退職後福利計畫

確定提撥計畫

合併公司中位於台灣之子公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

合併公司位於中華人民共和國及日本之子公司均已參加由當地政府辦理之確定提撥辦法，並按月提撥退休金給當地政府。

十四、權　　益

(一) 股　　本

普 通 股

	103年12月31日	102年12月31日
額定股數（仟股）	100,000	100,000
額定股本（新台幣）	$1,000,000	$1,000,000
已發行且已收足股款之股數（仟股）	63,482	53,947
已發行股本		
新台幣	$ 634,818	$ 539,473
美　金	$ 19,901	$ 16,762

已發行之普通股每股面額為10元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

本公司於103年5月26日董事會決議現金增資發行新股7,681仟股，每股面額10元，按每股86元發行，增資基準日為103年10月24日，共計取得現金660,566仟元（美金21,736仟元）。

(二) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程規定，年度決算如有盈餘時，除彌補歷年累積虧損外，依公開發行公司相關規定或權責主管機關之要求，提撥特別盈餘公積，如尚有盈餘，經股東會決議分派之，但董事酬勞不得多於分派數額之2%及員工紅利不得少於分派數額之1%。盈餘之分配得以現金或股票發放，惟其中現金股利發放總額不得低於股利總額之10%。

本公司股東常會於103年5月26日決議通過章程修訂案，依據新修訂之公司章程，本公司應依法提撥應繳納之稅款並就年度淨利先彌補歷年虧損。其次，依公開發行公司法令規定提撥法定盈餘公積，並依公開發行公司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積；並得提撥不超過所餘利潤之2%作為董事酬勞以及不低於所餘利潤之1%作為員工紅利。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，股利總額至少應為當年度盈餘扣除上述規定之 10%，其中現金股利發放總額不得低於發放股東股利總額之10%，最高以100%為上限。

103及102年度應付員工紅利及董事酬勞估列金額分別為17,660仟元（美金558仟元）及12,444仟元（美金418仟元）。前述員工紅利及董事酬勞分別係按稅後淨利（已扣除員工分紅及董事酬勞之金額）之8%及11%計算。年度終了後，本合併財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，本合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數按決議分紅之金額除以股票公允價值決定。股票公允價值係按股東會決議日前一日之收盤價（考量除權除息之影響後）計算。

本公司依金管證發字第 1010012865 號函、金管證發字第1010047490號函及「採用國際財務報導準則（IFRSs）後，提列特別盈餘公積之適用疑義問答」規定提列及迴轉特別盈餘公積。嗣後其他股東權益減項餘額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。

本公司未分配101年度盈餘，102年度盈餘分配案、員工紅利及董事酬勞如下：

	盈餘分配案（仟元）		每股股利	
	美金	新台幣	美金	新台幣
現金股利	$ 324	$ 9,746	$ 0.006	$ 0.2

	102年度	
	現金紅利（美金）	現金紅利（新台幣）
員工紅利	$ 340	$ 10,226
董事酬勞	78	2,341
	$ 418	$ 12,567
財務報表認列金額	$ 418	$ 12,567

本公司104年3月5日董事會擬議103年度盈餘分配案，配發現金股利美金1,275仟元折合新台幣約40,058仟元，每股股利約美金0.02元折合新台幣約0.63元。

有關103年度之盈餘分配案、員工分紅及董事酬勞尚待預計於104年6月12日召開之股東會決議。

有關本公司董事會通過擬議及股東會決議之員工紅利及董事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

(三) 首次採用IFRSs應提列之特別盈餘公積

合併公司首次採用IFRSs保留盈餘增加63,380仟元(美金3,221仟元)，其中67,693仟元（美金2,799仟元）係因累積換算調整數因選擇適用國際財務報導準則第1號豁免項目而轉入保留盈餘，故予以提列相同數額之特別盈餘公積。截至103年12月31日止，該特別盈餘公積餘額並未改變。

十五、股份基礎給付協議

(一) 現金增資保留予員工之認股權計劃

本公司於103年10月24日辦理現金增資發行新股7,681仟股，其中743仟股係由員工認購。給與對象為本公司及子公司符合條件之員工。認股權行使價格為每股新台幣86元（美金2.86元）。該股份基礎給付協議之相關資訊如下：

	103年度現金增資保留予員工部分	
員工認股權	單位（仟股）	加權平均執行價格（新台幣元）
年初流通在外	-	$ -
本年度給與	743	86
本年度執行	(743)	86
年底流通在外	-	-
年底可執行	-	-
本年度給與之認股權公允價值（新台幣元／股）	$ 2.60	

該現金增資保留員工認股部分使用 Black－Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

	員工認股權
給與日股價	88.5 元／股
執行價格	86 元／股
預期波動率	30.59%
預期存續期間	2 天
預期股利率	-
無風險利率	0.46%

上述現金增資保留予員工認股部分所認列之酬勞成本為 1,932 仟元（美金 63 仟元）。

(二) 本公司及子公司認股權計劃

本公司認股權酬勞計劃規定，每一單位認股權憑證可認購本公司普通股一股，給與對象為本公司、子公司及分公司之員工，經董事會同意後給予，認股權之存續期間為 10 年，憑證持有人於發行屆滿 1 年之日起，可行使被給與 25%之認股權，其後每月既得四十八分之一之認股權。認股權行使價格於本公司上市（櫃）前，由董事會參考同業發行員工認股權憑證之價格制定之，惟不得低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；本公司上市（櫃）後，則不低於發行日本公司普通股收盤價。認股權發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時，認股權行使價格依規定公式予以調整。任一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認

股權憑證總數之 20%，且每人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之 1%。

該員工認股權計畫之相關資訊如下：

	103年度		102年度	
員工認股權	單位	加權平均執行價格（美元）	單位	加權平均執行價格（美元）
年初流通在外	3,833,228	$ 2.36	4,395,707	$ 2.33
本年度執行	(1,853,473)	2.24	(76,000)	0.04
本年度逾期失效	(211,728)	2.55	(486,479)	2.52
年底流通在外	1,768,027	2.45	3,833,228	2.36
年底可執行	1,768,027	2.45	3,821,297	2.35

截至報導期間結束日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：

103年12月31日		102年12月31日	
執行價格（元）	加權平均剩餘合約期限（年）	執行價格（元）	加權平均剩餘合約期限（年）
$ 0.04	-	$ 0.04	1.24
0.99	0.04	0.99	1.09
2.00	0.54	2.00	1.54
2.20	0.96	2.20	1.96
2.60	3.30	2.60	4.33

103 及 102 年度因上述認股權計畫認列之酬勞成本分別為 106 仟元（美金 4 仟元）及 1,212 仟元（美金 41 仟元）。

十六、本期淨利

繼續營業單位淨利係包含以下項目：

(一) 營業收入淨額

合併公司之收入主要區分為 ASIC 及晶圓產品、委託設計服務收入及其他業務三類。委託設計服務收入主要係提供產品設計時所需的電路設計元件資料庫和各種矽智慧財產(SIP)，以及製作產品光罩組的電路圖，屬勞務服務收入；其他業務係提供客戶後端晶圓製造、封裝、測試的服務；ASIC 及晶圓產品業務則係包含上述兩種業務。

	103年度	102年度
新台幣		
ASIC及晶圓產品	$ 4,402,453	$ 2,392,158
委託設計服務收入	272,366	166,164
其他	16,922	25,241
合計	$ 4,691,741	$ 2,583,563
美金		
ASIC及晶圓產品	$ 145,269	$ 80,574
委託設計服務收入	8,987	5,597
其他	559	850
合計	$ 154,815	$ 87,021

(二) 其他收入

	103年度	102年度
新台幣		
利息收入	$ 7,085	$ 6,029
租金收入	2,197	-
其他	1,208	817
合計	$ 10,490	$ 6,846
美金		
利息收入	$ 234	$ 203
租金收入	72	-
其他	40	28
合計	$ 346	$ 231

(三) 其他利益及損失

	103年度	102年度
新台幣		
設備減損損失（附註九）	($ 40,879)	($ 39,332)
淨外幣兌換（損）益	(11,874)	2,977
處分設備（損）益	328	(1,063)
無形資產減損損失（附註十）	-	(3,136)
其他	(49)	-
合計	($ 52,474)	($ 40,554)

（接次頁）

	103年度	102年度
美　　金		
設備減損損失（附註九）	($ 1,349)	($ 1,325)
淨外幣兌換（損）益	(392)	101
處分設備（損）益	11	(36)
無形資產減損損失（附註十）	-	(106)
其　　他	(2)	-
合　　計	($ 1,732)	($ 1,366)

(四) 折舊及攤銷

	103年度	102年度
新 台 幣		
不動產、廠房及設備	$469,731	$246,045
無形資產	177,056	99,074
合　　計	$646,787	$345,119
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	$450,497	$224,369
營業費用	19,234	21,676
	$469,731	$246,045
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	$170,185	$ 92,207
營業費用	6,871	6,867
	$177,056	$ 99,074
美　　金		
不動產、廠房及設備	$ 15,500	$ 8,287
無形資產	5,842	3,337
合　　計	$ 21,342	$ 11,624
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	$ 14,865	$ 7,557
營業費用	635	730
	$ 15,500	$ 8,287
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	$ 5,616	$ 3,106
營業費用	226	231
	$ 5,842	$ 3,337

(五) 員工福利費用

	103年度	102年度
新台幣		
退職後福利（附註十三）		
確定提撥計畫	$ 24,223	$ 25,438
股份基礎給付（附註十五）	2,038	1,212
其他員工福利	406,059	367,476
	$432,320	$394,126
依功能別彙總		
營業成本	$ 38,764	$ 42,858
營業費用	393,556	351,268
	$432,320	$394,126
美金		
退職後福利（附註十三）		
確定提撥計畫	$ 799	$ 857
股份基礎給付（附註十五）	67	41
其他員工福利	13,399	12,378
	$ 14,265	$ 13,276
依功能別彙總		
營業成本	$ 1,279	$ 1,444
營業費用	12,986	11,832
	$ 14,265	$ 13,276

十七、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅費用之主要組成項目如下：

	103年度		102年度	
	美金	新台幣	美金	新台幣
當期所得稅				
當期產生者	$ 1,854	$ 56,188	$ 673	$ 20,011
未分配盈餘加徵	296	8,973	-	-
以前年度之調整	978	29,637	(8)	(243)
	3,128	94,798	665	19,768
遞延所得稅				
當期產生者	(214)	(6,476)	650	19,283
認列於損益之所得稅費用	$ 2,914	$ 88,322	$ 1,315	$ 39,051

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	103年度		102年度	
	美金	新台幣	美金	新台幣
繼續營業單位稅前淨利	$ 9,883	$299,508	$ 5,126	$152,175
稅前淨利按各轄區稅率計算之所得稅費用	1,811	54,893	991	29,433
決定課稅所得時應予調整之項目	25	742	29	816
免稅所得	-	-	(263)	(7,794)
投資抵減	(78)	(2,349)	(176)	(5,231)
基本稅額應納差額	-	-	318	9,450
未分配盈餘加徵	296	8,973	-	-
遞延所得稅影響數	(118)	(3,574)	424	12,620
以前年度之當期所得稅費用於本年度之調整	978	29,637	(8)	(243)
認列於損益之所得稅費用	$ 2,914	$ 88,322	$ 1,315	$ 39,051

合併公司適用中華民國所得稅法之個體所適用之稅率為 17%；中國地區子公司所適用之稅率為 25%；日本地區子公司所適用之各項稅率約為 38%。

(二) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

103 年度

新台幣

遞延所得稅資產	年初餘額	認列於損益	兌換差額	年底餘額
暫時性差異				
資產減損損失	$ 8,136	$ 2,445	$ 612	$ 11,193
備抵呆帳	764	(777)	13	-
存貨跌價損失	3,858	492	261	4,611
未實現兌換損益	1	290	13	304
	12,759	2,450	899	16,108
虧損扣抵	-	4,026	178	4,204
	$ 12,759	$ 6,476	$ 1,077	$ 20,312

美　　金

遞延所得稅資產	年初餘額	認列於損益	兌換差額	年底餘額
暫時性差異				
資產減損損失	$ 273	$ 81	$ -	$ 354
備抵呆帳	26	(26)	-	-
存貨跌價損失	129	16	-	145
未實現兌換損益	-	10	-	10
	428	81	-	509
虧損扣抵	-	133	-	133
	$ 428	$ 214	$ -	$ 642

102 年度

新　台　幣

遞延所得稅資產	年初餘額	認列於損益	兌換差額	年底餘額
暫時性差異				
資產減損損失	$ 8,160	($ 250)	$ 226	$ 8,136
備抵呆帳	145	627	(8)	764
存貨跌價損失	4,908	(1,160)	110	3,858
未實現兌換損益	2,120	(2,162)	43	1
	15,333	(2,945)	371	12,759
虧損扣抵	9,787	(11,044)	1,257	-
投資抵減	5,169	(5,294)	125	-
	$ 30,289	($ 19,283)	$ 1,753	$ 12,759

美　　金

遞延所得稅資產	年初餘額	認列於損益	兌換差額	年底餘額
暫時性差異				
資產減損損失	$ 281	($ 8)	$ -	$ 273
備抵呆帳	5	21	-	26
存貨跌價損失	169	(40)	-	129
未實現兌換損益	73	(73)	-	-
	528	(100)	-	428
虧損扣抵	337	(372)	35	-
投資抵減	178	(178)	-	-
	$ 1,043	($ 650)	$ 35	$ 428

(三) 子公司世芯電子股份有限公司兩稅合一相關資訊：

	103年12月31日	102年12月31日
股東可扣抵稅額帳戶餘額	$ 50,567	$ 39,436

(四) 所得稅核定情形

子公司世芯電子股份有限公司之營利事業所得稅截至 101 年度之申報案件業經稅捐稽徵機關核定。其核定與申報金額並無重大差異。

十八、每股盈餘

單位：每股元

	103年度		102年度	
	美金	新台幣	美金	新台幣
基本每股盈餘	$ 0.12	$ 3.77	$ 0.07	$ 2.10
稀釋每股盈餘	$ 0.12	$ 3.65	$ 0.07	$ 2.08

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

	103年度		102年度	
	美金	新台幣	美金	新台幣
本期淨利				
歸屬於本公司業主之淨利	$ 6,969	$211,186	$ 3,811	$113,124
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	$ 6,969	$211,186	$ 3,811	$113,124

單位：仟股

	103年度	102年度
股數		
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	56,021	53,878
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工認股權	1,681	221
員工分紅	172	187
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	57,874	54,286

若合併公司得選擇以股票或現金發放員工分紅，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工分紅將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度股東會決議員工分紅發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

十九、營業租賃協議

營業租賃係承租測試機台、辦公室及停車位，租賃期間為1至5年。於租賃期間終止時，本公司對租賃物件並無優惠承購權。

不可取消營業租賃之未來最低租賃給付總額如下：

	103年12月31日	102年12月31日
新台幣		
不超過1年	$ 31,716	$ 38,994
1～5年	33,470	32,752
	$ 65,186	$ 71,746
美金		
不超過1年	$ 1,002	$ 1,308
1～5年	1,058	1,099
	$ 2,060	$ 2,407

當年度認列於損益之租賃給付如下：

	新台幣		美金	
	103年度	102年度	103年度	102年度
最低租賃給付	$ 41,344	$ 36,250	$ 1,364	$ 1,221

二十、資本風險管理

本公司係採無晶圓廠營運模式，目前及未來重大資本支出主要為機器設備及矽智財權。故本公司之資本管理係依據所營事業的規模以及產業未來之成長與發展，以設定所需之營運資金、研究發展費用及股利支出等需求。本公司定期審慎評估資本風險管理政策，並以穩健保守為原則。

二一、金融工具

(一) 公允價值之資訊

請參閱合併資產負債表所列資訊。本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值，故以其在合併資產負債表上之帳面金額為估計公允價值之合理基礎。

(二) 金融工具之種類

請參閱合併資產負債表所列資訊。合併公司所持有之金融資產種類為放款及應收款，包括現金及約當現金、應收帳款及其他應收款、無活絡市場之債券投資及質押定存單；持有之金融負債種類為以攤銷後成本衡量之金融負債，包括應付帳款及其他應付款。

(三) 財務風險管理目的與政策

合併公司財務風險管理目標係為管理與營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險，並依相關規範及內部控制制度執行。合併公司財務部門視風險性質程度不定期對董事會及審計委員會提出報告以落實相關政策。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險。

(1) 匯率風險

本公司以美金為功能性貨幣，除承作人民幣定期存款外，另持有小額新台幣、日幣及人民幣等做為支應各子(分)公司員工薪資及營業費用，故無重大的匯率波動風險。然由於本公司於臺灣證券交易所掛牌交易，預料未來可能因發放新台幣股利予國內投資人或在國內籌資取得新台幣資金後必須兌換為美金使用時，將產生美元對台幣的匯率變動風險，本公司財務部門可能採取之因應措施如下：

A.財務人員依據匯率未來走勢於適當時機維持適當之外匯部位，以提供集團內各子公司之營運所需，降低匯率變動對公司獲利之影響。

B.與主要往來銀行保持密切聯繫，隨時監控外匯市場之變化，以供相關主管人員充分掌握匯率變動趨勢，若因應偶發收付款幣別改變之情事可即時進行適當調節。

C.對貨幣風險採取自然沖銷原則（即外銷與進口多以美元報價），並視需要在適當時機運用遠期外匯合約以及舉借外幣債務等方式，以降低匯兌變化對公司損益之影響。

本公司於報導期間結束日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額請參閱附註二五。

敏感度分析

本公司主要受到新台幣、日幣及人民幣匯率波動影響。

當美金（功能性貨幣）對新台幣、日幣及人民幣之匯率升值／貶值 5%時，合併公司之敏感度分析 5%係為集團內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率，亦代表管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估。敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其期末之換算以匯率變動 5%予以調整。有關外幣匯率風險之敏感性分析，主要係針對財務報導期間結束日之外幣貨幣性項目計算。103 年及 102 年 12 月 31 日之淨利將分別增加／減少美金 339 仟元及 456 仟元。

(2) 利率風險

合併公司於報導期間結束日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	103年12月31日	102年12月31日
新台幣		
具公允價值利率風險		
－金融資產	$846,429	$116,688
具現金流量利率風險		
－金融資產	666,527	543,518
美　　金		
具公允價值利率風險		
－金融資產	26,743	3,915
具現金流量利率風險		
－金融資產	21,058	18,236

敏感度分析

下列敏感度分析係依非衍生工具於報導期間結束日之利率暴險而決定。集團內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少 25 基點，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加／減少 25 基點，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司 103 及 102 年度之稅前淨利將增加／減少 1,666 仟元（美金 53 仟元）及 1,359 仟元（美金 46 仟元）。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成集團財務損失之風險。截至報導期間結束日，合併公司可能因交易對方未履行義務造成財務損失之最大信用風險曝險主要係來自於合併資產負債表所認列之金融資產帳面金額。

合併公司採行之政策係僅與信用良好之對象進行交易，並透過定期由財務部門複核及核准之交易對方信用額度限額控制信用曝險。

為減輕信用風險，合併公司管理階層負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，合併公司於報導期間結束日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，合併公司管理階層認為合併公司之信用風險有效降低。

另因流動資金之主要交易對方係國際信用評等機構給予良好信用評等之銀行，故該信用風險係屬有限。

合併公司之信用風險主要係集中於本公司最大客戶，截至 103 年及 102 年 12 月 31 日止，應收帳款總額來自前述客戶之比率分別為 25%及 16%。

3. 流動性風險

合併公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應集團營運並減輕現金流量波動之影響。

流動性及利率風險表

下表說明合併公司已約定還款期間之非衍生金融負債剩餘合約到期分析，其係依據合併公司最早可能被要求還款之日期，並以金融負債未折現現金流量編製。

	103年12月31日							
	新台幣				美金			
	短於1個月	1至3個月	3個月至1年	1至5年	短於1個月	1至3個月	3個月至1年	1至5年
無附息負債								
應付帳款	$ 98,809	$ 29,072	$ -	$ -	$ 3,122	$ 918	$ -	$ -
其他應付款	79,717	21,597	122,829	5,961	2,519	682	3,881	188
	$178,526	$ 50,669	$122,829	$ 5,961	$ 5,641	$ 1,600	$ 3,881	$ 188

	102年12月31日							
	新台幣				美金			
	短於1個月	1至3個月	3個月至1年	1至5年	短於1個月	1至3個月	3個月至1年	1至5年
無附息負債								
應付帳款	$ 73,172	$ 10,446	$ -	$ -	$ 2,456	$ 350	$ -	$ -
其他應付款	61,477	9,932	73,856	-	2,064	334	2,476	-
	$134,649	$ 20,378	$ 73,856	$ -	$ 4,520	$ 684	$ 2,476	$ -

二二、關係人交易

本公司及子公司（係本公司之關係人）間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時全數予以銷除，故未揭露於本附註。除已於其他附註揭露外，合併公司與其他關係人間之交易如下。

(一) 營業收入

帳列項目	關係人類別	103年度	102年度
新台幣			
營業收入	其他關係人（註）	$ -	$ 4,750
美金			
營業收入	其他關係人（註）	$ -	$ 160

對關係人之銷貨與一般交易條件相同。

(二) 應收關係人款項

帳列項目	關係人類別	103年12月31日	102年12月31日
新台幣			
應收帳款	其他關係人（註）	$ -	$ 4,769
美金			
應收帳款	其他關係人（註）	$ -	$ 160

註：自 103 年 5 月 9 日起與本公司非互為關係人。

(三) 對主要管理階層之獎酬

對董事及其他主要管理階層之薪酬總額如下：

	103年度	102年度
新台幣		
其他員工福利	$ 45,685	$ 45,132
退職後福利	628	619
	$ 46,313	$ 45,751
美金		
其他員工福利	$ 1,507	$ 1,520
退職後福利	21	21
	$ 1,528	$ 1,541

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效並考量市場趨勢決定。

二三、質抵押之資產

下列資產業經提供作為取得供應商交易額度及進口原物料之關稅擔保：

	103年12月31日		102年12月31日	
	新台幣	美金	新台幣	美金
質押定存單	$ 63,629	$ 2,010	$ 59,916	$ 2,010

二四、重大或有負債及未認列之合約承諾

截至 103 年 12 月 31 日止，合併公司為取得供應商交易額度，向銀行申請擔保信用狀餘額為美金 3,000 仟元。

二五、外幣金融資產及負債之匯率資訊

合併公司之功能性貨幣為美元，其具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

103 年 12 月 31 日

	外幣	匯率	帳面價值（美元）
金融資產			
貨幣性項目			
人民幣	$ 34,507	0.163425（人民幣：美元）	$ 5,639
新台幣	74,244	0.031596（新台幣：美元）	2,346
日圓	63,809	0.008360（日圓：美元）	533
			$ 8,518
金融負債			
貨幣性項目			
人民幣	6,455	0.163425（人民幣：美元）	$ 1,055
新台幣	21,812	0.031596（新台幣：美元）	689
			$ 1,744

102 年 12 月 31 日

	外幣	匯率	帳面價值（美元）
金融資產			
貨幣性項目			
人民幣	$ 47,165	0.164018（人民幣：美元）	$ 7,735
新台幣	56,825	0.033551（新台幣：美元）	1,907
日圓	72,300	0.009525（日圓：美元）	689
			$ 10,331
金融負債			
貨幣性項目			
人民幣	3,687	0.164018（人民幣：美元）	$ 605
新台幣	18,118	0.033551（新台幣：美元）	608
			$ 1,213

二六、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊：

1. 資金貸與他人：無。

2. 為他人背書保證：附表一。

3. 期末持有有價證券情形：無。

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
5. 取得不動產之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
6. 處分不動產之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新臺幣一億元或實收資本額百分之二十以上：附表二。
8. 應收關係人款項達新臺幣一億元或實收資本額百分之二十以上：附表三。
9. 從事衍生工具交易：無。
10. 其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：附表四。
11. 被投資公司資訊：附表五。

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：附表六。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：無。
   (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比。
   (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比。
   (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額。
   (4) 票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的。
   (5) 資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額。
   (6) 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等。

二七、部門資訊

(一) 部門收入與營運結果

合併公司主要業務為研究開發、設計及製造特殊應用積體電路設計（ASIC）和系統單晶片（SOC）及提供相關服務，係單一產業，管理階層將公司整體視為單一部門。

(二) 地區別資訊

合併公司主要於三個地區營運－日本、台灣與中國。

合併公司來自外部客戶之繼續營業單位收入依客戶所在地區分與非流動資產按資產（不含遞延所得稅資產）所在地區分別之資訊列示如下：

單位：新台幣仟元

	來自外部客戶之收入		非流動資產	
	103年度	102年度	103年12月31日	102年12月31日
日本	$ 1,729,154	$ 1,253,095	$ 6,003	$ 7,237
韓國	898,856	449,380	-	-
歐洲	741,741	229,355	-	-
中國大陸	712,460	359,491	43,746	38,351
台灣	564,667	239,953	336,436	336,010
其他	44,863	52,289	223,204	166,383
	$ 4,691,741	$ 2,583,563	$ 609,389	$ 547,981

單位：美金仟元

	來自外部客戶之收入		非流動資產	
	103年度	102年度	103年12月31日	102年12月31日
日本	$ 57,057	$ 42,207	$ 190	$ 243
韓國	29,660	15,136	-	-
歐洲	24,475	7,725	-	-
中國大陸	23,509	12,109	1,382	1,287
台灣	18,632	8,082	10,630	11,274
其他	1,482	1,762	7,052	5,581
	$ 154,815	$ 87,021	$ 19,254	$ 18,385

(三) 主要客戶資訊

來自單一客戶之收入達合併公司收入總額之10%以上者如下：

	103年度			102年度		
客戶	美金	新台幣	佔營業收入淨額%	美金	新台幣	佔營業收入淨額%
客戶A	$ 48,979	$1,484,343	32	$ 31,364	$ 931,179	36
客戶B	28,811	873,127	19	9,983	296,388	11
客戶C	24,315	736,892	16	7,725	229,355	9

Alchip Technologies, Limited 及子公司

為他人背書保證者

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：新台幣仟元

編號（註1）	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額（註3）	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率（%）	背書保證最高限額（註4）	屬母公司對子公司背書保證（註5）	屬子公司對母公司背書保證（註5）	屬對大陸地區背書保證（註5）	備註
		公司名稱	關係（註2）											
0	本公司	世芯電子股份有限公司	(1)	$ 1,111,409	$ 316,456	$ 316,456	$ 316,456	$ -	11.39	$ 1,389,261	Y	—	—	—
1	世芯電子（上海）有限公司	世芯電子股份有限公司	(2)	133,185	91,656	91,656	-	-	27.53	166,481	—	—	—	—

註1：編號欄之說明如下：

(1) 發行人填 0。

(2) 被投資公司按公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

2：關係欄說明如下：

(1) 直接持有普通股股權超過 50%之子公司。

(2) 母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過 50%之被投資公司。

註3：依本公司章程規定對個別對象背書保證金額不得超過最近期經會計師簽證後財務報表淨值之 40%。

註4：依本公司章程規定背書保證最高額度不得超過最近期經會計師簽證後財務報表淨值淨值之 50%。

註5：屬上市櫃母公司對子公司背書保證者、屬子公司對上市櫃母公司背書保證者、屬大陸地區背書證者始須填列 Y。

Alchip Technologies, Limited 及子公司

與關係人進、銷貨之金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表二

單位：新台幣仟元

進（銷）貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收（付）票據、帳款		備註
			進（銷）貨	金額	佔總進（銷）貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	世芯電子股份有限公司	本公司之子公司	進貨	$ 2,684,893	86.16%	一年內	與一般交易相同	與一般交易條件相同	($ 443,382)	(73.64%)	—
	世芯電子（上海）有限公司	本公司之子公司	進貨	172,132	5.52%	一年內	與一般交易相同	與一般交易條件相同	(121,220)	(20.13%)	—
	Alchip KK	本公司之子公司	銷貨	(181,815)	(5.49%)	一年內	與一般交易相同	與一般交易條件相同	152,189	26.33%	—
世芯電子股份有限公司	本公司	本公司之子公司	銷貨	(2,684,893)	(68.57%)	一年內	與一般交易相同	與一般交易條件相同	443,382	72.53%	—
世芯電子（上海）有限公司	本公司	本公司之子公司	銷貨	(172,132)	(90.98%)	一年內	與一般交易相同	與一般交易條件相同	121,220	100%	—
Alchip KK	本公司	本公司之子公司	進貨	181,815	80.95%	一年內	與一般交易相同	與一般交易條件相同	(152,189)	(99.79%)	—

Alchip Technologies, Limited 及子公司

應收關係人款項達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上者

民國 103 年 12 月 31 日

附表三

單位：新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率（次／年）	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註)	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
本公司	Alchip KK	本公司之子公司	$ 152,189	2.39	$ -	—	$ -	$ -
世芯電子股份有限公司	本公司	本公司之子公司	443,382	6.64	-	—	-	-
世芯電子（上海）有限公司	本公司	本公司之子公司	121,220	1.46	-	—	-	-

註：係截至 104 年 3 月 5 日止收回之金額。

Alchip Technologies, Limited 及子公司

母子公司間業務關係及重要交易往來情形

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表四

單位：新台幣仟元

編號（註 1）	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係（註 2）	交易往來情形			
				科目	金額（註 4）	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率（註 3）
0	本公司	世芯電子股份有限公司	1	預付款項	$ 292,606	一般交易條件	9%
		Alchip KK	1	應收帳款	152,189	一般交易條件	5%
		Alchip KK	1	營業收入	181,815	一般交易條件	4%
		Alchip USA	1	應收帳款	24,890	一般交易條件	1%
		Alchip USA	1	營業收入	38,986	一般交易條件	1%
1	世芯電子股份有限公司	本公司	2	應收帳款	443,382	一般交易條件	13%
		本公司	2	營業收入	2,684,893	一般交易條件	57%
2	世芯電子（上海）有限公司	本公司	2	應收帳款	121,220	一般交易條件	4%
		本公司	2	營業收入	172,132	一般交易條件	4%
3	世芯電子（無錫）有限公司	本公司	2	應收帳款	30,068	一般交易條件	1%
		本公司	2	營業收入	59,096	一般交易條件	1%

註 1：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

(1) 母公司填 0。

(2) 子公司依公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註 2：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可：

(1) 母公司對子公司。

(2) 子公司對母公司。

(3) 子公司對子公司。

註 3：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債項目者，以年底餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益項目者，以年度累積金額佔合併總營收之方式計算。

註 4：於編製合併財務報表時業已沖銷。

Alchip Technologies, Limited 及子公司

母子公司間業務關係及重要交易往來情形

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表四之一

單位：美金仟元

編號（註 1）	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係（註 2）	交易往來情形			
				科目	金額（註 4）	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率（註 3）
0	本公司	世芯電子股份有限公司	1	預付款項	$ 9,245	一般交易條件	9%
		Alchip KK	1	應收帳款	4,809	一般交易條件	5%
		Alchip KK	1	營業收入	5,999	一般交易條件	4%
		Alchip USA	1	應收帳款	786	一般交易條件	1%
		Alchip USA	1	營業收入	1,286	一般交易條件	1%
1	世芯電子股份有限公司	本公司	2	應收帳款	14,009	一般交易條件	13%
		本公司	2	營業收入	88,594	一般交易條件	57%
2	世芯電子（上海）有限公司	本公司	2	應收帳款	3,830	一般交易條件	4%
		本公司	2	營業收入	5,680	一般交易條件	4%
3	世芯電子（無錫）有限公司	本公司	2	應收帳款	950	一般交易條件	1%
		本公司	2	營業收入	1,950	一般交易條件	1%

註 1：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

(1) 母公司填 0。

(2) 子公司依公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註 2：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可：

(1) 母公司對子公司。

(2) 子公司對母公司。

(3) 子公司對子公司。

註 3：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債項目者，以年底餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益項目者，以年度累積金額佔合併總營收之方式計算。

註 4：於編製合併財務報表時業已沖銷。

Alchip Technologies, Limited 及子公司

被投資公司名稱、所在地區....等相關資訊

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表五

單位：外幣仟元，新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		年底持有			被投資公司本期（損）益	本期認列之投資（損）益	備註
				本年年底	去年年底	股數（仟股）	持股比率%	帳面金額			
本公司	Alchip HK	香港	一般投資	$480,264	$480,264	11,831,970	100	$381,776	$ 19,480	$ 19,480	—
	Alchip USA	美國	提供 ASIC 及 SOC 銷售	114,922	114,922	391,000	100	(1,671)	(8,468)	(8,468)	—
	Alchip KK	日本	研究、開發及設計 ASIC 及 SOC 並提供相關服務與銷售	62,587	62,587	2	100	34,196	(28,565)	(28,565)	—
	世芯電子股份有限公司	台灣	研究、開發及設計 ASIC 及 SOC 並提供相關服務、銷售與製造	250,000	250,000	25,000	100	904,861	228,780	228,780	—

Alchip Technologies, Limited 及子公司

大陸投資資訊

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表六

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式（註 1）	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期（損）益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資（損）益（註 2）	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
世芯電子（上海）有限公司	研究、開發及設計 ASIC 及 SOC 並提供相關服務與銷售	$ 405,120 (RMB 102,392)	註 1 (2)	$ 405,120 (US 12,800)	$ - -	$ - -	$ 405,120 (US 12,800)	$ 2,326	100%	$ 2,326 (2) 2.	$ 332,962	$ -
世芯電子科技（無錫）有限公司	研究、開發及設計 ASIC 及 SOC 並提供相關服務	63,300 (RMB 12,482)	註 1 (2)	63,300 (US 2,000)	- -	- -	63,300 (US 2,000)	17,367	100%	17,367 (2) 2.	45,128	-

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
$ -	$ -	$ -

註 1：投資方式區分為下列四種，標示種類別即可：

(1)直接赴大陸地區投資

(2)透過第三地區公司再投資大陸地區（投資公司：Alchip HK）。

(3)其他方式

註 2：本期認列投資損益欄中：

(1)若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明。

(2)投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明。

1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。

2.經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表。

3.其　　他。

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

董事長　關建英

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

Alchip Technologies, Ltd.

儒風 承印 RU FON (02) 2225-1430